

台灣積體電路製造股份有限公司
公開說明書

(發行民國一百一十二年度限制員工權利新股)

- 一、公司名稱：台灣積體電路製造股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的：發行民國一百一十二年度限制員工權利新股。
 - (一) 發行種類：本公司普通股股票。
 - (二) 發行股數及金額：6,249,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行總面額為新台幣 62,490,000 元整。
 - (三) 發行價格：無償發行。
 - (四) 發行條件：詳本公開說明書第 93 頁至第 97 頁。
- 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。
- 四、本次發行之相關費用：
 - (一) 承銷費用：不適用。
 - (二) 其他費用：包含會計師、律師等其他費用約新台幣 120 仟元。
- 五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項（詳本公開說明書第 5 頁至第 20 頁）。
- 八、查詢本公開說明書之網址：
 - (一) 公開資訊觀測站(<http://mops.tse.com.tw>)
 - (二) 公司網站(<https://www.tsmc.com>)

一、 本次發行前實收資本額來源：

新台幣仟元

資 本 來 源	金 額	占 實 收 資 本 額 比 率
創 立	1,377,500	1%
現 金 增 資	16,888,171	7%
盈 餘 轉 增 資	241,738,691	93%
資 本 公 積 轉 增 資	7,901,337	3%
合 併 增 資	15,835,152	6%
減 資	(27,573,432)	(11%)
其 他	3,153,292	1%
合 計	259,320,710	100%

二、 公開說明書之分送計畫：

(一) 陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。

(二) 分送方式：依證券主管機關之規定辦理。

(三) 索取方式：請逕洽公開資訊觀測站取閱(<http://mops.tse.com.tw>)。

三、 證券承銷商：不適用。

四、 公司債保證機構：不適用。

五、 公司債受託機構：不適用。

六、 股票簽證機構：不適用。

七、 辦理股票過戶機構：

名 稱	中國信託商業銀行 代理部	網 址	https://www.ctbcbank.com
地 址	台北市重慶南路一段 83 號 5 樓	電 話	(02) 6636-5566

八、 信用評等機構：不適用。

九、 公司債簽證會計師及律師：不適用。

十、 最近年度財務報告簽證會計師

會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所		
會計師姓名(註)	江美艷會計師、林尚志會計師		
地 址	台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	電 話	(02)2725-9988
網 址	http://www2.deloitte.com		

註：現任簽證會計師為吳世宗會計師、林尚志會計師

十一、 複核律師：不適用。

十二、 本公司發言人及代理發言人：

發言人姓名	黃仁昭	代理發言人姓名	高孟華
職 稱	副總經理暨財務長	職 稱	企業公共關係處 主管
電 話	(03)563-6688	電 話	(03)563-6688
電子郵件信箱	press@tsmc.com	電子郵件信箱	press@tsmc.com

十三、 本公司網址：<https://www.tsmc.com>

台灣積體電路製造股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 259,321 佰萬元		公司地址：新竹科學園區新竹市力行六路 8 號		電話：(03)563-6688	
設立日期：76 年 2 月 21 日			網址：https://www.tsmc.com.tw		
上市日期：83 年 9 月 5 日		上櫃日期：不適用	公開發行日期: 81 年 10 月 30 日		管理股票日期：不適用
負責人：董事長 劉德音			發言人：黃仁昭（副總經理暨財務長） 代理發言人：高孟華（企業公共關係處主管）		
股票過戶機構：中國信託商業銀行 代理部			電話：(02) 6636-5566 網址：https://www.ctbcbank.com 地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓		
股票承銷機構：不適用			電話：不適用 網址：不適用 地址：不適用		
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 江美艷、林尚志			電話：(02) 2725-9988 網址：http://www2.deloitte.com 地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓		
現任簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 吳世宗、林尚志			電話：(02) 2725-9988 網址：http://www2.deloitte.com 地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓		
複核律師：不適用			電話：不適用 網址：不適用 地址：不適用		
信用評等機構：不適用			電話：不適用 網址：不適用 地址：不適用		
評等標的	發行公司：不適用		無□ ； 有□，評等日期：		評等等級：
	本次發行公司債：不適用		無□ ； 有□，評等日期：		評等等級：
董事選任日期：民國 110 年 7 月，任期：3 年			監察人選任日期：不適用		
全體董事持股比例：6.57%（民國 112 年 11 月 30 日）			全體監察人持股比率：不適用		
董事、監察人及持股超過 10%股東及其持股比例：（民國 112 年 11 月 30 日）					
職 稱	姓 名	持 股 比 例	備 註		
董事長	劉德音	0.05%			
副董事長	魏哲家	0.02%			
董事	龔明鑫	6.38%	行政院國家發展基金管理會代表人		
董事	曾繁城	0.11%			
獨立董事	彼得・邦菲爵士	-			
獨立董事	陳國慈	-			
獨立董事	麥可・史賓林特	-			
獨立董事	摩西・蓋弗瑞洛夫	-			
獨立董事	海英俊	-			
獨立董事	拉斐爾・萊夫	-			
工廠地址：					
二廠、五廠		新竹科學園區園區三路121號		電話：(03)5636688	
三廠		新竹科學園區研新一路9號		電話：(03)5636688	
六廠		南部科學園區南科北路1號		電話：(06)5056688	
八廠		新竹科學園區力行路25號		電話：(03)5636688	
十二A廠		新竹科學園區力行六路8號		電話：(03)5636688	
十二B廠		新竹科學園區園區二路168號		電話：(03)5636688	
十四A廠		南部科學園區南科北路1號之1		電話：(06)5056688	
十四B廠		南部科學園區南科九路17號		電話：(06)5056688	
十五 A 廠		中部科學園區科雅六路 1 號		電話：(04)27026688	
十五 B 廠		中部科學園區新科路 1 號		電話：(04)27026688	
十八 A 廠		南部科學園區北園二路 8 號		電話：(06)5056688	
十八 B 廠		南部科學園區北園二路 8 號		電話：(06)5056688	
先進封測一廠		新竹科學園區研新二路 6 號		電話：(03)5636688	
先進封測二廠		南部科學園區三抱竹路 1 號		電話：(06)5056688	
先進封測三廠		桃園市龍潭區龍園六路 101 號		電話：(03)5636688	
先進封測五廠		中部科學園區科雅西路 5 號		電話：(04)27026688	
先進封測六廠		苗栗縣竹南鎮科專一路 1 號		電話：(03)5636688	

主要產品：積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計及光罩製造等代工業務		市場結構(民國 111 年)： 內銷 10%、外銷 90%	參閱本文之頁次 第 39 頁
風 險 事 項	詳本公開說明書公司概況之風險事項		參閱本文之頁次 第 5 頁至第 20 頁
去 (1 1 1) 年 度	營業收入：新台幣 2,263,891,292 仟元；新台幣稅前純益：1,144,190,718 仟元；每股盈餘：新台幣 39.20 元		第 119 頁至第 121 頁
本次募集發行有價證券種類及金額	見公開說明書封面		
發 行 條 件	見公開說明書封面		
募 集 資 金 用 途 及 預 計 產 生 效 益 概 述	不適用		
本次公開說明書刊印日期：民國 112 年 12 月 28 日		刊印目的：發行民國一百一十二年度限制員工權利新股	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄			

台灣積體電路製造股份有限公司
公開說明書目錄

目錄

壹、 公司概况	1
一、 公司簡介	1
(一) 設立日期	1
(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話	1
(三) 公司沿革	3
二、 風險事項	5
(一) 風險因素	5
(二) 訴訟或非訟事件	19
(三) 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生財務週轉困難或喪失債信情事	20
(四) 其他重要事項	20
三、 公司組織	21
(一) 關係企業圖	21
(二) 董事	24
四、 資本及股份	35
(一) 股本形成經過	35
(二) 最近股權分散情形	35
(三) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	36
(四) 員工分紅及董事、監察人酬勞	37
貳、 營運概況	39
一、 公司經營	39
(一) 業務內容	39
(二) 市場及產銷概況	49
二、 轉投資事業	55
(一) 轉投資事業概況	55
(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權情形	58
三、 重要契約	59
參、 發行計畫及執行情形	60
一、 本次發行限制員工權利新股應記載事項	60

(一) 資金來源.....	60
(二) 本次發行限制員工權利新股發行及認股辦法.....	60
二、 本次受讓他公司股份發行新股應記載事項	60
三、 本次併購發行新股應記載事項.....	60
肆、 財務概況.....	61
一、 財務分析.....	61
(一) 台積公司及子公司財務分析	61
(二) 台積公司財務分析.....	62
二、 財務報告應記載事項.....	63
(一) 最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告。 ...	63
(二) 最近二年度經會計師查核簽證之年度個體財務報告	64
(三) 申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告	64
三、 財務概況應記載事項.....	64
四、 財務狀況及經營結果檢討分析.....	64
(一) 財務狀況.....	64
(二) 財務績效.....	66
(三) 現金流量.....	68
(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	69
(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	69
(六) 其他重要事項：無。	69
伍、 特別記載事項	70
一、 委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形.....	70
二、 委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告	70
三、 證券承銷商評估總結意見	70
四、 律師法律意見書	70
五、 由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見	70
六、 本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應補充揭露之事項	70
七、 最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者.....	70
八、 證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書。	70

九、	發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書。	70
十、	公司治理運作情形	70
(一)	董事會運作情形	70
(二)	審計暨風險委員會運作情形	72
(三)	薪酬暨人才發展委員會組成及運作情形	75
(四)	提名及公司治理暨永續委員會組成及運作情形	76
(五)	公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	78
(六)	推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	83
(七)	履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	87
(八)	公司訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式	91
(九)	最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總	91
(十)	其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊	91

壹、公司概況

一、公司簡介

(一) 設立日期

民國76年2月21日

(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話

公司總部及晶圓十二A廠

300-096新竹科學園區力行六路8號

電話：+886-3-5636688

研發中心及晶圓十二B廠

300-091新竹科學園區園區二路168號

電話：+886-3-5636688

晶圓二廠、五廠

300-096新竹科學園區園區三路121號

電話：+886-3-5636688

晶圓三廠

300-092新竹科學園區研新一路9號

電話：+886-3-5636688

晶圓六廠

741-014南部科學園區南科北路1號

電話：+886-6-5056688

晶圓八廠

300-094新竹科學園區力行路25號

電話：+886-3-5636688

晶圓十四A廠

741-014南部科學園區南科北路1號之1

電話：+886-6-5056688

晶圓十四B廠

741-014南部科學園區南科九路17號

電話：+886-6-5056688

晶圓十五A廠

428-303中部科學園區科雅六路1號

電話：+886-4-27026688

晶圓十五B廠

428-015中部科學園區新科路1號

電話：+886-4-27026688

晶圓十八A廠

745-093南部科學園區北園二路8號

電話：+886-6-5056688

晶圓十八B廠
745-093南部科學園區北園二路8號
電話：+886-6-5056688

先進封測一廠
300-077新竹科學園區研新二路6號
電話：+886-3-5636688

先進封測二廠
741-013南部科學園區三抱竹路1號
電話：+886-6-5056688

先進封測三廠
325-002桃園市龍潭區龍園六路101號
電話：+886-3-5636688

先進封測五廠
428-303中部科學園區科雅西路5號
電話：+886-4-27026688

先進封測六廠
350-012苗栗縣竹南鎮科專一路1號
電話：+886-3-5636688

采鈺科技股份有限公司
300-096新竹科學園區篤行一路12號
電話：+886-3-6668788

台積電（中國）有限公司
上海市松江區文翔路4000號
郵政編碼：201616
電話：+86-21-57768000

台積電（南京）有限公司
江蘇省南京市浦口經濟開發區紫峰路16號
郵政編碼：211806
電話：+86-25-57668000

台積電韓國有限會社
Rm 2104-2105 west, Hanshin Inter Valley 24 Building, 322,
Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06211, Korea
電話：+82-2-20511688

TSMC Japan Limited
21F, Queen's Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku,
Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan
電話：+81-45-6820670

TSMC Design Technology Japan, Inc.
10F, Minatomirai Grand Central Tower, 4-6-2, Minatomirai,
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-0012, Japan
電話：+81-45-6644500

TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.
2F, 7D Bldg., West, 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki,
305-8569, Japan
電話：+81-29-893-2968

Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.
6F, Shimotori NS Building 1-3-8 Shimotori, Chuo-ku,
Kumamoto-shi, Kumamoto 860-0807, Japan

TSMC Europe B.V.
World Trade Center, Zuidplein 60, 1077 XV Amsterdam,
The Netherlands
電話：+31-20-3059900

TSMC Design Technology Canada Inc.
1000 Innovation Drive, Suite 400, Kanata, ON K2K 3E7, Canada
電話：+613-576-1990

TSMC North America
2851 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.
電話：+1-408-3828000

TSMC Technology, Inc.
2851 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.
電話：+1-408-3828000

TSMC Washiongton, LLC
5509 N.W. Parker Street, Camas, WA 98607-9299, U.S.A.
電話：+1-360-8173000

TSMC Arizona Corporation
5088 W. Innovation Circle, Phoenix, AZ 85083, U.S.A.
電話：+1-602-567-1688

(三) 公司沿革

民國七十六年，台積公司成立於台灣新竹科學園區，並開創了專業積體電路製造服務商業模式。台積公司專注於生產由客戶所設計的晶片，本身並不設計、生產或銷售自有品牌產品，確保絕不與客戶競爭。基於這個創始的原則，台積公司成功的關鍵就在於協助客戶獲得成功。台積公司的專業積體電路製造服務商業模式造就了全球無晶圓廠 IC 設計產業的崛起。自創立以來，台積公司一直是世界領先的專業積體電路製造服務公司，單單在民國一百一十一年，台積公司就以 288 種製程技術，為 532 個客戶生產 1 萬 2,698 種不同產品。

台積公司的眾多客戶遍布全球，為客戶生產的晶片廣泛地被運用在各種終端市場，例如高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品等。如此多樣化的晶片生產有助於緩和需求的波動性，使公司得以維持高產能利用率及獲利率，以及穩健的投資報酬以因應未來的投資。

民國一百一十一年，台積公司及其子公司所擁有及管理的年產能超過 1,500 萬片十二吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有四座十二吋超大晶圓廠（GIGAFAB[®] Facilities）、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有一家百分之百持有之海外子公司—台積電（南京）有限公司之十二吋晶圓廠、及二家百分之百持有之海外子公司—TSMC Washington, LLC（原 WaferTech, LLC）、台積電（中國）

有限公司之八吋晶圓廠的產能支援。

民國一百一十一年十二月，台積公司宣布其亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計於民國一百一十五年開始生產 3 奈米製程技術，此外該廠目前興建中的第一期工程預計於民國一百一十四年開始生產 4 奈米製程技術，兩期工程總投資金額約為 400 億美元。兩期工程完工後將合計年產超過 60 萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過 400 億美元。同時，台積公司持續執行其於日本熊本縣設立晶圓廠的計畫，並將於民國一百一十三年開始生產。

台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸以及南韓等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務與技術服務。目前，台積公司及其子公司員工總數超過 7 萬 3,000 人。

台積公司股票在台灣證券交易所上市，股票代碼為 2330，另有美國存託憑證在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代號為 TSM。

1、歷史沿革、廠房擴充與技術推出

民國七十六年公司初創之時，向工研院租用一座六吋晶圓廠，成為當初台積公司晶圓一廠；民國七十七年，台積公司於美國設立北美子公司；民國七十九年，晶圓二廠開始量產；民國八十三年，台積公司於荷蘭設立歐洲子公司，同年台積公司普通股股票於台灣證券交易所掛牌上市；民國八十四年，台積公司首座八吋廠—晶圓三廠開始量產；民國八十五年，全美第一家專業積體電路製造服務公司 WaferTech, LLC 於美國華盛頓州成立，擁有一座 8 吋晶圓廠（晶圓十一廠）；民國八十六年，美國存託憑證於紐約證券交易所掛牌上市，同年晶圓四廠、五廠開始量產，並設立日本子公司；民國八十七年，晶圓八廠及晶圓十一廠開始量產；民國八十九年，台積公司首座位於台南科學園區的晶圓廠—晶圓六廠開始量產，同年順利完成合併德基半導體公司及世大積體電路；民國九十年，首座全規模十二吋晶圓廠—晶圓十二廠開始量產；民國九十二年，台積電（中國）有限公司設立；民國九十三年，台積電（中國）有限公司開始量產，同年晶圓十四廠開始量產；民國一百零一年，晶圓十五廠開始量產；民國一百零五年，台積電（南京）有限公司設立，擁有一座 12 吋晶圓廠（晶圓十六廠）及一設計服務中心；民國一百零七年，晶圓十六廠開始量產；民國一百零八年，核准設立 TSMC Design Technology Japan, Inc.；民國一百零九年，晶圓十八廠開始量產，同時宣布將於美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，採用 5 奈米製程技術生產晶片；民國一百一十年，宣布將於高雄設立生產 7 奈米及 28 奈米製程之晶圓廠，並核准於日本投資設立 TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc. 及 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.；民國一百一十一年，宣佈與索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation, SSS）及電裝株式會社（DENSO Corporation）共同合資設立 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM），於同年底亦宣布亞利桑那州晶圓廠第二期工程動工，將採用 3 奈米製程技術進行生產；民國一百一十二年，先進封測六廠與全球研發中心正式啟用，同年宣布與羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH），並於同年十二月宣布將 WaferTech 更名為 TSMC

Washington，呼應台積公司全球拓展策略之一，為所有子公司建立一致的企業識別。

台積公司定期進行市場長期需求預測，對產能作整體之規劃，以符合市場對其產品與服務的需求。關於台積公司之技術推出，詳本公開說明書貳、一、(一)、3、技術及研發概況。

2、最近五年度及截至公開說明書刊印日止經營權之改變

台積公司創辦人張忠謀博士領導公司超過三十一年，於民國一百零七年六月五日的股東大會之後退休，台積公司股東於會中完成新一屆董事改選，隨後並召開董事會推舉劉德音博士擔任董事長，魏哲家博士擔任總裁暨副董事長，依據公司的傳承計畫，完成了責任的薪傳。

3、最近五年度及截至公開說明書刊印日止董事或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換：無。

二、風險事項

(一) 風險因素

1、經濟風險之影響及因應措施

任何未來系統性的政治、經濟或金融危機或市場波動，包括但不僅限於利率和匯率變動、通貨膨脹或通貨緊縮以及主要經濟體的經濟、財政和貨幣政策的變化，都可能造成半導體產業整體之營收及獲利大幅下降，且若經濟狀況或台積公司之客戶之財務狀況惡化，台積公司之產品及服務需求可能減少，且可能需提撥額外之會計準備，進而減少台積公司之營業利益及淨利。舉例來說，從 2023 年 3 月開始，資本和信貸市場受矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和 Signature Bank 的倒閉以及瑞士銀行集團（UBS）宣布收購瑞士信貸集團（Credit Suisse）影響而動盪。市場對銀行體系穩健性的擔憂可能會導致中小型銀行收緊貸款活動以保持其流動性，進而可能對經濟成長造成壓力。如果資本和信貸市場波動和混亂持續或擴大為系統性金融危機或全球經濟衰退，則可能對台積公司的業務造成不利的後續影響，包括客戶需求減少、應收帳款付款延遲，或供應商或客戶破產等。

■ 利率變動

台積公司的利率風險主要來自於其投資部位及金融債務。利率變動會影響公司現金及約當現金暨固定收益證券所產生的利息收入、固定收益證券的公允價值，以及金融債務所需支付的利息費用。

台積公司的投資政策目的是在保障本金及支持流動性的前提下追求收益。一般而言，該政策要求須投資於投資等級之證券，且對單一發行人設定信用曝險金額之上限。台積公司的固定收益投資大部分為固定利率證券，且被分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量及按攤銷後成本衡量之金融資產。分類為透過其它綜合損益按公允價值衡量之金融資產，其公允價值可能因為利率上揚而走低，但分類為按攤銷後成本衡量之金融資產，其帳面金額不會因為利率變動而改變。此外，若利率下跌，現金及約當現金之利息收入可能較預期為低。

台積公司已經且未來亦可能透過利率衍生性商品來規避部分固定收益投資及預期發行之債務的利率風險，但此避險操作僅能降低少部分因利率波動造成的財務影響。

民國一百一十一年及截至公開說明書刊印日止，台積公司大部分的金融

債務皆為固定利率且以攤銷後成本衡量，故利率變動不會影響其未來現金流量或帳面金額。

■ 匯率變動

台積公司大部分營收皆以美元計價，且超過一半以上的資本支出及股權投資係以非新台幣支付，主要為美元、歐元以及日幣。因此，新台幣對這些貨幣的任何重大不利波動，尤其是美元對新台幣走弱，對台積公司以新台幣表達之營收及獲利可能造成顯著不利影響。舉例來說，根據台積公司民國一百一十一年的營運結果，美元對新台幣每貶值1%，會造成台積公司的營業利益率下降0.4個百分點。

相反地，當美元相對其他主要貨幣大幅升值時，對台積公司的客戶及台積公司本身所提供之產品和服務需求可能會降低，並因此對台積公司的營收造成不利影響。

台積公司使用外幣衍生性金融商品合約及非衍生性金融工具，包括遠期外匯合約、外匯交換合約及外幣借款等，來規避非新台幣計價之貨幣性資產及負債、部份預期交易以及國外營運機構淨投資可能產生之匯率風險。這些避險可減少資產及負債受匯率變動的影響，但無法完全消除。

此外，新台幣對美元的匯率變化也可能會對台積公司普通股股價轉換成美元之價值、美國存託憑證之股價及新台幣現金股利轉換成美元後之價值產生影響。

■ 通貨膨脹

台積公司的通貨膨脹風險主要來自原物料成本、薪資及員工福利成本費用以及建廠相關成本的上漲。雖然通貨膨脹之影響並未對台積公司之財務狀況及營運成果造成重大影響，然若通貨膨脹持續升溫，而台積公司的產品與服務之銷售價格未有與成本相對應之上漲，則可能會對台積公司的獲利產生不利影響。

2、從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

民國一百一十一年及截至公開說明書刊印日止，台積公司並未從事高風險／高槓桿的財務投資；台積公司所從事的衍生性金融商品交易均以避險為目的，而非交易或投機性之操作；台積公司及本公司之子公司所從事之背書保證與資金貸與均提供予本公司及／或本公司百分之百持有之子公司，這些背書保證與資金貸與均符合相關法令，並依相關規定辦理。

為了控管財務交易風險，台積公司已依據金融監督管理委員會的相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運管理為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」以及「背書保證作業程序」。

3、未來研發計畫及預計投入之研發費用

為保持公司的技術領先地位，台積公司計畫持續大量投資研發。在台積公司3奈米及2奈米先進CMOS邏輯技術持續進展時，台積公司的前瞻研發工作將聚焦於2奈米以下的技術、三維電晶體、新記憶體，以及低電阻導線等領域，為未來技術平台建立堅實的基礎。台積公司的TSMC 3DFabric™先進封

裝研發，正在開發子系統整合的創新，以進一步增強先進的 CMOS 邏輯應用。公司繼續聚焦於新的特殊製程技術，例如用於 5G 及智能物聯網應用的射頻及三維智能感測器。台積公司先進研究持續開發可在未來十年及更長時間可能採用的新材料、製程、元件和記憶體。台積公司也持續與學術界和產業聯盟等外部研究機構合作，旨在為客戶儘早了解和採用未來具有成本效益的技術和製造解決方案。憑藉著高度稱職及專注的研發團隊及其對創新的堅定承諾，台積公司有信心能夠透過提供客戶有競爭力的半導體技術，推動未來業務的成長和獲利。

台積公司未來主要研發計畫摘要

計畫名稱	計畫內容
3 奈米邏輯技術平台應用	支援系統單晶片技術的三維 CMOS 製程技術平台
2 奈米以下邏輯技術平台應用	支援系統單晶片技術的三維 CMOS 製程技術平台
三維積體電路	因應三維積體電路（3DIC）整合趨勢，開發更具成本效益及更具尺寸、效能優勢的解決方案
下一世代的微影技術	發展下一世代極紫外光及相關曝光技術以延伸摩爾定律
長期研究	特殊系統單晶片技術（包括新型非揮發性記憶體、微機電、射頻、類比晶片）及未來八至十年的電晶體技術
以上計畫之研發經費約占民國 112 年總研發預算之 80%，而總研發預算預估約占民國 112 年全年營收的 8%。	

4、國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

台積公司經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司財務及業務的國內外政策與法令，並訂定相關風險管理程序。民國一百一十一年及截至公開說明書刊印日止，與本公司營運有關之重要法令變動如下：

台積公司產品的製造、組裝及測試要求使用的化學品和材料須符合國際頒布的環境、氣候相關、健康及安全法律法規以及國際協議例如「巴黎協定」。由於氣候變遷相關的法律或法規目前過於不確定，本公司無法合理確定的評估對我們未來財務狀況的影響。民國一百零四年七月一日生效的台灣「溫室氣體減排與管理法」修訂更名為「氣候變遷因應法」，此項修訂於民國一百一十二年二月生效，設定民國一百三十九年台灣實現淨零排放的目標，並建立了碳費制度。對直接和間接排放量達到一定閾值的排放者徵收碳費。碳費制度預計將於民國一百一十三年生效，有關部門尚未確定此費用的費率。如果我們的排放量超過碳費制度規定的適用閾值，我們可能需要支付任何產生的碳費，而可能導致我們營運成本增加，並在一定程度上影響我們的財務。我們預期未來立法單位將訂定更多相關法令。此外，中華民國立法機構隨時審視各種環境問題，以制定與環境保護和氣候變遷相關的法律和法規。此類法律法規以及碳費的影響目前尚無法確定。

其他相關政策及法令的變化對台積公司的財務業務尚不會造成重大影響。

5、科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

■ 產業發展

電子產業與半導體市場一向深受景氣循環、產品需求快速變化的重大影響，這樣的市場特性也對台積公司所在的積體電路製造服務業產生影響，因此台積公司的營收與獲利也可能受到客戶下單波動的影響。

電子產業與半導體產業不時面臨重大且持續不景氣及產能過剩的情況，台積公司目前及未來業務需求皆取決於電子產品及半導體公司的需求，上述產業不景氣及產能過剩的情況將導致整體半導體製造服務業及台積公司的業務需求下降。如果台積公司不能透過降低成本或其他措施來有效抵銷需求下降的影響，在不景氣及產能過剩期間，公司營收、利潤與獲利率均會受到衝擊。

■ 技術變革

因應半導體產業與其技術的不斷變化，台積公司的競爭利器為持續開發更先進製程技術，以及製造功能更多的產品。此外，台積公司也持續開發新的衍生技術。倘若台積公司無法洞察技術的改變並迅速發展創新技術，或遇到競爭者無預期地取得其他的技術，台積公司將可能無法以具競爭力的條件提供積體電路製造服務。此外，台積公司的客戶已大幅縮短其產品或服務的上市時間，如果台積公司無法達到縮短產品上市時間的要求，可能將面臨失去這些客戶的風險。由於智慧型手機等消費電子產品已經改變全球電子產業的發展方向，加上競爭越來越激烈以及客戶集中度增高等因素，前述這些風險的影響強度已然增加（有關這些風險之詳細描述，請參閱本章節相關段落）。

此外，伴隨先進製程技術而來的不確定性與不穩定性，也對達成預期的產品品質與良率帶來挑戰。如果台積公司無法維持品質，可能導致營收損失與增加額外成本，以及造成業務損失或喪失客戶信任。如果台積公司無法克服上述挑戰，公司的競爭力可能降低，且營收將可能大幅衰退。

有關上述風險之因應措施，請參閱本公開說明書貳、一、(二)市場及產銷概況說明。

■ 資訊技術安全

台積公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，但無法保證其控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免嚴重的網路攻擊。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，台積公司的系統可能會失去公司重要的資料，生產線也可能因此停擺。重大網路攻擊還可能導致營業秘密和其他機密資訊的丟失或洩露，例如我們客戶和其他利害關係人的專有資訊以及我們員工的個人資料。台積公司透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。

惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入台積公司的網路系統，以干擾公司的營運、對台積公司進行勒索、取得電腦系統控制權、窺探公司機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單

而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以進一步加強公司的網路安全系統；也可能使台積公司因涉入此類違規行為相關的法律訴訟或監管調查，而承擔重大法律責任。台積公司過去曾經因遭受惡意軟體帶來的攻擊，未來也可能面臨類似的攻擊。為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，台積公司落實及持續更新嚴謹的資安措施，例如建置先進的可攜式病毒掃描工具並協助新進機台（含機台內網電腦）掃毒以保護晶圓廠設備、強化超大晶圓廠網路架構與網路控管以防止電腦病毒跨機台及跨廠區擴散、在公司重要的電腦上建置防毒措施及先進的惡意行為偵測解決方案、導入新技術加強資料保護、實施辦公室電腦資安合規驗證與管控、建立雲端防護盾阻隔來自外部網路的攻擊，包括新的連網架構來保護網際網路存取、採用先進的技術防範分散式阻斷服務攻擊、加強釣魚郵件偵測並定期執行員工警覺性測試、強化雲端系統及外部網站資安政策與框架、建立一個整合的自動化資安維運平台並強化資安事件偵測與處理自動化、強化內部安全評估自動化、進行外部紅隊測試、演練勒索軟體攻擊之處理程序。此外，為降低供應鏈風險，與主要供應商協同合作，協助供應商改善資訊安全成熟度，執行供應商資安現場查核，定期或即時分享產業界資安事件及最佳解決方案。另外，台積公司與國際半導體產業協會（SEMI）合作成立半導體資安委員會，推廣半導體設備安全標準（SEMI E187）以及資安評鑑服務，幫助提升半導體供應鏈的韌性，獲頒 2023 SEMI 國際標準貢獻獎。雖然台積公司持續加強資訊安全防護措施，但仍無法保證公司免於網路攻擊。

此外，台積公司需要分享高度敏感及機密的資訊給部分其雇用提供台積公司及其全球關係企業服務的第三方廠商，以使其能提供相關服務。儘管台積公司在和第三方服務廠商簽訂之服務合約中，要求嚴格遵守保密及／或網路安全規定，但不能保證每個第三方服務廠商都將嚴守這些義務。而且，上述服務廠商亦會有遭受網路攻擊的風險。若台積公司或其服務廠商無法及時解決這些網路攻擊所造成的技術性問題、或確保台積公司（及屬於本公司客戶或其他第三方）的數據完整性及可用性，或維持控制住公司或其服務廠商的電腦系統，皆可能嚴重損及台積公司對客戶和其他利害關係人的承諾，而公司營運成果、財務狀況、前景及聲譽亦可能因此遭受重大不利影響。

6、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

台積公司以「誠信正直、承諾、創新、客戶信任」的核心價值建立了良好的企業形象。公司的正面形象也體現了卓越的經營、嚴謹的公司治理，以及良好企業公民的永續責任，台積公司持續在經濟、環境和社會面向追求創新。

截至公開說明書刊印日止，台積公司在營運發展、公司治理、專利成果、獲利成長、投資人關係、環境保護、企業永續等方面屢獲殊榮，包括連續第 23 年獲選為「道瓊永續世界指數」的組成企業、天下雜誌首設之 2023「天下人才永續獎」、台灣永續能源研究基金會「2023 TCSA 台灣企業永續獎」台灣十大永續典範企業獎首獎、年度最佳報告書獎、氣候領袖獎、循環經濟領袖獎、永續供應鏈領袖獎、水資源管理領袖獎、創新成長領袖獎、資訊安全領袖獎；證交所「公司治理評鑑」前 5% 公司、財富雜誌「2023 全球最受推崇

企業」之一、「全球 500 大企業」、企業騎士及 As You Sow 發布之「2023 清淨低碳全球 200 大企業」、商業周刊「碳競爭力百強」、MSCI「全球 ESG 領導者指數」成分股等肯定。

台積公司落實永續營運，民國一百一十二年，由董事長劉德音博士擔任主席的「ESG 指導委員會」舉行第四屆「TSMC ESG AWARD」，表彰公司內部組織呼應 ESG 五大方向（包括綠色製造、建立責任供應鏈、打造多元包容職場、培育人才、關懷弱勢）並落實 ESG 行動方案於日常業務中，同時，鼓勵員工提出永續層面的創新思維，透過評估員工提案之可行性，台積公司導入資源、付諸實現，把握驅動正向改變的機會。相較於第三屆的 1,880 件永續提案，第四屆共計收到 3,166 個創新點子，為公司創新的永續文化挹注源源動能。

此外，台積公司針對可能影響公司形象的潛在風險，如地震、火災、資訊系統服務中斷、良率損失、資訊安全、供應鏈中斷、傳染病大流行、環保事件或水電供應中斷等事件採取多項預防措施，依照危機事件訂定危機管理程序及復原計畫，並制定「台積公司中央危機指揮中心內控作業流程」及「台積公司緊急應變程序」，建立緊急事件指揮系統，台積公司亦定期執行危機情境演習，確認危機管理程序完備且經驗證。截至公開說明書刊印日止，台積公司持續獲 Sustainalytics「ESG 風險評比」評為低永續風險公司。

台積公司每月均召開「環保、安全與衛生技術委員會」會議，整合各廠區相關單位進行緊急應變演習以持續改善通報及運作程序，確保危機發生時與利害關係人的溝通管道暢通，並由企業公共關係處統一擔任對外發言代表。

一旦上述危機發生，各部門除能於第一時間啟動緊急應變措施，免除或降低意外事件對人員的生命安全、周遭環境、公司財產及營運業務之影響，並將同時通知企業公共關係處，以清楚一致地進行外部溝通。

7、進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

民國一百一十一年及截至公開說明書刊印日止，台積公司並未進行任何併購。

8、產能擴充之可能風險及因應措施

台積公司針對其產品與服務，定期進行市場長期需求預測，以對產能作整體之規劃。依據市場需求預測，公司近期持續擴充產能以符合市場對其產品與服務的需求，包括於台灣、美國亞利桑那州、中國南京市、日本熊本縣以及德國德勒斯登。

實施這些產能擴充計畫會造成營運成本增加，且其增加幅度可能很大。例如公司需要建置新設施、添購機器設備、擴充及訓練人員以操作新機器設備，如果台積公司無法相對地提高收益，這些成本的增加將對其財務表現產生負面的影響。

此外，因需求預測會隨著市場環境的動態變化而隨時發生顯著的改變，當需求減少時，台積公司會暫停或停止部分廠區的生產線或機台運作；而當後續需求在短時間內快速增加時，台積公司可能會無法即時地恢復產能來把握住景氣好轉時的所有需求。在這種情況之下，其財務業績和競爭力可能會受到

不利影響。

因應上述產能擴充之可能風險，台積公司會持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，若市場需求不如預期時，公司會及時地調整其產能計畫，以降低對於公司財務表現的負面影響。

9、新建廠之可能風險

台積公司目前正在進行多個擴建計畫，包括在全球的新建廠設計及興建工程，而全球性擴廠將對管理、財務及其他資源有相當程度的需求。台積公司預期在全球性擴廠和營運方面面臨一定的挑戰，其中包含但不限於：

- 擴廠計畫造成的成本增加、於多個海外據點建立各類原物料之供應鏈、對台積公司能維持現有生產力及製造效率的影響，因為在台灣有晶圓廠、員工及供應商連結組成的生態系統的支持，以及多個海外營運據點之人才吸引及留任；
- 工人短缺、材料供應鏈中斷以及興建工程問題皆可能使建廠時程受到延宕，可能進一步令台積公司承擔大幅增加的成本以及無法達成原訂產能擴充計畫；
- 天然或人為災害，例如地震、水災、颱風、乾旱、海嘯、沙塵暴、野火、火山爆發、火災、氣體/化學品洩漏、流行病、網路攻擊、惡意破壞、關鍵設施及設備故障失效、水/電/天然氣等公用設施供應短缺等事件，可能造成台積公司的營運中斷；
- 台積公司未來的產能擴充計畫可能受限於工業用地的不足而無法充分執行；
- 外國法規之遵循，以及台積公司因未遵循相關法規而遭受罰則之風險；
- 管理多個營運據點之不同資訊技術基礎架構，以及遭受第三方網路攻擊之風險；
- 政府補助及其他獎勵計畫出現對台積公司不利之改變；
- 工作文化差異，以及能否有效管理人數不斷成長且地理距離分布廣泛之員工；
- 有限或不足的智慧財產權保護，或台積公司主張智慧財產權之困難；及
- 營運所在地之各國稅務法規帶來潛在的不利影響。

若台積公司無法克服上述挑戰，則可能對公司業務、財務狀況及經營結果造成負面影響。

10、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

■ 採購集中的風險及因應措施

➤ 原物料

台積公司需及時並以合理的市場價格獲得生產營運所需之足夠原物料，例如矽晶圓、製程用氣體、化學原料、光阻劑等。過去曾發生特定供應商或半導體業的原物料短缺狀況，導致業界短暫的價格調整與交期延誤。此外，原物料產地發生重大天災、貿易壁壘、政治或經濟動盪（包括軍事衝突），以及通貨膨脹問題也可能會嚴重影響供應或

調漲價格。由於部分台積公司所採購的原物料是由單一廠商所供應，可能會出現供貨無法滿足需求或無法及時找到替代來源的風險。進口和國內生產限制也可能影響台積公司獲得充足原材料供應與其品質。此外，近期貿易緊張局勢可能導致價格上漲，甚至因關稅、出口管制或其他非關稅壁壘而導致原物料無法供應。如果台積公司無法適時取得充足且必要的原物料或是原物料價格顯著上漲，台積公司的營收可能會因此而下降。為降低供應鏈風險與有效管理成本，台積公司除致力開發新供應商外，亦持續鼓勵供應商透過分散生產廠區，降低供應鏈風險，並將生產廠區自高成本地區移至台灣，以提高成本競爭力。

鑒於找到合格的備援供應商不易，台積公司已及早與主要供應商就原物料品質與產能管理進行廣泛磋商，為任何意外的增產或減產需求做好準備，以避免公司缺乏足夠時間重新安排其生產製程的情況發生。在先進製程上，台積公司不但擁有世界級的製程與廠房設備，也需要有世界等級的高品質原物料。為了有效管理供應鏈風險，台積公司增加對供應商的拜會並進行現場稽核，以將供應鏈最佳實踐延伸至上游供應鏈。此外，因應新產品產能的變動，台積公司持續改善庫存監控系統，提高需求預測的準確度，以確保供應鏈維持足夠庫存水位。台積公司訂定了一套供應鏈風險評估，要求關鍵供應商在勞工、道德、環境、安全與衛生及持續營運計畫方面必須符合標準。為使供應商充分對其供應鏈負責，台積公司會定期現場稽核，對於違反法規或造成環境影響以及永續績效不符台積公司要求者，可能會減少或終止合作關係。

➤設備

台積公司的營運成長及全球產能的持續擴充計畫，仰賴來自市場中少數的供應商以得到充分的設備及相關服務，因此可能面臨供應商供給有限且交貨期長的情況，為了優化供應鏈管理，台積公司針對交貨前置期進行評估及預測，以期能夠盡量降低供應鏈風險對營運成本的影響，並與各供應商持續擬定多項商務合作模式與風險控管應變措施，以縮短機台的採購前置期，而為了因應全球性的業務擴展，台積公司亦加強對當地法規政策及供應鏈風險的了解。若台積公司無法及時取得所需設備與相關零組件，將影響台積公司執行產能擴充計畫和即時掌握高度時間敏感性的商機。此外，持續的貿易緊張或其他不可抗力之因素將可能導致台積公司無法及時取得關鍵機台與零組件，其中包括出口許可證延遲給予或被拒絕，以及額外出口管控措施或其他的關稅、非關稅壁壘等，若台積公司無法以合理價格及時取得所需設備以滿足客戶對技術及產品產能的需求，將可能對財務及營運造成負面影響。

■ 銷售集中之可能風險及因應措施

近年來，台積公司的客戶群與客戶的業務性質出現顯著變化。儘管台積公司在全球各地擁有數百位客戶，但來自前十大客戶的營業收入淨額，在民國一百零九年、一百一十年，與一百一十一年，各約占公司當年營業收入淨額的74%、71%及68%。台積公司最大客戶占台積公司民國一百零九年、一百一十年，與一百一十一年當年營業收入淨額各為25%、26%

及23%。台積公司第二大客戶占台積公司民國一百零九年及一百一十年當年營業收入淨額各為12%及10%。民國一百一十一年，台積公司第二大客戶占台積公司營業收入淨額未達10%。

較集中的客戶群將使得台積公司收入淨額受到大客戶季節性需求變化的影響，並且導致台積公司營運產生不同的季節性模式。客戶集中度的產生，部分來自電子產業的結構性改變，轉由行動及高效能運算裝置及其內容相關的應用程式與軟體所主導的局面。

目前僅有少數客戶成功利用這個新的商業模式典範。同時，台積公司已觀察到客戶業務模式產生本質上的轉變，以因應此一新的商業模式典範。例如，更多的系統公司開發自己設計的半導體晶片並直接與積體電路製造服務公司合作，使得產品及服務能在多變的終端市場脫穎而出。

同時，由於全球半導體產業競爭日益激烈，有些台積公司客戶已經開始進行產業整併以保持競爭優勢。此一產業整併係以合併與收購的方式進行；如果有越多台積公司主要客戶進行整併，台積公司的客戶總數將會進一步減少。此外，針對台積公司特定主要客戶的法令限制，例如出口管控措施，亦可能影響台積公司為該等客戶提供產品的能力，或減少該等客戶對台積公司產品及服務的需求，因此影響該等客戶的營運。

倘若其中一位或多位主要客戶，因競爭壓力升高、產業整併、適用法令限制改變、產品設計、製造採購或委外製造的策略或做法改變、客戶存貨調節時間的影響、重要客戶經營模式的改變，而停止或顯著縮減採購規模，將可能對台積公司的營運與財務表現產生負面影響。

11、董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司影響、風險及因應措施：

台積公司現有股東所持有股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。

民國一百一十一年及截至公開說明書刊印日止，台積公司無持股超過10%之股東。

12、經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施

民國一百一十一年及截至公開說明書刊印日止，台積公司並無任何經營權改變的風險發生。

13、其他重要風險及因應措施：

■ 需求及平均售價下滑之風險

台積公司的營收主要來自在高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品等領域使用我們產品的客戶群。其中任何一項終端市場成長衰退或趨緩，都將導致對全球積體電路製造服務業的需求顯著下滑，對台積公司的產品與服務需求亦可能隨之降低，台積公司的營收便可能受到衝擊。同時，積體電路製造之廠房設備建置需要大量的投資，當廠房開始營運後，便成為整體營運成本中之大宗固定成本資產，因台積公司廠房設備多數屬於自有，這些占整體營運成本中顯著比例的固定成本並不會隨著客戶需求或產能利用率降低而減少，因此，當客戶需求下滑，台積公司的獲利率將會受到顯著影響。相反地，當產品需求

提升與產能利用率上升時，固定成本得以分攤在增加的產出上，將有助於台積電公司的獲利表現。此外，終端產品平均銷售價格持續下滑的趨勢，也勢將擠壓內裝零組件的價格；若終端產品平均售價繼續下滑，台積電公司所製造的零組件，其價格壓力也可能導致台積電公司營收、獲利率與利潤降低。

■ 競爭之風險

專業積體電路製造服務產業的競爭激烈，台積電公司不僅與其他積體電路製造服務業者競爭，也與一些整合元件製造商競爭。某些競爭者可能取得比台積電公司更先進的技術，而某些競爭者可能取得比台積電公司更大的財務或其他資源，例如可能取得來自政府直接或間接的補助、刺激經濟措施的資金或台積電公司可能無法取得的其他獎勵補助。美國、中國、歐洲、南韓和日本政府提供了廣泛多樣的獎勵計畫以促進其國內半導體產業之發展，例如美國在西元2022年發布的晶片與科學法案（the Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act of 2022, the “U.S. CHIPS Act”）即提供財務上的補貼及獎勵誘因以促進美國國內半導體產業的發展。雖然於某些台積電公司目前已經拓展或是計畫拓展產能的區域與國家中之政府已經擴大或是將來可能擴大對台積電公司的財務獎勵計畫，這並不保證台積電公司能於未來繼續申請或者獲得台積電公司期待的財務獎勵。此外，任何台積電公司所獲得的財務獎勵計畫都將視嚴格的情況而定，或者給予單位能尋求收回已經提供給台積電公司的資金，或者於未來取消、減少、否認我們要求的補貼或授予。這可能大幅度增加台積電公司的營運成本並造成營運結果的負面影響。

此外，台積電公司的競爭對手可能會不時對單一或多個製程採取積極的低價策略。競爭對手的這些競爭手段，可能導致台積電公司客戶群減少、平均售價降低或兩者皆具。如果台積電公司不能有效率地在技術、製造產能、產品品質與客戶滿意度方面與這些新進且積極的對手競爭，台積電公司將可能面臨流失客戶的風險。

■ 有關智慧財產權之風險

台積電公司得以成功地保持競爭優勢並持續成長，原因之一是不斷強化智慧財產權版圖。雖然台積電公司積極地主張及保護智慧財產權，但無法保證可以適當地防止專有技術、軟體、營業秘密或know-how等智財權利被侵害或不當使用。此外，當公司業務及營業模式拓展至新領域時，台積電公司無法保證可以獨立開發從事業務所需之技術、專利、軟體、營業秘密或know-how，或在不知情的狀況下，不會侵害到他人之智慧財產權。因此，台積電公司可能在某種程度上需倚賴他人的技術及專利授權。當倚賴他人授權時，台積電公司亦難保證未來能夠以合理條件取得任何或所有必須的授權。而當缺乏必須的授權時，台積電公司可能有被第三方主張侵權損害賠償責任甚或聲請法院禁制令的風險，以及客戶依合約請求及主張本公司負擔或賠償客戶因第三方侵權主張所遭受之損害。

台積電公司不定期會接獲包括非實施專利實體（Non-practicing Entities）及半導體公司等第三方的通知，主張本公司之技術、製程，或所製造之半導體產品之設計智財或客戶使用前述半導體產品有侵害他人專利或其他智慧財產權之虞。由於產業的本質、市場地位及擴大在海外的製造營運

使然，本公司未來可能會接獲更多上述通知。由好訟、資金充足之非實施專利實體所提出的專利訴訟或主張，對金錢上之請求以及向法院提出之禁制令聲請格外強烈。這些訴訟及主張可能會增加本公司的營運成本，如果這些專利主張實體成功阻攔本公司所提供的產品及服務之交易，亦可能會嚴重干擾本公司的營運。再者，隨著台積公司的製造營運擴大至部份國外區域，本公司就智慧財產權被侵害之風險管理亦面臨更高的挑戰。縱使本公司努力採取有力的措施以減輕在該等新區域內智慧財產權被侵害的風險，仍無法保證本公司所採取的保護措施足以避免所有潛在的他人侵權行為。

如果台積公司無法取得或維持特定的技術或智慧財產權的授權或未能防止本公司的智慧財產權被侵害，且因此發生相關訴訟時，可能：（一）導致台積公司無法製造特定產品、銷售特定服務，或使用特定技術；及（二）減弱本公司對因侵害本公司智慧財產權而獲益的競爭對手的競爭力，因此將減少本公司產生營收之機會。

台積公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益的可能損失。這些措施包括：策略性地取得某些特定半導體公司或其它科技公司的必要授權、即時取得源自台積公司內部及外部的智慧財產權，以對於台積公司的技術及業務進行防禦性及／或攻擊性的防護，以及積極抵禦浮濫的專利訴訟。

■ 招募人才之風險及因應措施

台積公司的成長仰賴管理階層、專業技術人員及其他專業人才的持續服務及貢獻。倘若公司因人員流失、人才短缺、人才挖角、移民管制或因市場對產品及服務的需求改變而失去人才，公司可能會因為無法及時招募到足夠的優秀人才而面臨業務受到嚴重影響的狀況。由於人才招募競爭激烈，台積公司亦可能面臨無法確保及時滿足內部人才需求的挑戰。

為了降低招募人才之風險，台積公司除了鼓勵職務輪調，落實在職訓練與認證制度，讓員工在實際工作場域學習並精進工作效能外，更打造多元招募管道，持續在台灣及海外招募，廣納多元化及頂尖的專業人才。同時，台積公司也強化產學合作，提早掌握優秀人才，以利未來能延攬人才加入。

■ 稅務法規變動或實施新稅法

於台積公司經營業務的國家或地區內，若現行稅務法規有進行修訂或實施新稅法的情形時，可能會對台積公司的獲利產生不利影響。

台積公司在世界各地經營與拓展業務，同時遵循各個營運據點所屬國家之稅法規定。由於主要的營運與製造活動是在台灣，所以台積公司主要是受到中華民國政府稅法之規範。民國105年頒佈的中華民國營利事業受控外國企業制度，自民國112年1月1日起實施。依據該法規，設立在低稅負司法管轄區的受控外國企業，其保留而未分配之部分利潤，將從台灣的母公司進行課稅。另一方面，中華民國的產業創新條例已完成修訂，自民國112年1月1日起生效，在國內進行技術創新且位居全球供應鏈領先地位的本國企業，在同一年度內，為研發先進製程而投入的研發支出可以申請25%的投資抵減，機械/設備採購可以申請5%的投資抵減。台積公

司預計將能適用此新的租稅優惠。此外，經濟合作暨發展組織（OECD）的稅基侵蝕與利潤轉移（BEPS）行動計畫，可能讓外國司法管轄區的稅法發生變動，進而增加台積電公司稅負的不確定性，並對經營成果產生不利影響。

為了控管此稅務風險，台積電公司一直密切注意任何可能影響公司財務的國內外政策與法令，同時訂定風險管理程序，蒐集資訊、分析潛在的稅務影響，並研擬因應對策。

■ 融資之風險

在市場不穩定時，台積電公司未必能以商業上合理的條件及時獲得足夠的融資。若此情形發生，且台積電公司又需透過融資以支應公司的資本需求時，則台積電公司可能被迫於獲得融資前削減、修改或是延遲產能擴充計畫。

■ 減損損失之風險及因應措施

依據Taiwan-IFRSs，當有資產減損之跡象發生時，公司必須針對其有形資產、使用權資產及無形資產進行減損評估。在符合某些條件之下，台積電公司必須認列減損損失。台積電公司目前無法預測未來發生資產減損的程度或時間，以及任何必須認列之資產減損是否將對台積電公司之稅後淨利產生重大不利之影響。

至於在任何時點進行減損損失之認定時，主要係以當時針對未來數年營運成果所做出的評估來判斷，因此減損損失較可能發生在營運成果已經出現衰退之期間。台積電公司減損評估及減損金額之認定方式請參閱本公司民國一百一十一年度財務報告中附註五「重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源」。

■ 天然及人為災害風險

台積電公司承諾透過營運持續管理標準，強化有效應變營運中斷風險的能力，以維持營運韌性。主要的天然或人為災害，例如地震、水災、颱風、乾旱、海嘯、沙塵暴、野火、火山爆發、火災、氣體/化學品洩漏、流行病、網路攻擊、惡意破壞、關鍵設施及設備故障失效、水/電/天然氣等供應短缺等事件，可能造成台積電公司的營運中斷。

台積電公司多數的生產據點、供應商、客戶以及半導體製造服務的上游供應商均位於易受到天然災害影響之區域，亦可能受到水、電供應短缺的衝擊，而對台積電公司營運造成影響。

因此，如果一次或多次天然災害導致台積電公司、其客戶或供應商的營運長期中斷，或台積電公司的任何工廠或供應商設施因危害性事件而造成損壞或停止營運，均可能會降低產能並導致重要客戶流失，並對台積電公司的營運及財務績效產生不利的重大影響。

為了因應氣候變遷加劇可能帶來的乾旱缺水風險，台積電公司除了廠區製程節水外，也自行建置工業再生水及配合政府民生再生水的供應，以減緩乾旱時的供水風險。台積電公司亦訂定營運持續計畫，包含節水措施、擴大備援水源及水車運補機制、壓力測試及演練等，以確保乾旱不影響營運生產。

受到電力供應商供電服務或同一電網其他用戶的影響，台積電公司偶爾會遭遇電力中斷、壓降或突波而影響生產。政府的能源政策可能進一步加劇供電短缺或中斷風險。若台積電公司的晶圓廠無法獲得可靠且不間斷的電力供應，滿足客戶訂單的能力將受到削弱。

諸類事件若持續較長的時間，台積電公司的營運與財務績效可能會受到重大不利影響。未來在台灣或其他地區的產能擴充也可能受限於水、電的短缺。

此外，各式不可抗力之因素，例如過去幾年的COVID-19疫情，可能對全球經濟造成影響，進而在不同層面對台積電公司的業務和營運績效產生不利影響，包括但不限於：（一）中斷台積電公司供應鏈，特別是設備與原物料的生產、物流及裝機人力；（二）客戶對特定產品需求的波動，導致產能規劃的不確定性，並影響台積電公司對客戶需求的滿足，可能導致傷害台積電公司與客戶業務及法律糾紛的風險；（三）由於工廠或辦公室被迫關閉或減產而導致台積電公司產品潛在的生產延遲。而後疫情時代終端消費性電子產品需求降溫的風險，亦可能導致對台積電公司產品及服務需求的減緩與降價壓力的上升。

台積電公司更進一步加強營運持續管理，包括定期風險評估與風險抵減，緊急狀況發生前，成立專案小組，針對緊急事件的衍生影響、替代解決方案進行分析，並提出緊急應變、危機溝通、復原計畫與預防措施，確保能將人員傷害、營運中斷及財務衝擊降至最低。為維持營運持續計畫的有效性，台積電公司定期檢視營運持續計畫並依演練及執行成效予以修正。回應台灣所發生的地震對台積電公司的營運影響，台積電公司亦持續進行一系列的改善，包括強化地震緊急應變演練、改善生產機台設備防震固定及隔震措施，以及提升受損機台的生產復原能力。這些改善措施亦已納入新廠設計規劃，並參考營運持續管理系統（ISO 22301），以加強營運持續管理。

台積電公司致力於維護完整的風險管理系統以保護人員安全、天然資源保存與資產保護。為有效因應可能的緊急狀況及天然災害，每一個廠區的管理都有就風險預防、緊急應變、危機管理及營運持續等面向發展出全方位的應對計畫與流程。台積電公司所有晶圓廠均已取得環境管理系統（ISO 14001）及職業安全衛生管理系統（ISO 45001）的驗證，所有位於台灣的廠區亦均取得「台灣職業安全衛生管理系統」（TOSHMS）認證，同時新建廠房也必須於取得工廠登記證後的18個月內取得前述之認證。

台積電公司與其許多供應商在製程中使用的易燃性化學品及有毒物質，亦有造成火災、爆炸及影響環境的風險，除了維持各項風險預防與保護系統外，台積電公司也有火災與意外災害保險。即便如此，台積電公司的風險管理與保險仍可能無法涵蓋所有潛在損失，若任何一座晶圓廠或供應商之設備因火災、爆炸或環境事件而導致損害或停工，將導致台積電公司產能減少並失去重要客戶，並對台積電公司的財務績效造成負面影響。因此，台積電公司除了定期舉辦消防系統檢查與消防演習外，也進行全公司火災風險降低計畫，著重於管理與硬體改善。

台積電公司持續監控對其營運造成影響之破壞性威脅，並調整計畫以確保

營運韌性。

■ 未遵循出口管控、環保及氣候變遷相關法規及協議，或未即時取得營運所需相關核可之風險

由於台積電公司在許多地區從事生產活動，且客戶散布於世界各地，因此受到許多國家或地方法令的規範。例如，在製造、封裝與測試產品時需使用受出口管制法令與法規約束的設備，以及金屬、化學品與材料，需符合國際環保、氣候變遷、安全衛生及人道主義禁止強迫勞動的無衝突礦產來源等相關規定、法令及準則。

台積電公司若無法符合與時俱進的相關法規，或未及時申報資訊或文件至相關主管機關時，可能會導致：

- 遭受重大處罰並負相關法律責任，例如否決進出口許可或第三方訴訟、刑事或行政訴訟
- 暫時或永久停止生產相關產品
- 暫時或永久無法購買或使用特定生產之關鍵化學品或材料
- 製造、封裝與測試製程難以轉換
- 來自客戶的質疑使公司處於極為不利的競爭劣勢，例如若公司無法滿足相關法規或客戶要求，會喪失實際或潛在之銷售合約
- 限制台積電公司營運與產品銷售
- 喪失原有的租稅優惠，包括終止現有的租稅優惠及無權享有租稅減免，以及繳回公司不符合資格的租稅補貼
- 損害公司商譽及聲譽

為了符合相關法規，例如環境及氣候相關法令與要求，將可能使台積電公司必須採取以下措施：（一）購買、使用並設置防治設備；（二）執行防治計畫，例如減緩氣候變遷方案；（三）修改本身產品設計與製程，或導致花費更高成本，例如支付公司排放超過適用閾值而產生的碳費以及取得再生能源、再生能源憑證或碳權、替代性原料／化學品或更貴或更稀有的化學品來進行生產。

如果無法及時取得營運所需相關核可，恐妨礙台積電公司的營運與財務。例如當台積電公司進行新建廠或擴廠專案時，如果無法及時取得環保相關的核可，恐延遲或限制新建廠或擴廠計畫進而造成成本增加，對台積電公司的業務和營運產生不利影響。由於社會大眾對環保議題的日益關注，即使台積電公司營運符合所有相關法律的規定，仍可能因為公眾關注，或是來自社會、環保議題的壓力，使台積電公司的營運及擴廠計畫受到不利的影響或延遲。

台積電公司認為氣候變遷應被視為重要的企業風險，必須對此做好管控以提升企業競爭力。台積電公司針對氣候變遷相關風險及管控措施，請參考本公司民國一百一十一年年報第151頁之「7.2.1 環境保護」之「氣候變遷與能源管理」。

■ 貿易政策之風險

由於台積公司之營收主要來自於對全球主要經濟體之銷售（請參閱本公開說明書貳、一、(二)市場及產銷概況說明），各主要經濟體貿易政策之變動（例如對特定產品提高關稅、執行進出口管控以及採取其他貿易壁壘措施）可能影響台積公司或其客戶的銷售，從而影響台積公司之營運成果。

在民國一百零九年五月和八月，美國對華為技術有限公司及其關係企業（合稱「華為」）採取了一系列出口管制措施，包括對於供應華為受美國出口管制法規管轄的產品加諸更加嚴格的出口許可管制。為遵循上述法規，台積公司自民國一百零九年九月十五日起已停止對華為出貨。自民國一百一十一年二月起，由於烏俄間軍事衝突，數個國家和地區針對俄羅斯，包含特定個人和實體採取廣泛的制裁及出口管制等措施。此外，在民國一百一十一年十月及民國一百一十二年十月，美國進一步對於受美國出口管制法規管轄的特定高速運算晶片、包含此種晶片的電腦設備、用於半導體生產的特定設備或物品以及最終用途用於超級電腦或半導體生產的物項輸往美國出口管制法規定義下的特定國家（包括中國大陸）時，採取更嚴格的出口管制要求。另根據美國新的出口管制措施，運送受美國出口管制法規管轄的物項至中國大陸從事先進製程的晶圓廠，以及美國人員協助此等晶圓廠或特定半導體物項於中國大陸的開發與製造，皆須取得美國政府核發的出口許可。對此，台積公司在民國一百一十一年十月為其位於南京之子公司取得美國政府一年期授權，可繼續維持其正常營運，並於民國一百一十二年十月獲得展延，台積公司亦正進行「經認證終端使用者（Validated End-User, VEU）」授權的申請程序，以取得南京子公司的無限期豁免。惟台積公司並無法保證其南京子公司能取得「經認證終端使用者（VEU）」授權，亦無法保證所取得之授權於將來不會被終止。另一方面，受到貿易管制影響的國家也可能採取反制措施，從而對包括台積公司在內的跨國企業帶來重大的潛在法律風險。舉例言之，中國大陸在民國一百一十一年一月發布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，該辦法允許中國公民、法人向跨國企業尋求民事救濟，以賠償因該跨國企業遵守外國法律對其造成的損失。

世界各國對貿易加諸的障礙，包括保護主義措施、制裁和進出口管制（包含但不限於前段所述之出口管制措施），可能增加台積公司的生產成本、限制台積公司所需原物料和設備的供應，並降低台積公司產品價格的競爭力，亦可能影響台積公司或其客戶的銷售。民國一百一十一年及截至公開說明書刊印日止，台積公司的營運成果尚未因此受到重大影響。惟隨著全球貿易緊張局勢加深，相關管制、法令和措施仍可能對台積公司的業務及營運產生負面影響，並可能令台積公司面臨鉅額的法律責任和財務損失風險。

台積公司持續關注近來相關主要經濟體間的貿易政策及措施變動，並將根據後續發展採取相對的因應措施。

(二) 訴訟或非訟事件

如半導體產業其他多數公司常見的情形，台積公司不定期會接獲第三人的通知，主張台積公司的技術、製程或台積公司製造之半導體產品的設計或客戶之使用，有侵害他人專利或其他智慧財產權之虞。這些主張有時導致雙方間的訴

訟（台積公司或為原告或為被告）及台積公司支付和解金。無論這些第三人主張是否於法有據，或多或少可能造成台積公司訴訟費用之負擔或可能對公司之營運造成不利之影響。此外，台積公司亦須遵守相關地區競爭法的規範並受到主管機關之監理，該等競爭法主管機關對台積公司發動之執法程序若其結果對台積公司不利，可能會損害台積公司之業務或影響台積公司之營運策略，從而對台積公司營運成果或展望造成負面影響，並使台積公司面臨潛在高度法律責任。

- 1、公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形。

Daedalus Prime LLC（Daedalus）於 111 年 9 月，在美國國際貿易委員會（ITC）及美國東德州地方法院對台積公司、TSMC North America 及其他公司就四件美國專利提起專利權侵害調查及訴訟。ITC 於 111 年 10 月立案調查。

Daedalus 於 112 年 6 月，在 ITC 撤銷其中兩件美國專利權侵害調查。同年 6 月並在美國東德州地方法院對台積公司就其他五件美國專利提起專利權侵害訴訟。ITC 於 9 月依雙方共同請求准許暫停 ITC 調查程序，雙方完成和解協議後將再申請終結 ITC 調查及其他訴訟案件。雙方於 10 月共同請求 ITC 終結專利權侵害調查，以及共同請求美國東德州地方法院撤銷相關訴訟。ITC 專利權侵害調查已於 11 月終結，美國東德州地方法院之相關訴訟亦已於同月撤銷。

除前述法律案件之外，截至公開說明書刊印日止，並無其他台積公司為案件主體的重大法律案件。

- 2、公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者。

無。

- 3、公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形。

本公司二位經理人分別於民國一百一十年及一百一十一年因買賣本公司股票未留意買賣期間，致發生證券交易法第 157 條規定之情事，二位經理人已立即依相關規定將該項利益加計利息返還本公司。

- (三) 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生財務週轉困難或喪失債信情事

無。

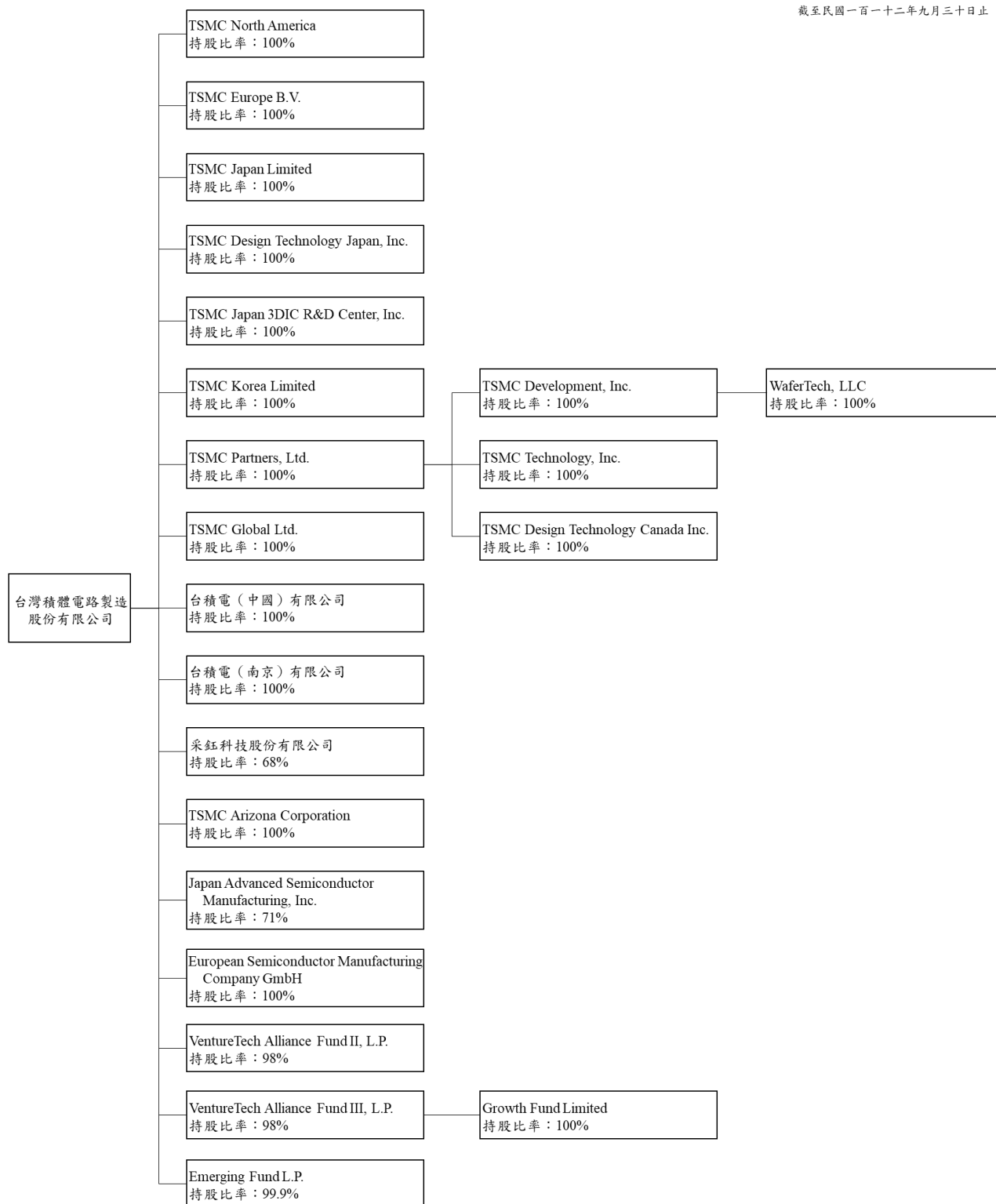
- (四) 其他重要事項

無。

三、公司組織

(一) 關係企業圖

截至民國一百一十二年九月三十日止



本公司與關係企業之關係、相互持股情形、股份及實際投資金額

截至民國一百一十二年九月三十日止

關係企業名稱	與本公司關係	本公司投資情形(註一)		
		持股比例	股數(股)	實際投資金額 (新台幣仟元)
TSMC North America	子公司	100%	11,000,000	333,718
TSMC Europe B.V.	子公司	100%	200	15,749
TSMC Japan Limited	子公司	100%	6,000	83,760
TSMC Design Technology Japan, Inc.	子公司	100%	15,000	410,680
TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.	子公司	100%	49,000	1,144,356
TSMC Korea Limited	子公司	100%	80,000	13,656
TSMC Partners, Ltd.	子公司	100%	988,268,244	31,456,130
TSMC Global Ltd.	子公司	100%	11,384	355,162,309
台積電(中國)有限公司	子公司	100%	不適用(註六)	18,939,667
台積電(南京)有限公司	子公司	100%	不適用(註六)	30,521,412
采鈺科技股份有限公司	子公司	68%	213,619,000	4,224,082
TSMC Arizona Corporation (註二)	子公司	100%	4,400,000	133,798,710
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. (註三)	子公司	71%	2,269,291	52,630,042
European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH (註四)	子公司	100%	4	3,359
VentureTech Alliance Fund II, L.P.	子公司	98%	不適用(註六)	260,300
VentureTech Alliance Fund III, L.P.	子公司	98%	不適用(註六)	1,242,679
Emerging Fund L.P.	子公司	99.9%	不適用(註六)	1,712,674
TSMC Development, Inc.	子公司	100%	10(註七)	18,946,972
TSMC Technology, Inc.	子公司	100%	10(註七)	461,038
TSMC Design Technology Canada Inc.	子公司	100%	2,300,000(註七)	74,246
WaferTech, LLC (註五)	子公司	100%	293,636,833(註八)	-
Growth Fund Limited	子公司	100%	不適用(註六)	74,100

註一：本公司之子公司未持有本公司股票。

註二：TSMC Arizona Corporation (TSMC AZ) 於民國 112 年 10 月與 11 月辦理增資，增資後台積公司對 TSMC AZ 之持股數增加為 9,500,000 股，所有權百分比率維持為 100%。

註三：台積公司對 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. 所有權及表決權百分比分別為 71% 及 81%。

註四：European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH (ESMC) 於民國 112 年 6 月設立並增資，所有權百分比率為 100%。台積公司於民國 112 年 8 月 8 日董事會核准 ESMC 經監管機關核准並符合其他條件後，向博世、英飛凌和恩智浦各出售 10%

股權，出售後台積公司對 ESMC 之所有權百分比將由 100%下降至 70%，惟仍須依實際交易情況而定。

註五：WaferTech, LLC 於民國 112 年 12 月更名為 TSMC Washington, LLC。

註六：不適用，非股份有限公司未發行股票。台積公司之投資係以股權比例表示。

註七：透過 TSMC Partners, Ltd.持有。

註八：透過 TSMC Development, Inc.持有。

(二) 董事

1、董事會成員簡介

職稱 姓名	性別 年齡	國 籍 或 註 冊地	選（就）任 日期(註一)	任期至 (註一)	初 次 選 任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註五)		配偶、未成年子女現在 持有股份		主要經／學歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
						股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率		
董事長 劉德音	男 66-70	美國	110/07/26	113/07/25	106/06/08	12,913,114	0.05%	12,965,696	0.05%	-	-	學歷及專業資格 國立台灣大學電機工程學士 美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦 資訊碩士及博士 工業技術研究院院士 經歷 世大積體電路製造（股）公司總經理 台積公司先進技術事業資深副總經理 台積公司營運資深副總經理 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司總經理暨共同執行長 台灣半導體產業協會理事長	無
副董事長 魏哲家	男 66-70	中 華 民 國	110/07/26	113/07/25	106/06/08	7,179,207	0.03%	6,392,834	0.02%	700,261	0.00%	學歷及專業資格 國立交通大學電機工程學士及碩士 美國耶魯大學電機工程博士 工業技術研究院院士 經歷 新加坡特許半導體公司資深副總經理 台積公司主流技術事業資深副總經理 台積公司業務開發資深副總經理 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司總經理暨共同執行長 台灣半導體產業協會理事長	台積公司總裁
董事 曾繁城	男 76-80	中 華 民 國	110/07/26	113/07/25	86/05/13	34,472,675	0.13%	29,472,675	0.11%	5,132,855	0.02%	學歷及專業資格 國立成功大學電機工程學士 國立交通大學電機工程碩士 國立成功大學電機工程博士 國立交通大學名譽博士 國立清華大學名譽博士 經歷 世界先進積體電路（股）公司總經理 台積公司總經理	擔任董事長職位： - 台積電（中國） 有限公司（非公 開發行公司） - 創意電子（股） 公司 世界先進積體電路 （股）公司副董 事長

職稱 姓名	性別 年齡	國 籍 或 註 冊 地	選（就）任 日期(註一)	任期至 (註一)	初 次 選 任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註五)		配偶、未成年子女現 在持有股份		主要經／學歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
						股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率		
												台積公司副總執行長 台積公司副董事長 宏基（股）公司獨立董事、審計委員 會主席及薪酬委員會委員 財團法人國家文化藝術基金會董事 目前兼任非營利組織之職務 財團法人台積電文教基金會董事長 財團法人雲門文化藝術基金會董事 醫療財團法人竹銘基金會董事	
董事 行政院國家發展基金 管理會 (註三) 代表人： 龔明鑫	男 56-60	中 華 民 國	110/07/26	113/07/25	75/12/10 109/07/24 (註四)	1,653,709,980 779 (註四)	6.38% 0.00%	1,653,709,980 779	6.38% 0.00%	- -	- -	學歷及專業資格 輔仁大學統計學系學士 國立台灣大學經濟學系碩士 國立中興大學經濟學研究所博士 經歷 淡江大學產業經濟系兼任助理教授 經濟部產業發展諮詢委員會副執行秘書 行政院科技顧問組兼任研究員 台灣經濟研究院研究員 台灣經濟研究院副院長 行政院大陸委員會諮詢委員 經濟部顧問 行政院國家金融安定基金管理委員會 委員 行政院國家發展委員會副主任委員兼 國家發展基金管理委員會執行秘書 經濟部政務次長 行政院政務委員 目前兼任非營利組織之職務 行政院政務委員兼國家發展委員會主	台杉投資管理顧問 公司董事（非公開 發行公司）（行政 院國家發展基金 管理會代表人）

職稱 姓名	性別 年齡	國 籍 或 註 冊 地	選（就）任 日期(註一)	任期至 (註一)	初 次 選 任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註五)		配偶、未成年子女現 在持有股份		主要經／學歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
						股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率		
												任委員 行政院國家發展基金管理會召集人	
獨立董事 彼得·邦菲 爵士	男 76-80	英國	110/07/26	113/07/25	91/05/07	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 英國Loughborough大學工程學士 英國Loughborough大學Honorary Doctorate of Technology 倫敦皇家工程學院院士 1996 年冊封爵士勳銜 1989 年獲頒 CBE 勳章 獲頒 the Lion of Finland 勳章 獲頒 Institute of Management 金質獎章 National Electronics Council 頒發 Mountbatten 獎章 2019年獲頒FT ODX傑出董事獎 經歷 ICL Plc董事長暨執行長（英國） 英國電信公司執行長及Executive Committee主席 英國品質基金會副總裁 Mentor Graphics公司董事（美國） Sony公司董事（日本） L.M. Ericsson公司董事（瑞典） GlobalLogic公司董事長（美國） Hampton Group資深顧問（倫敦） Loughborough大學Chair of Council and Senior Pro-Chancellor （英國） Board Member, EastWest Institute（紐 約） 恩智浦半導體公司董事長（荷蘭）	擔任非執行董事職 位： - Imagination Technologies Group 公司（英 國）（非公開發行公 司） - Darktrace 公司 （英國） The Longreach Group 公司諮詢 委員會委員（香 港）（非公開發行公 司） Alix Partners LLP 資深顧問（倫 敦） Board Mentor, Chairman Mentors International (CMi) 公司 （倫敦）（非公開發 行公司）
獨立董事 陳國慈	女 76-80	中 華 民 國	110/07/26	113/07/25	100/06/09	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 英國Inns of Court School of Law 英國大律師資格 新加坡律師資格 美國加州律師資格 專業經歷 新加坡陳材清法律事務所律師（1969- 1970） 美國紐約Sullivan & Cromwell 法律事 務所律師（1971-1974）	無

職稱 姓名	性別 年齡	國 籍 或 註 冊 地	選（就）任 日期(註一)	任期至 (註一)	初 次 選 任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註五)		配偶、未成年子女現 在持有股份		主要經／學歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
						股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率		
												美國舊金山Heller, Erhman, White & McAuliffe法律事務所律師（1974-1975） 聯鼎法律事務所合夥人（1975-1988） 國振法律事務所合夥人（1988-1992） 漢聲出版社副總經理（1992-1995） 財團法人國家文化藝術基金會執行長（1995-1997） 台積公司資深副總經理暨法務長（1997-2001） 「台北故事館」創辦人暨總監（2003-2015） 中華民國行政院政務顧問（2009-2016） 財團法人國家文化藝術基金會董事（2011-2016） 國家表演藝術中心董事長（2014-2017） 「迪化二〇七博物館」創辦人暨總監（2017-2022） 學術經歷 新加坡南洋大學講師（1970-1971） 東吳大學副教授（1981-1998） 國立清華大學客座教授（1999-2002） 國立政治大學教授（2001-2004） 東吳大學教授（2001-2008） 目前兼任非營利組織之職務 財團法人中華民國婦癌基金會董事 香港「Artspace K藝術空間」創辦人暨董事長（2020-）	
獨立董事 麥克·史賓林特	男 71-75	美國	110/07/26	113/07/25	104/06/09	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程學士及碩士 美國威斯康辛大學麥迪森分校工程榮譽博士 獲頒美國半導體產業協會最高榮譽 2013 Robert N. Noyce Award 獲頒美國公司董事協會之2020	NASDAQ公司首席 獨立董事（美國） Gogoro公司（英屬 開曼群島）獨立 董事及薪資報酬 委員會主席 Tigo Energy公司獨

職稱 姓名	性別 年齡	國 籍 或 註 冊 地	選（就）任 日期(註一)	任期至 (註一)	初 次 選 任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註五)		配偶、未成年子女現 在持有股份		主要經／學歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
						股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率		
												Directorship Certified™ 認證 美國國家工程院院士（2017） 經歷 英特爾公司技術與製造事業群執行副 總裁（美國） 英特爾公司全球業務行銷執行副總裁 （美國） 應用材料公司執行長（美國） 應用材料公司董事長（美國） The NASDAQ OMX Group 公司董事 （美國） 矽谷領袖集團 董事（Silicon Valley Leadership Group） 國際半導體產業協會（SEMI）董事 Meyer Burger Technology 公司董事 （瑞士） 威斯康辛大學基金會董事（美國） NASDAQ 公司董事長（美國） 美台商會協會理事主席 目前兼任非營利組織之職務 美國商務部國家標準暨技術研究院工 業諮詢委員會主席	立董事、薪資報 酬委員會主席及 提名暨公司治理 委員會委員（美 國） Kioxia Holdings 公 司獨立董事（日 本）（非公開發行公 司） 擔任合夥人職位： - WISC Partners 創投基金（美 國） - MRS 商業和技 術顧問公司（美 國）（非公開發行公 司）
獨立董事 摩西·蓋弗 瑞洛夫	男 66-70	美國	110/07/26	113/07/25	108/06/05	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 Technion 以色列理工學院電機工程學 士 Technion 以色列理工學院電腦科學碩 士 經歷 National Semiconductor 公司及 Digital Equipment 公司歷任多項工程師及管 理工程師職務（美國） LSI Logic 公司歷任多項經理人職務近 10 年（美國） Verisity 公司執行長（美國） Cadence Design Systems 公司執行副總 經理及驗證處 General Manager（美 國） 賽靈思公司總經理暨執行長（美國）	擔任董事長職位： - SiMa Technologies 公 司（美國）（非 公開發行公司） - Foretellix 公 司 （以色列）（非 公開發行公司） 恩智浦半導體公司 （荷蘭）獨立董事

職稱 姓名	性別 年齡	國 籍 或 註 冊 地	選（就）任 日期(註一)	任期至 (註一)	初 次 選 任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註五)		配偶、未成年子女現 在持有股份		主要經／學歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
						股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率		
												賽靈思公司董事（美國） Wind River Systems公司執行董事長 （美國）（2018-2022） San Jose Institute of Contemporary Art 董事（美國）	
獨立董事 海英俊	男 71-75	中 華 民 國 美 國	110/07/26	113/07/25	109/06/09	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 美國德州大學達拉斯分校國際企業管 理碩士 工業技術研究院院士 經歷 GE Capital台灣地區總經理 台達電子副董事長暨執行長（2004- 2012） 台達電子經營策略管理委員會主任委 員（2012-2021） 目前兼任非營利組織之職務 台灣雲端物聯網產業協會會策顧問 中華民國企業永續發展協會理事 財團法人台達電子文教基金會董事 財團法人中華民國企業界紀念張心洽 先生學術基金會董事 蔣經國國際學術交流基金會董事及董 事會財務委員會委員 台灣氣候聯盟理事長	台達電子工業 （股）公司 （「台達電 子」）董事長， 2012- 台達電子永續委員 會主席 台達電子所屬子公 司董事： - 台達電子企業管 理（上海）有限 公司（非公開發行公 司） - Delta Networks公 司（非公開發行公 司） - 台達資本（股） 公司（非公開發行公 司） - 乾坤科技（股） 公司（非公開發行公 司） 台灣聚合化學品 （股）公司獨立 董事、審計委員 會委員、永續發 展委員會委員及 薪資報酬委員會 召集人 中鼎工程（股）公 司董事及永續與 淨零委員會委員
獨立董事	男 71-75	美國	110/07/26	113/07/25	110/07/26	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 委內瑞拉Carabobo大學電機工程學士	應用材料公司 Growth Technical Advisory Board

職稱 姓名	性別 年齡	國 籍 或 註 冊 地	選（就）任 日期(註一)	任期至 (註一)	初 次 選 任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註五)		配偶、未成年子女現 在持有股份		主要經／學歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
						股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率	股數(註二)	持股 比率		
拉斐爾· 萊夫												美國史丹佛大學電機工程碩士及博士 香港中文大學榮譽法學博士（2015） 清華大學（2016）、以色列Technion學 院（2017）、亞利桑那州立大學 （2018）及邁阿密大學（2022）榮 譽博士 Tau Beta Pi, the Engineering Honor Society會員 The Electrochemical Society會員 Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE）院士 美國文理科學院、美國國家工程院及 中國工程院院士 美國國家發明家科學院院士 獲頒美國總統青年學者獎（1984） 美國Semiconductor Research Corporation頒發Aristotle獎（2000） 獲頒Tribeca Disruptive Innovation獎 （2012） 美國Woodrow Wilson National Fellowship Foundation頒發Frank E. Taplin, Jr.Public Intellectual獎 （2015） 獲頒Great Minds in STEM年度工程師 （2018） 美國國家工程院美國國家工程院 Simon Ramo Founders獎（2022） 發明或共同發明13項專利、編輯或共 同編輯5本書，及指導38篇博士論 文 經歷 委內瑞拉Simón Bolívar大學助理教授 美國史丹佛大學電機工程客座助理教 授 美國麻省理工學院（MIT）教職 （1980-） MIT材料科學與工程中心IBM院士 MIT電機工程Analog Devices職涯發展 教授 MIT Fariborz Maseeh新興技術教授	共同主席（美 國）

職稱 姓名	性別 年齡	國 籍 或 註 冊 地	選（就）任 日期(註一)	任期至 (註一)	初 次 選 任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註五)		配偶、未成年子女現 在持有股份		主要經／學歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
						股數(註二)	持 股 比 率	股數(註二)	持 股 比 率	股數(註二)	持 股 比 率		
												(2004-2012) MIT微系統技術實驗室主任 MIT電機工程系副主任 MIT電機暨電腦資訊系主任 MIT教務長 Schlumberger公司董事 MIT校長(2012-2022) 目前兼任非營利組織之職務 MIT榮譽校長(2023-) MIT Ray and Maria Stata科技中心電機 工程暨電腦科學教授(2023-) 卡內基國際和平基金會Board of Trustees成員 美國外交關係協會董事 Waverley Street基金會董事(美國)	
附註： 1. 董事利用他人名義持有台積公司股份：無 2. 董事與其他主管或董事具配偶或二等親以內關係：無 3. 董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者：無													

註一：民國年／月／日

註二：不含美國存託憑證表彰之股數。

註三：該法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東（股權比例占前十名之股東名稱）
行政院國家發展基金管理會	不適用

註四：行政院國家發展基金管理會於民國一百零九年七月二十四日指派龔明鑫先生擔任本公司代表人。

註五：截至民國一百一十二年十一月三十日之持股

2、董事所具專業資格及獨立性情形

本公司於民國一百一十年七月二十六日股東常會完成第十五屆董事改選，任期自民國一百一十年七月二十六日起至民國一百一十三年七月二十五日止。本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列：

姓名及職稱	條件	專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
劉德音 董事長		董事專業資格與經驗請參閱本公開說明書「壹、三、(二)、1、董事會成員簡介」	不適用	0
魏哲家 副董事長				0
龔明鑫 董事				0
曾繁城 董事				0
彼得·邦菲爵士 獨立董事			所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司普通股股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
陳國慈 獨立董事				0
麥克·史賓林特 獨立董事				0
摩西·蓋弗瑞洛夫 獨立董事				0
海英俊 獨立董事				1
拉斐爾·萊夫 獨立董事				0

註一：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
- 二、曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 三、曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
- 四、受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
- 五、使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
- 六、無行為能力或限制行為能力者。
- 七、受輔助宣告尚未撤銷。

註二：一、非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

二、兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

三、選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董

事、監察人或受僱人。

- (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。
- (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。
- (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

3、董事會多元化及獨立性

董事會訂定「董事提名辦法」，明訂董事候選人之提名、資格及評估之政策及標準。本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司之目標為獨立董事人數至少占全體董事席次的 50%，以及至少包含一名女性董事。目前本公司董事會十位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中包含一名女性董事；十位董事中，六位為獨立董事，占全體董事席次的 60%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	副董事長	董事		獨立董事					
姓名	劉德音	魏哲家	曾繁城	龔明鑫	彼得·邦菲爵士	陳國慈	麥克·史賓林特	摩西·蓋弗瑞洛夫	海英俊	拉斐爾·萊夫
性別	男	男	男	男	男	女	男	男	男	男
國籍	美國	中華民國	中華民國	中華民國	英國	中華民國	美國	美國	中華民國 /美國	美國
年齡	66-70	66-70	76-80	56-60	76-80	76-80	71-75	66-70	71-75	71-75
兼任本公司員工		✓								

專業知識與才能										
商務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
科技	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
財務／會計				✓					✓	
法律						✓				
行銷	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
資訊安全					✓					
其他										創新／ 研發／ 教育／ 訓練
能力與經驗										
領導力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
決策力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
國際市場觀	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
產業知識	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
財務管理能力	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
營運及製造	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	
業務開發	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
風險管理／危機處理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
環境永續	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
社會參與	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

四、資本及股份

(一) 股本形成經過

1、最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動之情形

單位：仟股／新台幣仟元

年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
111.03	10	28,050,000	280,500,000	25,931,768	259,317,675	發行限制員工權利新股 增資：1,387 仟股	無	111.03.08 竹商字第 11100069 86 號
111.05	10	28,050,000	280,500,000	25,930,381	259,303,805	註銷庫藏股 減資：1,387 仟股	無	111.05.20 竹商字第 11100154 83 號
112.03	10	28,050,000	280,500,000	25,932,490	259,324,905	發行限制員工權利新股 增資：2,110 仟股	無	112.03.08 竹商字第 11200067 88 號
112.05	10	28,050,000	280,500,000	25,932,071	259,320,710	註銷未既得限制員工權利新股 減資：419 仟股	無	112.05.22 竹商字第 11200162 19 號

2、最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募普通股執行情形：

無。

3、總括申報制度相關資訊：

無。

(二) 最近股權分散情形

1、主要股東名單

持股基準日：民國一百一十二年九月二十日（註）

主要股東名稱	持有股數	持股比例
花旗託管台積電存託憑證專戶	5,316,067,058	20.50%
行政院國家發展基金管理會	1,653,709,980	6.38%
花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	803,585,089	3.10%
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	424,300,838	1.64%
新制勞工退休基金	340,229,555	1.31%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	323,621,748	1.25%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	288,506,605	1.11%

中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越 50 證券投資信託基金專戶	264,458,321	1.02%
渣打託管 iShares 新興市場 ETF	223,708,000	0.86%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管歐洲太平洋成長基金	177,797,649	0.69%

註：此為民國一百一十二年第一季現金股利發放之配息基準日。

2、最近兩年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形

不適用。

(三) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：除加權平均股數及投資報酬分析外，均為新台幣元

項目	民國 110 年	民國 111 年	民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 9 月 30 日
每股市價（註一）			
最高	673.00	683.00	593.00
最低	536.00	371.00	449.50
平均	597.73	516.24	536.62
每股淨值			
分配前	83.62	113.60	129.12
分配後	80.87	110.85（註五）	125.62（註六）
每股盈餘			
加權平均股數（仟股）	25,930,380	25,929,383	25,929,338
稀釋每股盈餘	23.01	39.20	23.13
每股股利			
現金股利	11.00	11.00（註五）	9.50（註六）
累積未付股利	-	-	-
投資報酬分析			
本益比（註二）	25.98	13.17	-
本利比（註三）	54.34	46.93（註五）	-
現金股利殖利率（註四）	1.8%	2.1%（註五）	-

註一：資料來源為台灣證交所網站。

註二：本益比=當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘。

註三：本利比=當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利。

註四：現金股利殖利率=每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價。

註五：包含民國一百一十二年二月十四日董事會決議之民國一百一十一年第四季股利金額。

註六：包含民國一百一十二年十一月十四日董事會決議之民國一百一十二年第三季股利金額。

(四) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1、公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司之章程規定，公司分派盈餘前，應提撥年度獲利不高於 0.3%作為董事酬勞，及不低於 1%作為員工酬勞。

2、本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

台積公司於民國一百一十二年二月十四日董事會通過配發之本公司民國一百一十一年度應付員工現金酬勞係依當年度獲利狀況按一定比率估列，董事酬勞則係依預期發放金額估計入帳。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3、董事會通過分派酬勞情形：

- 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形。

	董事會決議 (民國 112 年 2 月 14 日)
	金額 (新台幣仟元)
董事酬勞 (現金)	690,128
員工酬勞 (現金)	60,702,047

註：本公司已於民國一百一十一年每季季後發放業績獎金新台幣 60,702,047 仟元。上述員工酬勞 (分紅) 已於民國一百一十二年七月發放。

- 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4、股東會報告分派酬勞情形及結果：

台積公司於民國一百一十二年六月六日股東會報告下列事項：

- 本公司民國一百一十一年度員工酬勞 (分紅) 及董事酬勞，業經民國一百一十二年二月十四日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。
- 本公司民國一百一十一年度員工業績獎金及酬勞 (分紅) 總額為新台幣 121,404,093 仟元，其中業績獎金新台幣 60,702,047 仟元已於每季季後發放，而酬勞 (分紅) 新台幣 60,702,047 仟元，已於民國一百一十二年七月發放。
- 本公司民國一百一十一年度董事酬勞為新台幣 690,128 仟元。

5、前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形 (包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

民國一百一十年度董事酬勞及員工酬勞

	董事會決議 (民國 111 年 2 月 15 日)	實際發放數 (註)
	金額 (新台幣仟元)	金額 (新台幣仟元)
董事酬勞 (現金)	487,537	487,537
員工酬勞 (現金)	35,601,449	35,177,130

註：上述董事酬勞及員工酬勞已於民國一百一十年度綜合損益表中費用化，並經民國一百一十一年二月十五日董事會決議通過。惟其中因員工離職未發放之金額計新台幣 424,319 仟元，已於民國一百一十一年將此費用迴轉。

貳、營運概況

一、公司經營

(一) 業務內容

1、業務範圍

身為專業積體電路製造服務的創始者與領導者之一，台積公司提供全面整合的積體電路製造服務，包括領先的先進製程技術、特殊製程技術、先進光罩技術、TSMC 3DFabric™先進封裝與矽堆疊技術服務、優異的量產能力與品質，以及完備的設計生態系統支援，來滿足客戶日益多樣化的需求。台積公司致力於提供客戶無與倫比的整體價值，視客戶的成功為台積公司的成功，因此贏得來自全球客戶的信任，而公司也獲致極大的成長與成功。

民國一百一十一年，台積公司為532個客戶生產1萬2,698種不同的產品，應用範圍涵括整個電子應用產業，包括於個人電腦與其周邊產品、資訊應用產品、有線與無線通訊系統產品、高效能運算伺服器與數據中心、汽車與工業用設備，以及包括數位電視、遊戲機、數位相機等消費性電子、人工智慧物聯網及穿戴式裝置，與其他許多產品與應用。

終端電子產品的快速演進，將促使客戶採用台積公司創新的技術與服務以追求差異化，同時也會更促進台積公司自身的技術發展。台積公司始終深信成功將屬於產業趨勢的領導者而非追隨者。

有關台積公司未來業務發展計畫，請參閱本公開說明書貳、一、(二)市場及產銷概況說明。

■ 最近二年度銷售量值表

單位：銷售量（千片十二吋晶圓約當片數）／營業收入淨額（新台幣仟元）

		民國 110 年		民國 111 年	
		銷售量	營業收入淨額	銷售量	營業收入淨額
晶圓	內銷(註一)	2,562	172,814,551	2,324	202,075,489
	外銷	11,617	1,232,485,722	12,929	1,789,780,458
其他 (註二)	內銷(註一)	不適用	13,055,166	不適用	16,668,631
	外銷	不適用	169,059,598	不適用	255,366,714
合計	內銷(註一)	2,562	185,869,717	2,324	218,744,120
	外銷	11,617	1,401,545,320	12,929	2,045,147,172

註一：內銷係指銷售至台灣。

註二：其他主要係包含封裝測試服務、光罩製造、設計服務及權利金收入。

本公司計畫開發之新商品（服務）請參閱本公開說明書壹、二、(一)、3、未來研發計畫及預計投入之研發費用。

2、產業概況

■ 產業未來展望、機會與挑戰

民國一百一十一年，台積公司在積體電路製造服務領域的穩健成長來自於強勁廣泛的市場需求。產業大趨勢諸如5G的普及化、AI快速增長以及加速數位化轉型等，使高效能運算產品、智慧型手機、物聯網及車用市場需求

攀升。然而在這段期間，電子產品供應鏈也已負荷在過去兩年因供給的不確定性而累積之高水位剩餘庫存。因此，在民國一百一十一年下半年，電子產品供應鏈進入庫存調整階段，影響積體電路製造服務業與台積公司的成長。

於民國一百一十二年，在高通膨環境與經濟增長放緩的情形下，消費者的可支配支出受到影響。因此，電子產品的整體需求減少。除了電子產品需求疲軟之外，庫存調整於民國一百一十二年持續，以上半年幅度較高。在這二個不利因素下，台積公司預計全球半導體（不含記憶體）市場的產值為個位數百分比衰退。長期而言，因電子產品採用半導體的含量提升，無晶圓廠設計公司持續擴大市占率，整合元件製造商增加委外製造，以及系統公司增加採用自有特殊應用元件 (ASIC) 等因素，台積公司預期自民國一百一十一年至民國一百一十六年，積體電路製造服務領域的成長可望較全球半導體（不含記憶體）市場的個位數百分比年複合成長率更為強勁。

積體電路製造服務領域位居整個半導體產業鏈的上游，其表現與主要產品平台的市場狀況息息相關，包含高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品。

➤ 高效能運算

高效能運算平台包括個人電腦、平板電腦、遊戲機、伺服器、基地台等。民國一百一十一年，主要高效能運算產品單位出貨量衰退了 11%，主要歸咎於居高不下的通貨膨脹，整體經濟不確定性以及過度準備庫存導致消費者端之需求疲軟。在此同時，伺服器與數據中心升級週期維持相對健康，以容載快速成長的資訊流量，並滿足在人工智慧應用上日益增加的需求，以及持續的 5G 基地台部署。

儘管受到 COVID-19 刺激而加速之數位化轉型已導致與高效能運算相關之半導體需求產生結構性的成長，經濟逆風將跨大影響個人消費者與企業客戶兩方面的需求。因此，台積公司預估民國一百一十二年高效能運算產品單位出貨量呈現另一個低十位數百分比衰退。長期來說，隨著產業開始邁入 5G 時代，一個更智慧化且更加互聯的世界，將會激起對運算能力及低耗能運算的強烈需求。這些都需要更高性能及更佳功耗效率的中央處理器、繪圖處理器、網路處理器、人工智慧加速器與相關的特殊應用積體電路，並將驅動整體高效能運算平台朝向更豐富的半導體含量、更先進製程技術與 3D 封裝邁進。基於公司在這些領域的技術領先地位，這些趨勢對台積公司是有利的。

➤ 智慧型手機

由於受到全球嚴峻的 COVID-19 疫情，烏俄戰爭和較高通膨的影響，智慧型手機的單位出貨量在民國一百一十一年衰退 11%，反映出 5G 商用化的趨緩和 4G 市場的快速衰退，這樣的結果延長整體換機週期。這樣的情勢可能無法在短期恢復，台積公司預估民國一百一十二年智慧型手機市場呈現個位數百分比衰退。長期來看，由於智慧型手機持續演進至 5G，加上擁有更高性能、更長電池使用時間、生理感應器及更多人工智慧應用，將持續推動智慧型手機銷售。

高性能與高能源效率的積體電路技術是手機製造商的基本要求，而高度

整合的晶片和先進的 3D 封裝設計是最佳化成本、能耗及規格（晶片面積與高度）的首選解決方案。在人工智慧應用、各種複雜軟體運算與高解析度視訊處理的高效能需求刺激之下，先進製程技術將持續推進。台積公司在製造高度整合晶片和先進 3D 封裝設計是公認的製程技術領導者，因此在服務智慧型手機市場處於非常有利的地位。

➤ 物聯網

物聯網平台包含各式各樣的「智慧」聯網裝置，如穿戴裝置、音箱、健康裝置、家庭自動化裝置、城市與製造等。由於 COVID-19 疫情改變了消費者的生活與工作型態，並加速了企業的數位轉型，民國一百一十一年物聯網裝置單位出貨量成長 18%，並以智慧健康與智慧零售/智慧製造裝置為主要成長動能。

這樣的成長趨勢將持續，但由於全球通膨將對消費者相關物聯網裝置之出貨造成些許影響，導致民國一百一十二年的物聯網單位出貨量預計成長約個位數百分比。此外，由於物聯網裝置將採用更多的人工智慧功能，物聯網裝置將需要更高性能並更省電的控制晶片、聯網晶片與各種感測晶片。台積公司除提供業界最領先先進技術，更提供超低功耗（Ultra-Low Power, ULP）與各種特殊製程技術，以強化客戶的競爭力，達到產業 ESG 永續發展需求，並協助客戶贏得市場。

➤ 車用電子

由於晶片供應改善的帶動，民國一百一十一年全球汽車單位產量成長 7%，但是部分成長受到烏俄戰爭造成的持續供應鏈中斷以及 COVID-19 在中國蔓延時的零星停工所抵消。預期終端需求於民國一百一十二年受到高通膨以及宏觀經濟不確定性的影響，全球汽車單位產量將僅有個位數百分比的成長。

整體汽車產業正朝向更環保、更安全與更智慧化的方向邁進，這將加速電動汽車（EV）、先進駕駛輔助系統（ADAS）及智慧座艙資訊娛樂系統的採用，加上新的電子/電氣（Electrical/Electronic, E/E）架構，所有這些將帶動 AP/MCU/ASIC 處理器、車內網路、感測器，以及電源管理晶片的需求增加，從而使每輛汽車的半導體含量不斷提升。台積公司提供多種車用製程技術，使客戶能夠在汽車市場上提供具有競爭力的產品。

➤ 消費性電子產品

物流中斷（如塞港）導致電視供應鏈的交貨時間延長，影響主要零售商超額預訂而導致民國一百一十一年庫存過多。同時，通貨膨脹、升息及中國清零政策封鎖導致電視、機上盒（STB）和其他消費產品的需求疲軟。總體而言，受庫存調整和需求疲軟的影響，民國一百一十一年數位消費性電子市場總出貨量下降 11%。

對經濟衰退的擔憂可能會推遲數位消費性電子市場的需求復甦，預計民國一百一十二年全球數位消費性電子出貨量呈現個位數跌幅，其中較高階部分，例如大尺寸螢幕、120Hz/144Hz 高幀率電視、語音 AI 控制及 WiFi 6 無線連接將持續呈現正成長。此外，無論經濟何時恢復，台積公司的先進技術將持續協助客戶在 DCE 市場創造和提供差異化的創新產

品。

■ 產業供應鏈

電子產品的供應鏈冗長而複雜，且各個環節環環相扣。身處產業鏈的上游，半導體元件供應商必須提供充足且彈性的供貨以因應市場需求的激烈變化，而積體電路製造服務產業更是確保產業鏈健康、穩健的重要角色。台積公司身為積體電路製造服務領域的領導者之一，將持續提供下游產業鏈創新所需的最先進製程技術及具規模的產能。

3、技術及研發概況

■ 所營業務之技術層次、研究發展

民國一百一十一年，台積公司持續投資研究與開發，全年研發總支出占營收之7.2%，此一研發投資規模相當於或超越了許多其他高科技領導公司的規模。

延續每二年半導體運算能力大幅提升之摩爾定律所面臨的持續挑戰，台積公司研發組織的努力著重於讓台積公司能夠提供客戶先進的技術和設計解決方案，協助客戶取得產品的成功。民國一百一十一年，公司成功開始試產N3E技術，是N3增強型技術，同時也開發領先半導體業界的2奈米技術，已進入基礎製程制定和良率提升階段。此外，公司繼續推進2奈米以下技術的探索性研究。

除了發展互補金屬氧化物半導體（CMOS）邏輯技術，台積公司廣泛的對其他半導體技術進行研發，以提供客戶行動系統單晶片（SoC）及其他應用所需的功能。民國一百一十一年完成的重點包括：

- 台積公司的導線與封裝技術整合方案 TSMC 3DFabric™，取得重大進展：HBM3（第三代 HBM）完成 CoWoS®-S 認證；InFO_PoP Gen-8 通過驗證支援行動應用和增強散熱性能；如期開發下一代 InFO_PoP 並提供背面線路重佈層（RDL）。
- 在特殊製程技術方面進展的例子包括：提高 55 奈米 BCD 技術的 5V 器件的品質因數，擴展 0.13 微米 BCD 技術以支援 55V 汽車應用；驗證下一代單片 CMOS-MEMS 技術，具有高度可靠的 6 軸 IMU（慣性測量單元）；採用三片晶圓堆疊技術，試產世上最小晶片的電壓式全域快門金屬氧化物半導體影像感測器；展示了下個世代的磁性記憶體把記憶體單元面積減少並且提升寫入速度與節省耗能，以使用於微控制器（MCU），虛擬實境（VR）與邊緣運算（Edge-AI）的應用。

民國一百一十一年及截至本公開說明書刊印日止，台積公司開發或已提供的製程技術包括：

- 邏輯製程技術
 - ✓ 2 奈米（N2）技術開發依照計畫進行並且有良好的進展。N2 技術採用台積公司第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，預計於民國一百一十四年開始量產。
 - ✓ 3 奈米鰭式場效電晶體（Fin Field-Effect Transistor, FinFET）

(N3) 技術依照計畫已於民國一百一十一年下半年量產。

- ✓ N3 增強型 (N3E) 技術係 N3 技術的強化版，將持續針對行動通訊與高效能運算應用提供領先業界的優勢，並已於民國一百一十二年第四季開始量產。
 - ✓ 4 奈米 FinFET (N4) 技術為 5 奈米 FinFET (N5) 技術的強化版，已於民國一百一十一年開始量產。
 - ✓ 4 奈米 FinFET 強效版 (4nm FinFET Plus, N4P) 技術開發依照計畫進行並有良好的進展，已於民國一百一十一年獲得客戶產品投片，並已於民國一百一十二年量產。
 - ✓ N4X 製程技術於民國一百一十年推出。此一技術係台積公司首次針對高效能運算產品所量身打造，在台積公司 5 奈米系列製程技術中，展現極致效能與最高運作時脈，已於民國一百一十二年下半年接獲客戶產品投片。
 - ✓ 5 奈米 FinFET 強效版 (N5P) 技術為 N5 技術的效能強化版，於民國一百一十二年邁入第三年量產，應用於客戶手機及高效能運算產品。
 - ✓ 6 奈米 FinFET (N6) 技術於民國一百一十二年邁入第四年量產，並廣泛應用於客戶手機、高效能運算，以及消費性電子產品。
 - ✓ 6 奈米 FinFET (N6) 超低功耗 (Ultra Low Power) N6e™ 技術正在開發中，其製程設計套件 (Process Design Kit, PDK) 已於民國一百一十二年第四季完成，預計於民國一百一十三年開始試產。
 - ✓ 7 奈米 FinFET (N7) 及 7 奈米 FinFET 強效版 (N7+) 技術已為客戶量產 5G 及高效能運算產品多年，並於民國一百一十二年邁入為客戶量產消費性電子與車用產品的第三年。
 - ✓ 奠基於 12 奈米 FinFET 精簡型強效版 (12nm FinFET Compact Plus, 12FFC+) 的 N12e™ 技術，於民國一百一十年量產。隨後，於民國一百一十一年推出創新的低漏電 (Ultra-low Leakage Devices) 元件，並已於民國一百一十二年量產，協助客戶提供更具有競爭力的超低功耗產品。
 - ✓ 22 奈米超低漏電 (Ultra-Low Leakage, ULL) (22ULL) 技術於民國一百一十年推出新的強化版低漏電元件，並於民國一百一十一年開始應用於物聯網產品。
- 特殊製程技術
- ✓ 5 奈米 FinFET 車用 (N5A) 技術，係經過車用驗證並提供汽車設計開發平台 (Automotive Design Development Platform) 的 5 奈米技術。N5A 技術已完成技術開發及矽智財 AEC-Q100 驗證，並通過 ISO26262 汽車產業功能安全標準認證，並已於民國一百一十二年接獲客戶產品投片。
 - ✓ N6 射頻 (Radio Frequency, RF) (N6 RF) 技術於民國一百一十一年接獲多個客戶產品投片。此外，第二代 N6 射頻 (N6 RF+) 技

術正在開發中，其製程設計套件（Process Design Kit, PDK）已於民國一百一十二年第四季完成。

- ✓ 12FFC+ 射頻技術 1.0 版積體電路用模擬程式（Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, SPICE）模型與製程設計套件於民國一百一十一年發布。此技術在與 N12e™ 相同的邏輯技術平台上開發，針對物聯網無線連接應用和第二波手機射頻客戶。
 - ✓ 16 奈米 FinFET 精簡型（16nm FinFET Compact，16FFC）射頻技術於民國一百一十年接獲多個客戶產品的投片。其增強版（Enhancement I/II）技術於民國一百一十一年開發完成，支援 28/39/47 千兆赫茲（GHz）毫米波射頻前端模組（mmWave RF Front-End Module）與 77 GHz/79 GHz 汽車雷達等運用。
 - ✓ 16FFC 嵌入式磁性隨機存取記憶體（Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM）技術矽智財於民國一百一十一年完成可靠性驗證，具備 100 萬次的循環操作耐久性和回流焊接能力。此技術的生產已準備就緒，並已於民國一百一十二年第四季完成車規 AEC-Q100 Grade-1 可靠性驗證。
 - ✓ 22ULL 及 28 奈米超低漏電（28ULL）嵌入式電阻式隨機存取記憶體（Resistive Random Access Memory, RRAM）技術是台積公司第二代 RRAM 解決方案，具備成本和可靠性的平衡。民國一百一十一年已有多個客戶採用這些技術完成產品驗證並開始量產。
 - ✓ 十二吋晶圓 40 奈米絕緣層上覆矽（Silicon On Insulator, SOI）（N40SOI）技術提供領先業界的競爭優勢，於民國一百一十年接獲多家客戶產品投片，並於民國一百一十一年開始量產。
 - ✓ 六吋矽基板氮化鎵（Gallium Nitride on Silicon）技術成功通過客戶產品品質及可靠性認證，並於民國一百一十一年被廣泛應用於多樣消費性電子產品的電源供應器，具備省電與輕薄短小的優勢。台積公司持續開發第二代六吋矽基板氮化鎵技術，支援車用電子應用，預計於民國一百一十三年推出。八吋矽基板氮化鎵技術開發依照計畫進行，預計於民國一百一十四年推出。
 - ✓ 持續精進互補式金氧半導體影像感測器（CMOS Image Sensor, CIS）技術，進入下一世代製程，以更進一步強化先進智慧手機相機效能。民國一百一十一年，台積公司持續協助客戶將世界最小畫素的產品導入市場。此外，台積公司成功完成全球首個三片晶圓堆疊全局曝光影像感測器技術的開發，此技術的生產已準備就緒。
 - ✓ 針對矽光子（Silicon Photonics）技術，台積公司正在開發創新的 COUPE（COmpact Universal Photonics Engine）三維立體光子堆疊技術，能夠整合矽光子晶片與電路控制晶片（Electrical Control Chip）成為單晶片的光學引擎。此光學引擎能夠與高速運算晶片共構封裝，提供低耗能與高速訊號傳輸。民國一百一十一年，數個測試晶片已投片並進行初期評估，為未來量產奠定深厚基礎。
- TSMC 3DFabric™ - 台積公司先進封裝及三維矽堆疊（3D Silicon

Stacking) 技術

- ✓ TSMC-SoIC[®] (System on Integrated Chip, 系統整合晶片) 晶片對晶圓 (Chip on Wafer, CoW) 技術於民國一百一十一年成功量產。透過 CoW 技術堆疊靜態隨機存取記憶體 (Static Random Access Memory, SRAM) 與邏輯晶片, 展現出大幅效能提升。
- ✓ TSMC-SoIC[®] 晶圓對晶圓 (Wafer on Wafer, WoW) 技術, 藉由堆疊 7 奈米邏輯晶片於嵌入式深溝槽電容 (Deep Trench Capacitor, DTC) 晶片上, 於民國一百一十一年在高效能運算 (High performance computing, HPC) 產品展現出優異的系統效能提升。
- ✓ 能夠整合多個系統單晶片 (System-on-Chip, SoC)、第二代高頻寬記憶體 (second generation high bandwidth memory, HBM2E) 及具備嵌入式深溝槽電容 (Embedded deep trench capacitor, eDTC) 的三倍光罩尺寸矽基板的 CoWoS[®]-S (Chip on Wafer on Substrate with Silicon interposer) 技術, 於民國一百一十一年成功地為客戶量產高效能運算產品。
- ✓ 針對高效能運算產品, 提供較佳訊號整合的線路重佈層 (Redistribution layer, RDL) 的 CoWoS[®]-R (Chip on Wafer on Substrate with Redistribution Layer Interposer) 技術, 於民國一百一十一年成功試產, 並已於民國一百一十二年開始量產。
- ✓ 能夠在大於 90 毫米乘 90 毫米的基板上, 整合多個系統單晶片至二倍光罩尺寸扇出封裝的整合型扇出暨封裝基板 (InFO on Substrate, InFO_oS) 技術, 於民國一百一十一年成功量產。
- ✓ 針對高效能運算產品, 能夠整合 5 奈米系統單晶片與超高密度晶片互連導線的局部矽基互連整合型扇出封裝 (Integrated Fan-Out with Local Si Interconnect, InFO_LSI) 技術, 於民國一百一十一年成功量產。
- ✓ 應用於 4 奈米晶圓覆晶封裝的細小間距陣列銅凸塊 (Cu bump) 技術於民國一百一十一年成功量產。

■ 研究發展人員與其學經歷

截至民國一百一十二年九月三十日, 本公司研究發展人員共計約9,000人, 其中約85%擁有碩士以上學位, 平均服務年資約9年。

■ 研發支出

金額：新台幣仟元

民國 107 年	85,895,569
民國 108 年	91,418,746
民國 109 年	109,486,089
民國 110 年	124,734,755
民國 111 年	163,262,208

■ 研究發展成果

➤ 研究發展組織卓越成果

✓ 3 奈米製程技術

民國一百一十一年，台積公司建立 N3E 技術平台，支援高效能運算及系統單晶片應用，已於民國一百一十二年第四季開始量產。

✓ 2 奈米製程技術

民國一百一十一年，台積公司 2 奈米研發著重於基礎製程制定、良率提升、電晶體及導線效能改善以及可靠性評估。民國一百一十二年內，重要客戶完成矽智財設計，並開始做驗證。台積公司並且發展低阻值重置導線層以及超高效能金屬層間電容，持續進行 2 奈米製程技術效能提升。

✓ 微影技術

民國一百一十一年微影技術研發的重點在於 3 奈米技術量產、2 奈米技術開發和下一代奈米技術的先期準備。針對 2 奈米技術的開發，強化變異控制、材料品質和降低缺陷展現了良好的效能和符合預期的晶片良率。民國一百一十二年，為了 2 奈米技術，台積公司的研發組織持續追求極紫外光技術發展、光罩保護膜開發以及成本的降低。未來，台積公司微影技術研發將持續開發先進製程技術並結合下一代極紫外光曝光機發展，以延續摩爾定律。

✓ 光罩技術

民國一百一十一年，研發組織藉由極紫外光阻及吸收層材料改善、多重電子束光罩曝光機精調、顯影蝕刻製程配方的調整及導入乾式清潔處理、檢測深度學習，致力於提升極紫外光光罩在線寬控制、增進圖形可靠度、光罩層疊精準度、減少光罩缺陷、增進良率、曝光耐受度及晶圓產能，以完成 3 奈米微影製程的要求。藉由 2 奈米及未來製程光罩新材料與光罩新製程的開發，公司持續精進極紫外光光罩技術。

➤ 導線與封裝技術整合

台積公司將晶圓級晶片到晶片製程之細間距連接技術命名為 TSMC 3DFabric™，其中包括晶圓級前段和後段技術。我們的前段技術 TSMC-SoIC®（系統整合晶片）支持先進矽技術的 3D 晶片堆疊。我們先進的後段技術，包括將晶片嵌入預製的線路重佈層（RDL）上的 CoWoS®和在互連之前嵌入晶片的整合型扇出（InFO）。TSMC 3DFabric™ 通過整合晶圓級前段和後段技術，在產品設計方面提供了極大的靈活性，以滿足未來計算系統整合及擴充的需求。

✓ 三維積體電路（3DIC）與系統整合晶片（TSMC-SoIC®）

系統整合晶片（TSMC-SoIC®）是創新的晶圓級前段三維積體電路（3DIC）晶片堆疊平台，具有卓越的接合密度、互連頻寬、功耗效率和薄形輪廓，可透過系統級微縮來延續摩爾定律，具有持續性的效能提升和相對應的成本優勢。系統整合晶片接下來可以使用傳統封裝或台積公司嶄新的 TSMC 3DFabric™技術，例如 CoWoS®或整合型扇出

(InFO) 來做封裝，以支援下一世代高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI) 和行動應用產品。目前已有多款 SoIC 產品正在驗證中，我們同時在規劃下一代 SoIC 平台，頻寬改進更多，成本也有競爭力。台積電將繼續追求 SoIC 技術改進，並與公司先進的矽技術共同優化，進一步提高電晶體密度、系統 PPA (功耗、性能及面積)，以及成本的優勢。

✓ CoWoS®

含有矽中介層的 CoWoS® 是針對高端高效能運算與人工智慧產品應用的 2.5D 領先技術。此技術之矽中介層具有次微米級的繞線層和整合電容 (integrated capacitors, iCap)，因此可以在上面放置系統單晶片 (SoC) 和高頻寬記憶體 (HBM) 等各種小晶片。新的 HBM3 (第三代 HBM) 已於民國一百一十一年通過 CoWoS®-S 認證。同時，正在開發在有機中介層中嵌入多重 LSI (局部矽互連) 的 CoWoS®-L 技術。與 CoWoS®-S 相比，CoWoS®-L 釋放了矽中介層的尺寸限制，並能加入更多功能以提升整體系統性能。

✓ 整合型扇出 (InFO)

民國一百一十一年，台積電持續領先業界大量生產第七代整合型扇出層疊封裝技術 (InFO_PoP Gen-7) 以支援行動應用。第八代 InFO_PoP 也已成功通過驗證支援行動應用並呈現更良好的散熱性能。第四代 InFO_oS 提供更多的晶片整合、支援更大封裝尺寸和頻寬需求，已在民國一百一十一年完成驗證。此外，以扇出層疊封裝技術為基礎，開發出多晶粒整合型扇出層疊封裝技術 (InFO_M PoP) 以支援穿戴應用，並於民國一百一十一年完成驗證。進一步提供背面線路重佈層 (RDL) 以整合通用型低功耗動態記憶體 (LPDDR) 的次世代 InFO_PoP 也如期進行開發。

➤ 先進導線技術

台積電提供給客戶獨特的導線製造技術，協助客戶設計出更具競爭力的產品。民國一百一十一年，創新發展的金屬化製程提供更低電阻的導線與導孔；此外，嶄新材料的開發同時達成了更低的電容。這些創新技術方案，實現出優良的晶片表現與更低的成本。

➤ 先進技術研究

低維度材料及元件的創新持續提升先進邏輯技術的效能並降低功耗。在民國一百一十一年，台積電保持在二維電晶體的研究走在業界前端。在民國一百一十一年的超大型積體電路技術與電路研討會 (Symposia on VLSI Technology and Circuits)，台積電利用半金屬 (Bi) 和二維二硫化鎢之間的弱耦合界面，展示了一種用於單層化學氣相沉積二硫化鎢的新型晶圓級半自動乾式轉移製程。使用這種半金屬輔助轉移製程，台積電展示了晶圓級單層化學氣相沉積二維二硫化鎢電晶體創紀錄的高電流和低接觸電阻。在民國一百一十一年舉行的國際電子元件會議 (International Electron Device Meeting, IEDM)，台積電成功地將基於鈹的原子層沉積較高介電常數介電質與化學氣相沉積生長的單層二維二硫化鉬整合，以構建具有等效氧化物厚度 ~1 奈米和近乎理想的 68

mV/dec 亞閾值擺幅的頂柵 N 型二維電晶體。也在民國一百一十一年 IEDM，台積公司首次成功地將單層二維二硫化鉬奈米片電晶體整合成閘極全環場效電晶體。具有高性能的二硫化鉬奈米片和奈米片堆疊模組的成功演示進一步闡明了將二維材料用於晶體微縮的價值主張。

台積公司繼續研究用於人工智慧和高效能運算應用的新興高密度、非揮發性記憶體元件和硬體加速器。在民國一百一十一年的國際固態電路會議（International Solid-State Circuits Conference, ISSCC），台積公司展示了具有混合單層單元和多層單元配置的 40 奈米相變化記憶體的記憶體內計算巨集。結合輸入重新排序方案以增強稀疏性，二百萬位元組的設計實現了業界最先進的能效。在民國一百一十一年 IEDM，台積公司提出了一種無生成（forming-free）的硫化物記憶體選擇器，其中引入了額外的缺陷以輔助生成過程並降低生成電壓（forming voltage）。基於矽氮鎢碳碲（SNGCT）的硫族化物的無生成低電壓記憶體選擇器被證明具有超過 10^{10} 次循環的高耐久性。

➤ 特殊製程技術

台積公司提供多樣化的新製程技術以協助客戶廣泛解決各類產品的應用：

✓ 混合訊號／射頻

過去幾年 COVID-19 疫情的限制使得 MS／RF 晶片在無線連接方面的需求不斷持續增長，例如 5G 通訊、WiFi7、物聯網等應用。民國一百一十一年，台積公司持續加強 RF 設計技術協同優化（DTCO），通過系統化的電路效能驗證，RF 技術平台已包含關鍵製程／元件選用／佈局優化。台積公司應用成果提供最佳性能／功率／成本的權衡解決方案，例如 6 奈米／12 奈米 FFC+用於收發器設計，16 奈米／28 奈米 HPC+用於 5G 毫米波前端模組（mmWave FEM）設計，以及增強型 40 奈米特殊製程用於 5G RF FEM 設計。

✓ 電源 IC／雙極-互補金屬氧化半導體-雙重擴散金屬氧化半導體（BCD）

民國一百一十一年，台積公司持續精進其 12 吋 BCD 技術的製程競爭力，55 奈米 BCD 針對行動裝置電源開關應用提昇 5 伏元件品質因素優化。延續 40 奈米 BCD 20/24 伏技術，公司將開發 28 伏及 5-16 伏高壓元件。22 奈米支援 5 伏到 20 伏 BCD 技術，目前進入可靠度驗證階段。公司也持續拓展 0.13 微米 BCD 技術支援 55 伏以因應車用市場需求。

✓ 微機電系統

民國一百一十一年，台積公司使用完成驗證的壓電微機電技術以量產具備高音質及快速響應的微機電揚聲器。同時，台積公司完成電容式超音波微換能器技術的驗證並進入量產，以生產高性能及低成本的醫療超音波影像晶片。此外，台積公司完成新一代微機電單晶片技術的驗證，以生產具備高可靠度的車用六軸慣性感測器，應用在新一代車輛的安全系統及自駕輔助系統上。未來計畫包含開發下一世代高敏感度壓電麥克風、高訊噪比車用六軸慣性感測器、醫療用單晶片超音波感測器等應用

✓ 氮化鎵半導體

民國一百一十一年，台積公司第一代 650 伏氮化鎵增強型高電子移動率電晶體（E-HEMT）已進入穩定量產階段。為滿足客戶的需求，在民國一百一十一年產能擴充至民國一百一十年的三倍。此外，為了持續保持台積公司於氮化鎵電晶體領域的領先優勢，第二代 650 伏和 100 伏 E-HEMT 已經進入最後可靠度驗證階段，預計於民國一百一十三年投入生產。台積公司也著眼氮化鎵功率元件於車用電子應用，正在開發第三代 650 伏增強型高電子移動率電晶體，預計於民國一百一十四年推出。

✓ 互補式金屬氧化物半導體（CMOS）影像感測器

民國一百一十一年，台積公司在互補式金屬氧化物半導體影像感測器技術獲致數項技術成果，包括：（1）開始試產畫素面積降低 16% 的新款次微米畫素技術，以支援行動影像感測市場；（2）運用三片晶圓堆疊技術，試產世上最小的電壓式全域快門金屬氧化物半導體影像感測器晶片，用於近紅外線與安控相機市場；（3）完成矽質飛時測距單光子崩潰二極體製程的技術移轉予量產工廠，以應用於三維距離偵測用途；（4）試產以 22 奈米邏輯晶圓作為影像訊號處理單元的堆疊式金氧半影像感測器，應用於高動態範圍車用影像感測。

✓ 嵌入式快閃記憶體／新興記憶體

民國一百一十一年，台積公司在嵌入式非揮發性記憶體（non-volatile memory, NVM）技術領域達成數項重要的里程碑。在 28 奈米製程方面，支援高效能行動運算與高效能低漏電製程平台的嵌入式快閃記憶體開發維持穩定的高良率，消費性電子級已進入量產，並通過最高規格第零級車用電子技術驗證，預計於民國一百一十三年完成產品驗證。台積公司亦提供電阻式隨機存取記憶體技術，作為低成本嵌入式非揮發性記憶體解決方案，支援對價格敏感的物聯網市場。40 奈米和 28 奈米已進入量產，而 22 奈米已準備量產。

台積公司也在嵌入式磁性隨機存取記憶體完成數項重要成就。支援車用電子應用的 16 奈米已於民國一百一十二年完成技術驗證。同時，台積公司也展示了下個世代的磁性記憶體把記憶體單元面積減少並且提升寫入速度與節省耗能的精進成果，可符合微控制器（MCU），虛擬實境（VR）與邊緣運算（AI-Edge）應用所需的要求。

（二）市場及產銷概況

1、市場分析

■ 市場分析

民國一百一十一年，台積公司估計全球半導體（不含記憶體）市場的產值達到美金4,920億元，較民國一百一十年成長10%。其中，從事半導體製造的積體電路製造服務業產值增加至美金1,300億元，較民國一百一十年強勁成長28%。

■ 台積公司卓越表現

民國一百一十一年，台積公司保持其在全球半導體業之積體電路製造服務

領域的領導地位，其產出占全球半導體（不含記憶體）市場產值的30%，較民國一百一十年的26%增加。台積公司的成長，主要係因5G及高效能運算（High Performance Computing, HPC）產業相關應用持續擴增所致。

擁有最先進的製程技術是台積公司在專業積體電路製造服務領域取得強大市場地位的重要關鍵。民國一百一十一年，有53%的晶圓營收來自先進製程技術（7奈米及以下更先進製程），高於民國一百一十年的50%。

台積公司提供客戶完備的製程技術，並且持續投資先進製程技術、特殊製程技術，以及先進封裝與矽堆疊技術，以提供客戶更多附加價值。

除了擁有在先進製程技術和特殊製程技術的領導地位，台積公司亦提供 TSMC 3DFabric™- 完備的三維矽堆疊（3D Silicon Stacking）和先進封裝系列技術，與其製程技術發揮相輔相成的效益。TSMC 3DFabric™系列技術為客戶提供更靈活的晶片設計彈性來釋放創新，是台積公司有別於競爭對手的另一差異化競爭優勢。

■ 台積公司之市場定位、差異化與策略

➤ 台積公司的市場定位

台積公司在先進製程技術、特殊製程技術，以及先進封裝技術的發展上，是全球積體電路製造服務領域的領導公司之一。民國一百一十一年，台積公司產出占全球半導體（不含記憶體）市場產值的30%，較民國一百一十年的26%增加。民國一百一十一年，台積公司營業收入淨額以地區劃分（主要依據客戶營運總部所在地），北美市場占68%、亞太市場（不含日本與中國大陸）占11%、中國大陸市場占11%、歐洲、中東及非洲市場占5%、日本市場占5%。依據產品平台來區分，高效能運算占41%、智慧型手機占39%、物聯網占9%、車用電子占5%。此外，消費性電子產品占3%、其他產品則為剩餘的3%。

➤ 台積公司的差異化優勢

台積公司的領導地位奠基於三大差異化競爭優勢及長期以來承襲的業務策略，公司憑藉「先進技術、卓越製造、客戶信任」在競爭中脫穎而出。

身為技術領導者之一，台積公司一直以來均是首家推出最新世代技術的專業積體電路製造服務公司；同時，台積公司也在較成熟的製程技術取得領先地位，此係因為台積公司將先進技術開發的經驗導入特殊製程技術所致。除了製程技術之外，台積公司優異的前段及後段製程整合能力，提供功耗、效能及晶片尺寸最佳化的競爭優勢，協助客戶更快速進入生產。

台積公司領先業界的積體電路製造能力已經獲得高度肯定；而「開放創新平台」（Open Innovation Platform® Initiative）以及台積大同盟（TSMC Grand Alliance），則更進一步強化台積公司的領導地位。台積公司的「開放創新平台」加速半導體設計產業與台積公司設計生態系統合作夥伴的創新，也加速台積公司自有矽智財開發、設計實現與可製造性設計能力、製程技術與後段服務的創新。「開放創新平台」是一個完整的設計生態系統，藉由台積公司所開發、支援的協同合作平台，加速

供應鏈各方面的創新，因而產生並共享新增的營收與獲利；而台積電大聯盟則是由台積電客戶、電子設計自動化（Electronic Design Automation, EDA）夥伴、矽智財（IP）夥伴、以及於民國一百一十一年十月正式宣佈成立新的3DFabric™聯盟夥伴、主要設備及原物料供應商及台積電所共同組成，是半導體產業中最強而有力的創新動能之一。透過此一嶄新、更高層次的協同合作，希望能夠協助客戶、聯盟成員及台積電都能贏得商機並強化競爭優勢。

台積電自民國七十六年成立以來，始終秉持「絕對不與客戶競爭」的承諾，而這正是客戶信任台積電的基礎。秉持此一承諾，台積電從未設計、生產或銷售任何自有品牌的晶片產品，而是投注公司所有努力與資源成為客戶所信賴的專業積體電路製造服務公司。

➤ 台積電策略

台積電深信，差異化的競爭優勢將使台積電更能把握未來積體電路製造服務領域的成長機會。針對高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子，以及消費性電子產品這五個主要市場，及因應客戶需求從以製程技術為中心轉變為以產品應用為中心，台積電已經分別建構五個對應的技術平台，提供客戶完備且具競爭優勢的邏輯製程技術、特殊製程技術、矽智財，以及封裝測試技術，協助客戶縮短晶片設計時程及加速產品上市速度。這五個技術平台分別為：

✓ 高效能運算

在巨量數據運算和應用創新的驅動下，高效能運算已成為台積電業務增長的主要動力之一。台積電為無晶圓廠設計公司及系統公司客戶提供領先的技術，例如 N3、N4、N5、N6、N7，和 12 奈米/16 奈米鰭式場效電晶體等邏輯製程技術，以及包括高速互連技術等完備的矽智財，以滿足客戶產品在任何地點和時間傳輸和處理大量資料的需求。尤其是，台積電推出了第一個為高效能運算產品所量身打造的製程技術—N4X，在台積電 5 奈米系列製程技術中，展現極致效能與最高運作時脈。基於先進製程技術，多種高效能運算產品已被導入市場，例如個人電腦中央處理器（Central processing unit, CPU）、繪圖處理器（Graphics processor unit, GPU）、可程式邏輯閘陣列（Field programmable gate array, FPGA）、伺服器處理器、加速器、高速網路晶片等。這些產品可以應用於當前及未來的 5G/6G 通訊基礎設備、人工智慧（AI）、雲端（Cloud）、和企業資料中心（Data center）。台積電也提供涵蓋 CoWoS®、InFO，和 TSMC-SoIC®的多種先進 TSMC 3DFabric™封裝及矽堆疊技術，協助完成異質和同質晶片整合，達到客戶對高效能、高計算密度和高能源效率、低延遲以及高度整合的需求。台積電將持續優化高效能運算平台，並強化與客戶協同合作，以幫助客戶掌握高效能運算領域的市場成長。

✓ 智慧型手機平台

針對客戶在頂級產品的應用，台積電提供領先的3奈米鰭式場效電晶體（3nm FinFET, N3）、4奈米鰭式場效電晶體（4nm FinFET, N4）及5奈米鰭式場效電晶體（5nm FinFET, N5）等邏輯製程技術以

及完備的矽智財，更進一步提升晶片效能、降低功耗及晶片尺寸大小。針對客戶在主流產品的應用，則提供廣泛多樣的邏輯製程技術，包括6奈米鰭式場效電晶體（6nm FinFET, N6）、7奈米鰭式場效電晶體強效版（7nm FinFET Plus, N7+）、7奈米鰭式場效電晶體（7nm FinFET, N7）、12奈米鰭式場效電晶體精簡型強效版（12nm FinFET Compact Plus, 12FFC+）、12奈米鰭式場效電晶體FinFET精簡型（12nm FinFET Compact, 12FFC）、16奈米鰭式場效電晶體精簡型強效版（16nm FinFET Compact Plus, 16FFC+）、16奈米鰭式場效電晶體精簡型（16nm FinFET Compact, 16FFC）、28奈米高效能精簡型製程技術（28nm High Performance Compact, 28HPC）、28奈米高效能精簡型強效版製程技術（28nm High Performance Compact Plus, 28HPC+），和22奈米超低功耗（22nm Ultra-Low Power, 22ULP）等，以及完備的矽智財，滿足客戶對高效能、低功耗晶片產品的需求。此外，不論頂級與主流產品應用，台積公司也提供客戶領先業界且具高度競爭力的特殊製程技術為客戶產出配搭邏輯應用處理器的特殊製程晶片，包括射頻、嵌入式快閃記憶體、新興記憶體、電源管理、感測器、顯示晶片等特殊製程技術，以及領先產業的多種先進TSMC 3DFabric™封裝技術，例如整合型扇出（InFO）技術。

✓ 物聯網平台

台積公司提供領先、完備，且高整合度的超低功耗（Ultra-Low Power, ULP）技術平台來實現智能物聯網（Artificial Intelligence of Things, AIoT）的產品創新。台積公司提供領先業界的技術，包括採用FinFET架構的新一代12奈米技術-N12e™技術，具備能源效率與高效能以提供更多運算能力及人工智慧推論（AI inferencing）能力、22奈米超低漏電（Ultra-low Leakage, ULL）技術、28奈米ULP技術、40奈米ULP技術，以及55奈米ULP技術，已被各種終端智能系統單晶片（Edge AI system-on-a-chip）和電池供電的應用廣泛採用。台積公司更進一步擴展其低操作電壓（Low Operating Voltage, Low Vdd）技術，並提供更寬操作電壓範圍的電子電路模擬模型，以滿足極低功耗（Extreme-low Power）產品應用。同時，台積公司也提供客戶具備競爭力且完備的射頻、強化版類比元件、嵌入式快閃記憶體、新興記憶體、感測器和顯示晶片、電源管理晶片等特殊製程技術，以及包括整合型扇出（InFO）技術的多種先進的TSMC 3DFabric™封裝技術，以支援智能物聯網邊緣計算和無線連網快速增長的需求。

✓ 車用電子平台

台積公司提供完備的技術與服務，以滿足車用電子產業中的三大應用趨勢：更安全、更智慧和更環保。同時，台積公司也是業界推出堅實的車用矽智財生態系統的領導公司之一，提供5奈米、7奈米與16奈米鰭式場效電晶體（FinFET）技術，以滿足汽車產業對先進駕駛輔助系統（Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS）、先進座艙系統（In-Vehicle Infotainment, IVI），及針對新型電子/電氣（Electrical/Electronic, E/E）架構的區域控制器的需求。台積公司於2023年推出3奈米技術 Auto Early（N3AE）解決方案，提供汽車製程設計套件（Process Design Kit, PDK），支援車用客戶提早採用業界

最先進的3奈米製程技術來設計更先進的汽車應用產品。

除了先進邏輯技術平台外，台積公司亦提供廣泛而且具競爭力的特殊製程技術，包括28奈米嵌入式快閃記憶體，28奈米、22奈米，和16奈米毫米波射頻，高靈敏度的互補式金氧半導體影像感測器（CMOS Image Sensor, CIS）／光學雷達（Light Detection and Ranging, LiDAR）感測器和電源管理晶片技術。新興的磁性隨機存取記憶體（Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM）方面，22奈米技術已符合汽車Grade-1標準的驗證，而16奈米技術也正順利開發中，以滿足汽車Grade-1標準的要求。這些技術均符合台積公司基於美國車用電子協會（Automotive Electronic Council, AEC）AEC-Q100汽車等級製程規格驗證標準，或客戶對技術規格的要求。

✓ 消費性電子產品平台

台積公司提供客戶領先且全面的技術，以推出應用於消費性電子產品人工智慧智能元件，包括數位電視（Digital TV, DTV）、機上盒（Set-top Box, STB）、具備人工智慧的智能數位相機（AI-embedded Smart Camera）及相關的無線區域網路（Wireless Local Area Network, WLAN）、電源管理晶片（Power Management IC, PMIC）、時序控制器（Timing Controller, T-CON）等。台積公司領先業界的7奈米鰭式場效電晶體（7nm FinFET, N7）、16FFC/12FFC、22ULP/ULL、以及28HPC+技術，已被全球領導的8K/4K數位電視、4K串流機上盒/過頂服務（Over-the-top）、數位單眼相機（Digital Single-lens Reflex, DSLR）等廠商廣泛採用。針對客戶數位密集的晶片設計，台積公司將持續縮小晶片尺寸，推出更具成本效益的技術，並推出更低功耗的技術，以利採用更具成本效益的封裝。

➤ 業務發展計畫

台積公司將繼續強化其核心競爭力，適切規劃公司長短期技術及業務發展策略，並協助客戶因應電子產品週期短以及市場上激烈競爭的挑戰，以達成投資報酬率與成長目標。

✓ 短期業務發展計畫

- 持續投資擴充產能及研發，以擴大市場及維持台積公司在先進製程技術領域的市場占有率。
- 開發新客戶及新的應用領域，以維持台積公司在主流技術製程領域的市場占有率。
- 持續強化高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子及消費性電子產品技術平台的競爭優勢，以擴展台積公司在這些產品應用的專業積體電路製造服務業務。
- 進一步拓展台積公司在新興市場及發展中市場的業務與服務。

✓ 長期業務發展計畫

- 持續依照可預測的節奏發展先進製程技術，提升節能運算效能。

- 進一步發展衍生性半導體製程技術，來增加特殊製程相關應用對營業的貢獻。
- 提供更多整合服務，涵蓋產品系統整合設計（System-Level Integration Design）、設計技術定義、設計工具發展、晶圓製造、TSMC 3DFabric™先進封裝與矽堆疊技術，以及後段封裝測試等，透過最佳化解決方案為客戶提供更高的價值。

2、最近二年度主要產品別毛利率重大變化說明

■ 最近二年度毛利率變動情形

項目 \ 年度	年度	
	110年度	111年度
毛利率(%)	51.63%	59.56%
毛利率變動(%)	(2.77%)	15.36%

- 毛利率較前一年度變動達百分之二十者，應分析造成價量變化之關鍵因素及對毛利率之影響：不適用。

二、轉投資事業

(一) 轉投資事業概況

截至民國一百一十二年九月三十日止

單位：新台幣仟元

轉投資事業 (註一)	主要營業項目	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市 價 (註六)	會計處理方法	最近年度投資報酬	
				股數 (仟股)	股權比例 %				投資(損)益 (註七)	分配股利
TSMC Global Ltd.	一般投資業務	355,162,309	450,233,116	11	100	450,233,116	-	子公司	7,308,722	-
TSMC Arizona Corporation (註二)	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售與測試	133,798,710	119,394,567	4,400	100	119,402,589	-	子公司	(9,430,070)	-
TSMC Partners, Ltd.	半導體設計、製造等相關投資業務及一般投資業務	31,456,130	70,167,087	988,268	100	70,227,990	-	子公司	3,135,764	-
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. (註三)	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計	52,630,042	47,543,240	2,269	71	47,544,372	-	子公司	(452,020)	-
世界先進積體電路股份有限公司	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計及光罩製造與設計服務	10,180,677	13,103,470	464,223	28	12,457,749	31,567,198	採權益法評價之被投資公司	4,322,799	2,089,006
采鈺科技股份有限公司	彩色濾光膜產品相關研究、設計、開發、製造、銷售及封裝測試	4,224,082	11,241,528	213,619	68	11,203,360	44,325,943	子公司	1,253,986	398,314
Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd.	積體電路及其他半導體裝置之製造與銷售	5,120,028	9,985,558	314	39	9,772,122	-	採權益法評價之被投資公司	1,373,234	-
TSMC North America	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務	333,718	6,235,197	11,000	100	6,235,197	-	子公司	62,213	-

轉投資事業 (註一)	主要營業項目	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市 價 (註六)	會計處理方法	最近年度投資報酬	
				股數 (仟股)	股權比例 %				投資(損)益 (註七)	分配股利
精材科技股份有限公司	晶圓級晶片尺寸之封裝及晶圓級後護層封裝業務	1,988,317	3,580,425	111,282	41	3,082,720	13,075,626	採權益法評價之被投資公司	813,516	333,846
創意電子股份有限公司	積體電路元件之研究、開發、生產、測試及銷售	386,568	2,238,136	46,688	35	3,131,246	63,728,928	採權益法評價之被投資公司	1,292,705	326,815
Emerging Fund L.P.	新創科技事業之投資	1,712,674	2,130,468	(註五)	99.9	2,130,468	-	子公司	(6,910)	100,063
TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.	工程支援業務	1,144,356	1,174,258	49	100	1,174,258	-	子公司	27,950	-
TSMC Europe B.V.	客戶服務及支援業務	15,749	569,867	-	100	569,867	-	子公司	(4,926)	-
TSMC Design Technology Japan, Inc.	工程支援業務	410,680	371,800	15	100	371,800	-	子公司	20,303	-
VentureTech Alliance Fund III, L.P.	新創科技事業之投資	1,242,679	267,497	(註五)	98	244,162	-	子公司	(6,566)	-
TSMC Japan Limited	客戶服務及支援業務	83,760	130,349	6	100	130,349	-	子公司	6,559	-
VentureTech Alliance Fund II, L.P.	新創科技事業之投資	260,300	99,903	(註五)	98	93,657	-	子公司	313	-
TSMC Korea Limited	客戶服務及支援業務	13,656	44,746	80	100	44,746	-	子公司	1,408	-
European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH (註四)	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計	3,359	2,331	-	100	2,331	-	子公司	-	-
TSMC Development, Inc.	半導體製造相關投資業務	18,946,972	39,842,511	-	100	39,842,511	-	子公司	(註八)	-

轉投資事業 (註一)	主要營業項目	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市 價 (註六)	會計處理方法	最近年度投資報酬	
				股數 (仟股)	股權比例 %				投資(損)益 (註七)	分配股利
TSMC Technology, Inc.	工程支援業務	461,038	1,217,826	-	100	1,217,826	-	子公司	(註八)	-
TSMC Design Technology Canada Inc.	工程支援業務	74,246	375,241	2,300	100	375,241	-	子公司	(註八)	-
Growth Fund Limited	新創科技事業之投資	74,100	192,788	(註五)	100	192,788	-	子公司	(註八)	72,589
相豐科技股份有限公司	電子零組件製造、電子材料批發及零售與無線射頻識別系統之研發及測試	51,435	13,969	4,693	28	13,969	-	採權益法評價之被投資公司	(註八、註九)	-
WaferTech, LLC (註十)	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售與測試	-	7,148,865	293,637	100	7,148,865	-	子公司	(註八)	1,824,060
台積電(中國)有限公司	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計	18,939,667	94,591,954	(註五)	100	94,962,436	-	子公司	12,223,165	-
台積電(南京)有限公司	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計	30,521,412	82,952,291	(註五)	100	82,963,359	-	子公司	20,473,263	-

註一：本公司之轉投資事業未持有本公司股票。

註二：TSMC Arizona Corporation (TSMC AZ) 於民國 112 年 10 月與 11 月辦理增資，增資後台積公司對 TSMC AZ 之持股數增加為 9,500,000 股，所有權百分比率維持為 100%。

註三：台積公司對 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. 所有權及表決權百分比分別為 71% 及 81%。

註四：European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH (ESMC) 於民國 112 年 6 月設立並增資，所有權百分比率為 100%。台積公司於民國 112 年 8 月 8 日董事會核准 ESMC 經監管機關核准並符合其他條件後，向博世、英飛凌和恩智浦各出售 10% 股權，出售後台積公司對 ESMC 之所有權百分比將由 100% 下降至 70%，惟仍須依實際交易情況而定。

註五：不適用，非股份有限公司未發行股票。台積公司之投資係以股權比例表示。

註六：本公司持股依該上市(櫃)轉投資事業公司民國一百一十二年九月二十八日收盤價計算之價值。

註七：本期認列之投資(損)益業已考量公司間交易之未實現損益之影響數。

註八：該被投資公司之損益業已包含於其投資公司，為避免混淆，於此不再另行表達。

註九：相豐科技股份有限公司於民國 112 年 10 月辦理增資，增資後 VentureTech Alliance Fund III, L.P. 對其之所有權百分比率由 28% 下降至 17%，對相豐公司不

再具有重大影響力，故自 112 年 11 月起停止採用權益法評價，並轉列為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
註十：WaferTech, LLC 於民國 112 年 12 月更名為 TSMC Washington, LLC。

(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權情形
無。

三、重要契約

除一般商業交易行為外，本公司目前並無簽訂其他重要契約。另本公司於民國一百一十一年度及民國一百一十二年第三季財務報告亦揭露「重大或有負債及未認列之合約承諾」(民國一百一十一年度財務報告第 76 頁及民國一百一十二年第三季財務報告第 53 頁)。

參、發行計畫及執行情形

一、本次發行限制員工權利新股應記載事項

(一) 資金來源

不適用。

(二) 本次發行限制員工權利新股發行及認股辦法

詳附件一。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項

不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項

不適用。

肆、財務概況

一、財務分析

(一) 台積公司及子公司財務分析

		民國 107 年	民國 108 年	民國 109 年	民國 110 年	民國 111 年	民國 112 年 前 3 季
財務結構	負債占資產比率 (%)	19.74	28.38	32.97	41.73	40.37	38.50
	長期資金占不動產、廠房及設備比率 (%)	163.20	123.79	137.80	151.18	149.25	144.11
償債能力	流動比率 (%)	279.46	139.25	176.97	217.32	217.42	214.68
	速動比率 (%)	248.76	124.92	154.35	190.61	193.65	187.33
	利息保障倍數 (次)	131.28	120.92	281.95	123.48	80.18	52.44
經營能力	應收款項週轉率 (次)	8.19	7.95	9.35	9.20	10.52	9.00
	平均收現日數	44.57	45.91	39.04	39.67	34.70	40.56
	存貨週轉率 (次)	6.02	6.20	5.70	4.65	4.42	3.82
	平均銷貨日數	60.63	58.87	64.04	78.49	82.58	95.55
	應付款項週轉率 (次)	16.56	15.48	15.45	17.10	17.40	16.75
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	0.97	0.88	0.92	0.90	0.97	0.70
	總資產週轉率 (次)	0.51	0.49	0.53	0.49	0.52	0.39
獲利能力	資產報酬率 (%)	17.34	15.99	20.69	18.56	23.64	15.48
	歸屬於母公司業主之權益報酬率 (%)	21.95	20.94	29.84	29.69	39.76	25.41
	營業利益占實收資本比率 (%)	147.94	143.73	218.58	250.66	432.42	255.00
	稅前利益占實收資本比率 (%)	153.30	150.34	225.52	255.73	441.25	270.28
	純益率 (%)	34.05	32.28	38.69	37.61	44.92	39.02
	基本每股盈餘 (元)	13.54	13.32	19.97	23.01	39.20	23.13
	稀釋每股盈餘 (元)	13.54	13.32	19.97	23.01	39.20	23.13
現金流量	現金流量比率 (%)	168.54	104.13	133.30	150.39	170.57	87.33
	現金流量允當比率 (%)	113.11	106.60	100.74	97.84	101.82	97.58
	現金再投資比率 (%)	9.06	8.45	11.24	13.56	17.25	7.42
槓桿度	營運槓桿度	2.28	2.41	1.97	2.05	1.77	2.00
	財務槓桿度	1.01	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01

最近二年度各項財務比率增減變動達 20%以上者，說明如下：

1. 利息保障倍數減少 35%：主要係因利息費用增加所致。
2. 資產報酬率增加 27%：主要係因淨利增加所致。
3. 歸屬於母公司業主之權益報酬率增加 34%：主要係因淨利增加所致。
4. 營業利益占實收資本比率增加 73%：主要係營業利益增加所致。
5. 稅前利益占實收資本比率增加 73%：主要係稅前利益增加所致。
6. 基本每股盈餘及稀釋每股盈餘增加 70%：主要係因淨利增加所致。
7. 現金再投資比率增加 27%：主要係因營業活動淨現金流量增加所致。

**財務比例計算公式如下：

1.財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（股東權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額

2.償債能力

(1) 流動比率＝流動資產／流動負債

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債

(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息費用

3.經營能力

(1) 應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝銷貨淨額／平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額

(2) 平均收現日數＝365／應收款項週轉率

(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨

(4) 平均銷貨日數＝365／存貨週轉率

(5) 應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額

(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額

(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額

4.獲利能力

(1) 資產報酬率＝〔稅後純益＋利息費用（1－稅率）〕／平均資產總額

(2) 歸屬於母公司業主之權益報酬率＝歸屬於母公司業主之稅後純益／平均歸屬於母公司業主之股東權益淨額

(3) 營業利益占實收資本比率＝營業利益／實收資本額

(4) 稅前利益占實收資本比率＝稅前利益／實收資本額

(5) 純益率＝稅後純益／銷貨淨額

(6) 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數

5.現金流量

(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債

(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）

(3) 現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金）

6.槓桿度

(1) 營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益

(2) 財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）

(二) 台積公司財務分析

		民國 107 年	民國 108 年	民國 109 年	民國 110 年	民國 111 年
財務結構	負債占資產比率 (%)	19.21	28.74	32.33	35.82	33.39
	長期資金占不動產、廠房及設備比率 (%)	170.43	127.39	135.80	141.47	144.83
償債能力	流動比率 (%)	143.26	58.64	85.37	111.12	124.39
	速動比率 (%)	113.07	45.81	65.93	84.33	100.95
	利息保障倍數 (次)	137.46	122.80	330.85	261.58	277.57
經營能力	應收款項週轉率 (次)	8.45	8.32	9.80	9.80	11.28
	平均收現日數	43.21	43.88	37.24	37.23	32.35
	存貨週轉率 (次)	6.31	6.65	6.13	4.98	4.84
	平均銷貨日數	57.89	54.91	59.58	73.23	75.43
	應付款項週轉率 (次)	16.22	15.10	14.89	17.06	17.68
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	1.00	0.91	0.93	0.93	1.04
	總資產週轉率 (次)	0.51	0.49	0.52	0.52	0.58
獲利能力	資產報酬率 (%)	17.62	16.00	20.74	19.59	26.14
	股東權益報酬率 (%)	21.95	20.94	29.84	29.69	39.76
	營業利益占實收資本比率 (%)	148.10	141.12	209.59	242.82	420.64
	稅前利益占實收資本比率 (%)	152.79	149.92	224.69	254.72	439.90
	純益率 (%)	34.29	32.58	39.39	37.88	45.13

		民國 107 年	民國 108 年	民國 109 年	民國 110 年	民國 111 年
	基本每股盈餘 (元)	13.54	13.32	19.97	23.01	39.20
	稀釋每股盈餘 (元)	13.54	13.32	19.97	23.01	39.20
現金流量	現金流量比率 (%)	173.17	98.00	114.56	153.79	173.41
	現金流量允當比率 (%)	113.52	106.59	99.88	97.62	104.90
	現金再投資比率 (%)	9.23	8.23	10.93	14.20	18.23
槓桿度	營運槓桿度	2.28	2.46	2.04	2.11	1.81
	財務槓桿度	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00

最近二年度各項財務比率增減變動達 20%以上者，說明如下：

1. 速動比率增加 20%：主要係因現金及約當現金增加所致。
2. 資產報酬率增加 33%：主要係因淨利增加所致。
3. 股東權益報酬率增加 34%：主要係因淨利增加所致。
4. 營業利益占實收資本比率增加 73%：主要係營業利益增加所致。
5. 稅前利益占實收資本比率增加 73%：主要係稅前利益增加所致。
6. 基本每股盈餘及稀釋每股盈餘增加 70%：主要係因淨利增加所致。
7. 現金再投資比率增加 28%：主要係因營業活動淨現金流量增加所致。

**財務比例計算公式如下：

1.財務結構

- (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額
- (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (股東權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額

2.償債能力

- (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債
- (3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息費用

3.經營能力

- (1) 應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據) 週轉率 = 銷貨淨額 / 平均應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據) 餘額
- (2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率
- (3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨
- (4) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率
- (5) 應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據) 週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據) 餘額
- (6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額
- (7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額

4.獲利能力

- (1) 資產報酬率 = [稅後純益 + 利息費用 (1 - 稅率)] / 平均資產總額
- (2) 股東權益報酬率 = 稅後純益 / 平均股東權益淨額
- (3) 營業利益占實收資本比率 = 營業利益 / 實收資本額
- (4) 稅前利益占實收資本比率 = 稅前利益 / 實收資本額
- (5) 純益率 = 稅後純益 / 銷貨淨額
- (6) 每股盈餘 = (稅後純益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數

5.現金流量

- (1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債
- (2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度 (資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)
- (3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)

6.槓桿度

- (1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益
- (2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)

二、財務報告應記載事項

- (一) 最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告。

- 1.民國一百一十年度合併財務報表及會計師查核報告：請詳附件三。
- 2.民國一百一十一年度合併財務報表及會計師查核報告：請詳附件四。
- 3.民國一百一十二年第三季合併財務報表及會計師核閱報告：請詳附件五。

(二) 最近二年度經會計師查核簽證之年度個體財務報告

- 1.民國一百一十年度個體財務報表及會計師查核報告：請詳附件六。
- 2.民國一百一十一年度個體財務報表及會計師查核報告：請詳附件七。

(三) 申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告

無。

三、財務概況應記載事項

最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第 185 條情事者：

最近二年度及截至公開說明書刊印日止無此情事。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一) 財務狀況

1、台積公司及子公司財務報表

單位：新台幣仟元

項目	民國 110 年	民國 111 年	增減金額	增減比率 (%)
流動資產	1,607,072,907	2,052,896,744	445,823,837	28%
長期投資(註一)	29,384,701	68,927,920	39,543,219	135%
不動產、廠房及設備	1,975,118,704	2,693,836,970	718,718,266	36%
使用權資產	32,734,537	41,914,136	9,179,599	28%
無形資產	26,821,697	25,999,155	(822,542)	-3%
其他資產(註二)	54,370,909	81,203,953	26,833,044	49%
資產總額	3,725,503,455	4,964,778,878	1,239,275,423	33%
流動負債	739,503,358	944,226,817	204,723,459	28%
非流動負債	815,266,892	1,060,063,194	244,796,302	30%
負債總額	1,554,770,250	2,004,290,011	449,519,761	29%
股本	259,303,805	259,303,805	0	0%
資本公積	64,761,602	69,330,328	4,568,726	7%
保留盈餘	1,906,829,661	2,637,524,688	730,695,027	38%
其他權益	(62,608,515)	(20,505,626)	42,102,889	67%
歸屬於母公司業主之權益	2,168,286,553	2,945,653,195	777,366,642	36%
權益總額	2,170,733,205	2,960,488,867	789,755,662	36%

註一：長期投資包含非流動之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、非流動之按攤銷後成本衡量之金融資產及採用權益法之投資。

註二：其他資產係包含遞延所得稅資產、存出保證金及其他非流動資產。

■ 增減比例超過20%之變動分析：

流動資產增加：主要係現金及約當現金增加所致。

長期投資增加：主要係按攤銷後成本衡量之金融資產增加所致。

不動產、廠房及設備增加：主要係待驗設備及未完工程增加所致。

使用權資產增加：主要係土地租賃增加所致。

其他資產增加：主要係遞延所得稅資產增加所致。

資產總額增加：主要係流動資產及不動產、廠房及設備增加所致。

流動負債增加：主要係應付費用及其他流動負債增加所致。

非流動負債增加：主要係民國111年度發行公司債所致。

負債總額增加：主要係民國111年度發行公司債及應付費用及其他流動負債增加所致。

保留盈餘增加：主要係民國111年度淨利，部分因分配盈餘而抵銷。

其他權益增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。

歸屬於母公司業主之權益增加：主要係保留盈餘增加所致。

權益總額增加：主要係歸屬於母公司業主之權益增加所致。

■ 最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

■ 未來因應計畫：不適用。

2、台積公司財務報表

單位：新台幣仟元

項目	民國 110 年	民國 111 年	增減金額	增減比率 (%)
流動資產	783,205,937	1,118,550,389	335,344,452	43%
長期投資(註一)	603,640,944	728,961,910	125,320,966	21%
不動產、廠房及設備	1,889,970,529	2,432,675,050	542,704,521	29%
使用權資產	30,123,052	39,051,427	8,928,375	30%
無形資產	22,910,400	21,456,104	(1,454,296)	-6%
其他資產(註二)	48,644,283	81,724,184	33,079,901	68%
資產總額	3,378,495,145	4,422,419,064	1,043,923,919	31%
流動負債	704,833,370	899,245,600	194,412,230	28%
非流動負債	505,375,222	577,520,269	72,145,047	14%
負債總額	1,210,208,592	1,476,765,869	266,557,277	22%
股本	259,303,805	259,303,805	0	0%
資本公積	64,761,602	69,330,328	4,568,726	7%
保留盈餘	1,906,829,661	2,637,524,688	730,695,027	38%
其他權益	(62,608,515)	(20,505,626)	42,102,889	67%
權益總額	2,168,286,553	2,945,653,195	777,366,642	36%

註一：長期投資包含非流動之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及採用權益法之投資。

註二：其他資產係包含遞延所得稅資產、存出保證金及其他非流動資產。

■ 增減比例超過20%之變動分析：

流動資產增加：主要係現金及約當現金增加所致。

長期投資增加：主要係採權益法之投資增加所致。

不動產、廠房及設備增加：主要係待驗設備及未完工程增加所致。

使用權資產增加：主要係土地租賃增加所致。

其他資產增加：主要係遞延所得稅資產增加所致。

資產總額增加：主要係流動資產及不動產、廠房及設備增加所致。

流動負債增加：主要係應付費用及其他流動負債增加所致。

負債總額增加：主要係民國111年度發行公司債及應付費用及其他流動負債增加所致。

保留盈餘增加：主要係民國111年度淨利，部分因分配盈餘而抵銷。

其他權益增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。

權益總額增加：主要係保留盈餘增加所致。

■ 最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

■ 未來因應計畫：不適用。

(二) 財務績效

1、台積公司及子公司財務報表

單位：新台幣仟元

項目	民國 110 年	民國 111 年	增減金額	增減比率 (%)
營業收入淨額	1,587,415,037	2,263,891,292	676,476,255	43%
營業成本	767,877,771	915,536,486	147,658,715	19%
營業毛利	819,537,266	1,348,354,806	528,817,540	65%
營業費用	169,222,934	226,707,552	57,484,618	34%
其他營業收益及費損淨額	(333,435)	(368,403)	(34,968)	-10%
營業淨利	649,980,897	1,121,278,851	471,297,954	73%
營業外收入及支出	13,145,417	22,911,867	9,766,450	74%
稅前淨利	663,126,314	1,144,190,718	481,064,404	73%
所得稅費用	66,053,180	127,290,203	61,237,023	93%
本年度淨利	597,073,134	1,016,900,515	419,827,381	70%
其他綜合（損）益（稅後淨額）	(7,619,456)	42,430,165	50,049,621	NM
本年度綜合損益總額	589,453,678	1,059,330,680	469,877,002	80%
本年度歸屬予母公司業主淨利	596,540,013	1,016,530,249	419,990,236	70%
本年度歸屬予母公司業主綜合損益	588,918,059	1,059,124,890	470,206,831	80%

■ 增減比例超過20%的變動分析

營業收入淨額增加：主要係平均銷售單價提高、晶圓出貨量增加及受匯率變動增加所致。

營業毛利增加：主要係平均銷售單價提高、有利的匯率變動及持續成本改善所致，部分受產能利用率下降所抵銷。

營業費用增加：主要係研究發展費用增加所致。

營業淨利增加：主要係因營業毛利增加所致。

營業外收入及支出增加：主要係因利息收入增加所致。

稅前淨利增加：主要係因營業淨利增加所致。

所得稅費用及淨利增加：主要係因稅前淨利增加所致。

其他綜合（損）益（稅後淨額）增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。

綜合損益總額、歸屬予母公司業主淨利及歸屬予母公司業主綜合損益增加：主要係淨利增加所致。

■ 預期未來一年銷售數量及其依據

請參閱本公司111年年報「致股東報告書-未來展望」（第10-11頁）。

■ 最近二年度財務績效變動影響：對財務績效無顯著影響。

■ 未來因應計畫：不適用。

2、台積公司財務報表

單位：新台幣仟元

項目	民國 110 年	民國 111 年	增減金額	增減比率 (%)
營業收入淨額	1,574,745,881	2,252,320,561	677,574,680	43%
營業成本	786,116,844	951,927,673	165,810,829	21%
營業毛利	788,629,037	1,300,392,888	511,763,851	65%
營業費用	158,667,757	209,637,924	50,970,167	32%
其他營業收益及費損淨額	(328,444)	(8,275)	320,169	97%
營業淨利	629,632,836	1,090,746,689	461,113,853	73%
營業外收入及支出	30,869,355	49,927,127	19,057,772	62%
稅前淨利	660,502,191	1,140,673,816	480,171,625	73%
所得稅費用	63,962,178	124,143,567	60,181,389	94%
本年度淨利	596,540,013	1,016,530,249	419,990,236	70%
其他綜合（損）益（稅後淨額）	(7,621,954)	42,594,641	50,216,595	NM
本年度綜合損益總額	588,918,059	1,059,124,890	470,206,831	80%

■ 增減比例超過20%的變動分析

營業收入淨額增加：主要係平均銷售單價提高、晶圓出貨量增加及受匯率變動增加所致。

營業成本增加：主要係因營業收入增加，致營業成本隨之增加。

營業毛利增加：主要係平均銷售單價提高、有利的匯率變動及持續成本改善所致，部分受產能利用率下降所抵銷。

營業費用增加：主要係研究發展費用增加所致。

其他營業收益及費損淨額增加：主要係因認列處分及報廢不動產、廠房及設備淨益所致。

營業淨利增加：主要係因營業毛利增加所致。

營業外收入及支出增加：主要係採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額增加所致。

稅前淨利增加：主要係因營業淨利增加所致。

所得稅費用及淨利增加：主要係因稅前淨利增加所致。

其他綜合（損）益（稅後淨額）增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。

綜合損益總額增加：主要係淨利增加所致。

■ 預期未來一年銷售數量及其依據

請參閱本公司 111 年年報「致股東報告書-未來展望」（第 10-11 頁）。

■ 最近二年度財務績效變動影響：對財務績效無顯著影響。

■ 未來因應計畫：不適用。

（三）現金流量

1、台積公司及子公司財務報表

單位：新台幣仟元

年初現金餘額 (民國 110 年 12 月 31 日)	全年來自營業 活動淨現金流 量(民國 111 年)	全年因投資活 動淨現金流量 (民國 111 年)	全年因籌資 活動淨現金 流量(民國 111 年)	全年因匯率 變動對現金 及約當現金 之影響 (民國 111 年)	現金剩餘數額 (民國 111 年 12 月 31 日)	流動性 不足之 改善計 畫	
						投資 計畫	融資 計畫
1,064,990,192	1,610,599,188	(1,190,928,235)	(200,244,032)	58,396,970	1,342,814,083	無	無

■ 民國111年度現金流量變動分析

營業活動之現金流入約新台幣16,106億元：主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。

投資活動之現金流出約新台幣11,909億元：主要係用於資本支出。

籌資活動之現金流出約新台幣2,002億元：主要係因償還短期借款及發放現金股利，部分因發行公司債而抵銷。

■ 流動性不足之改善計畫及流動性分析：無現金流動性不足之情形。

■ 未來一年現金流動性分析：不適用。

2、台積公司財務報表

單位：新台幣仟元

年初現金餘額 (民國 110 年 12 月 31 日)	全年來自營業 活動淨現金流 量(民國 111 年)	全年因投資活 動淨現金流量 (民國 111 年)	全年因籌資活 動淨現金流量 (民國 111 年)	現金剩餘數額 (民國 111 年 12 月 31 日)	流動性不足之 改善計畫	
					投資 計畫	融資 計畫
396,294,241	1,559,417,480	(944,001,551)	(382,834,273)	628,875,897	無	無

■ 民國111年度現金流量變動分析

營業活動之現金流入約新台幣15,594億元：主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷

費用。

投資活動之現金流出約新台幣9,440億元：主要係用於資本支出。

籌資活動之現金流出約新台幣3,828億元：主要係償還短期借款及發放現金股利，部分因發行公司債而抵銷。

■ 流動性不足之改善計畫及流動性分析：無現金流動性不足之情形。

■ 未來一年現金流動性分析：不適用。

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

單位：新台幣仟元

計畫	實際或預計之 資金來源	所需資金總額 (民國 110 年及 111 年)	實際資金運用情形	
			民國 110 年	民國 111 年
生產、研發及 廠務設備	自有資金及發 行公司債	1,903,407,434	831,096,598	1,072,310,836
其他	自有資金	18,460,404	8,099,110	10,361,294
合計		1,921,867,838	839,195,708	1,082,672,130

基於上述之資本支出，民國一百一十一年台積公司產能約增加120萬片約當十二吋晶圓。

(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

台積公司採用權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的。民國一百一十一年，台積公司在合併基礎之下，採權益法之轉投資獲利為新台幣 7,798,359 仟元，較前一年增加，主要原因為產品需求增加。未來台積公司採用權益法之轉投資仍將以長期策略性投資為原則，並持續審慎評估。

(六) 其他重要事項：無。

伍、特別記載事項

- 一、委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形

本公司無需委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。

- 二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告

不適用。

- 三、證券承銷商評估總結意見

不適用。

- 四、律師法律意見書

不適用。

- 五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見

請參照附件二。

- 六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應補充揭露之事項

不適用。

- 七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者

無。

- 八、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書。

不適用。

- 九、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書。

不適用。

- 十、公司治理運作情形

台積公司堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。基於這樣的理念，台積公司董事會授權其下設立之「審計暨風險委員會」、「薪酬暨人才發展委員會」，及「提名及公司治理暨永續委員會」，分別協助董事會履行其職責，且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

(一) 董事會運作情形

- 一、董事任期：自民國一百一十年七月二十六日至民國一百一十三年七月二十五日止。

- 二、台積公司董事長劉德音博士於民國一百一十一年度及截至公開說明書刊印日止共召開八次董事常會以及二次臨時董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
董事長	劉德音	10	0	100%	無
副董事長	魏哲家	10	0	100%	無
董事	行政院國家發展基金 管理會 代表人：龔明鑫	8	2	80%	無
董事	曾繁城	10	0	100%	無
獨立董事	彼得·邦菲爵士	10	0	100%	無
獨立董事	陳國慈	10	0	100%	無
獨立董事	麥克·史賓林特	9	1	90%	無
獨立董事	摩西·蓋弗瑞洛夫	10	0	100%	無
獨立董事	海英俊	10	0	100%	無
獨立董事	拉斐爾·萊夫	10	0	100%	無
其他應記載事項： 一、（一）證券交易法第十四條之三所列事項：本公司已設置審計暨風險委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本公開說明書「審計暨風險委員會運作情形」。 （二）其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。 三、加強董事會職能之目標： - 本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中包含一名女性董事，且獨立董事人數占全體董事席次的 60%。 - 台積公司董事長不兼任公司經理人職務。 - 台積公司為持續追求更完善的公司治理，董事會進一步於民國一百一十二年二月核准新增並強化其下委員會職責，包括變更「審計委員會」名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及為強化董事的選任機制，建構多元化及專業化的董事成員，參考國際做法設立「提名及公司治理暨永續委員會」。 - 台積公司董事會於民國一百一十二年五月訂定「公司治理政策」。					

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期執行一次	民國111年1月1日至 民國111年12月31日	• 董事會 • 個別董事成員 • 審計委員會	• 董事會內部自評 • 董事成員自評	董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 審計委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質

				4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制
--	--	--	--	----------------------------

本公司已完成民國一百一十一年度董事會績效自評，評估結果並提送民國一百一十二年第一季董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為 4.76（滿分 5 分），其中一項「董事會有適當討論 ESG 之參與及執行情形」之平均分數為 4.9，個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.9（滿分 5 分），顯示整體董事會運作良好；審計委員會績效自評結果，各委員均 100%滿意各衡量項目。

(二) 審計暨風險委員會運作情形

一、委員任期：自民國一百一十年七月二十六日至民國一百一十三年七月二十五日止。

二、審計暨風險委員會主席彼得·邦菲爵士於民國一百一十一年度及截至公開說明書刊印日止共召開八次常會。除上述會議外，另召開二次臨時會及六次電話會議，審閱有關本公司依中華民國及美國法令規定編製之年報及法人說明會資料。審計暨風險委員會及財務專家顧問出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	電話會議次數	電話會議出席率(%)	備註
主席	彼得·邦菲爵士	10	0	100%	6	100%	無
委員	陳國慈	9	1	90%	6	100%	無
委員	麥克·史賓林特	10	0	100%	5	83%	無
委員	摩西·蓋弗瑞洛夫	10	0	100%	5	83%	無
委員	海英俊	10	0	100%	6	100%	無
委員	拉斐爾·萊夫	8	2	80%	4	67%	無
財務專家顧問	羅貝茲	10	0	100%	6	100%	無

其他應記載事項：

一、(一) 證券交易法第十四條之五所列事項：

審計暨風險委員會開會日期 (期別)	議案內容
2 月 14 日 (民國 111 年第一次常會)	● 民國 110 年度財務報表 ● 民國 110 年度營業報告書 ● 民國 110 年第四季盈餘分派 ● 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 ● 發行民國 110 年限制員工權利新股共 1,387,000 股 ● 發行民國 111 年限制員工權利新股案 ● 追認為發行 35 億美元公司債由簽證會計師所提供之擔保函服務 ● 為 TSMC Japan 3DIC R&D Center 額外增加之民

	國 111 年簽證會計師服務公費 ● 民國 110 年度「內部控制制度聲明書」
4 月 12 日 (民國 111 年第一次臨時會)	● 修訂發行民國 111 年限制員工權利新股案
5 月 9 日 (民國 111 年第二次常會)	● 民國 111 年第一季財務報表 ● 民國 111 年第一季營業報告書 ● 民國 111 年第一季盈餘分派 ● 修訂內部控制相關之政策與程序
8 月 8 日 (民國 111 年第三次常會)	● 民國 111 年第二季財務報表 ● 民國 111 年第二季營業報告書 ● 民國 111 年第二季盈餘分派 ● 追認本公司非流動之有價證券之投資 ● 追認為全球員工股票購買計畫及南京子公司，額外增加之民國 111 年簽證會計師服務公費及代墊費用 ● 為擬計畫發行之美元公司債由簽證會計師所提供之擔保函服務，以及為覆核 IFRS 期中財務報表所額外提供之服務與增加之服務公費
11 月 7 日 (民國 111 年第四次常會)	● 民國 111 年第三季財務報表 ● 民國 111 年第三季營業報告書 ● 民國 111 年第三季盈餘分派 ● 自民國 112 年起本公司簽證會計師事務所之新委任主辦會計師為吳世宗會計師，以及民國 112 年簽證會計師服務公費及代墊費用
2 月 13 日 (民國 112 年第一次常會)	● 民國 111 年度財務報表 ● 民國 111 年度營業報告書 ● 民國 111 年第四季盈餘分派 ● 於不超過美金 35 億元之額度內增資 TSMC Arizona ● 於不高於美金 30 億元之額度及不超過一年之貸與期間，為 TSMC Arizona 提供資金貸與 ● 修訂本公司「背書保證作業程序」 ● 發行新台幣公司債 ● 發行民國 111 年限制員工權利新股共 2,110,000 股 ● 發行民國 112 年限制員工權利新股案 ● 民國 111 年度「內部控制制度聲明書」
5 月 8 日 (民國 112 年第二次常會)	● 民國 112 年第一季財務報表 ● 民國 112 年第一季營業報告書 ● 民國 112 年第一季盈餘分派 ● 發行新台幣公司債 ● 修訂內部控制相關之政策與程序
8 月 7 日 (民國 112 年第三次常會)	● 民國 112 年第二季財務報表 ● 民國 112 年第二季營業報告書 ● 民國 112 年第二季盈餘分派 ● 於不超過歐元 3,499,930,000 元之額度內增資 ESMC ● 於不超過美金 45 億元之額度內增資 TSMC Arizona ● 追認本公司非流動之有價證券之投資
11 月 13 日 (民國 112 年第四次常會)	● 民國 112 年第三季財務報表 ● 民國 112 年第三季營業報告書 ● 民國 112 年第三季盈餘分派 ● 出售本公司既有機器設備予 JASM

		● 民國 113 年簽證會計師服務公費及代墊費用
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無		
審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理：本公司審計暨風險委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計暨風險委員會之建議，核准通過所有議案。		
(二) 其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。		
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。		
三、獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：		
(一) 本公司內部稽核主管定期與審計暨風險委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計暨風險委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計暨風險委員會委員報告。民國一百一十一年度及截至公開說明書刊印日止並無上述特殊狀況。本公司審計暨風險委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。		
(二) 本公司簽證會計師於每季的審計暨風險委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計暨風險委員會委員報告，民國一百一十一年度及截至公開說明書刊印日止並無上述特殊狀況。本公司審計暨風險委員會與簽證會計師溝通狀況良好。		
獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師溝通事項如下表：		
審計暨風險委員會開會日期（期別）	與內部稽核主管溝通之重大事項	與簽證會計師溝通之重大事項
2 月 14 日 （民國 111 年第一次常會）	● 內部稽核報告（單獨會議） ● 民國 110 年度 SOX 404 內控自評結果報告（單獨會議） ● 民國 110 年度「內部控制制度聲明書」（單獨會議）	● 簽證會計師資歷、績效及獨立性 ● 法規變動報告 ● 民國 110 年度財務報表查核情況，包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
5 月 9 日 （民國 111 年第二次常會）	● 內部稽核報告（單獨會議） ● 修訂內部控制相關之政策與程序（單獨會議）	● 簽證會計師民國 110 年績效評量問卷結果 ● 法規變動報告 ● 民國 111 年第一季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
8 月 8 日 （民國 111 年第三次常會）	● 內部稽核報告（單獨會議）	● 法規變動報告 ● 民國 111 年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
11 月 7 日 （民國 111 年第四次常會）	● 內部稽核報告（單獨會議） ● 民國 112 年內部稽核年度計畫（單獨會議）	● 法規變動報告 ● 民國 111 年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
2 月 13 日 （民國 112 年第一次常會）	● 內部稽核報告（單獨會議） ● 民國 111 年度 SOX 404 內控自評結果報告（單獨會議） ● 民國 111 年度「內部控制制度聲明書」（單獨會議）	● 簽證會計師資歷、績效及獨立性 ● 法規變動報告 ● 民國 111 年度財務報表查核情況，包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

5月8日 (民國112年第二次常會)	● 內部稽核報告(單獨會議) ● 修訂內部控制相關之政策與程序(單獨會議)	● 簽證會計師民國111年績效評量問卷結果 ● 聽取簽證會計師之德勤中國及KY事件報告 ● 法規變動報告 ● 民國112年第一季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應(單獨會議)
8月7日 (民國112年第三次常會)	● 內部稽核報告(單獨會議)	● 法規變動報告 ● 民國112年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應(單獨會議)
11月13日 (民國112年第四次常會)	● 內部稽核報告(單獨會議) ● 民國113年內部稽核年度計畫(單獨會議)	● 法規變動報告 ● 民國112年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應(單獨會議)
結果：上述事項皆經審計暨風險委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。		

(三) 薪酬暨人才發展委員會組成及運作情形

薪酬暨人才發展委員會委員所具專業資格及獨立性情形如下：

姓名及身份別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他台灣公開發行公司薪酬委員會成員家數
麥克·史賓林特 (主席) 獨立董事		本公司薪酬暨人才發展委員會由全體六位獨立董事組成，委員之工作年資及專業資格與經驗請參閱本公開說明書「壹、三、(二)、1、董事會成員簡介」	所有薪酬暨人才發展委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(註)相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司普通股股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
彼得·邦菲爵士 獨立董事				0
陳國慈 獨立董事				0
摩西·蓋弗瑞洛夫 獨立董事				0
海英俊 獨立董事				1
拉斐爾·萊夫 獨立董事				0

註：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

1. 公司或其關係企業之受僱人。
2. 公司或其關係企業之董事、監察人。
3. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
4. (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5. 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
7. 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
8. 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
9. 為公司或其關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配

偶。

薪酬暨人才發展委員會運作情形如下：

- 一、 本公司之薪酬暨人才發展委員會委員計六人。
- 二、 委員任期：自民國一百一十年七月二十六日至民國一百一十三年七月二十五日止。
- 三、 薪酬暨人才發展委員會主席麥克·史賓林特先生於民國一百一十一年度及截至公開說明書刊印日止共召開八次常會以及一次臨時會，薪酬暨人才發展委員會委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
主席	麥克·史賓林特	9	0	100%	無
委員	彼得·邦菲爵士	9	0	100%	無
委員	陳國慈	9	0	100%	無
委員	摩西·蓋弗瑞洛夫	9	0	100%	無
委員	海英俊	9	0	100%	無
委員	拉斐爾·萊夫	8	1	89%	無

其他應記載事項：

- 一、 薪酬暨人才發展委員會於民國 111 年 2 月 14 日、5 月 9 日、8 月 8 日、11 月 7 日及民國 112 年 2 月 13 日、5 月 8 日、8 月 7 日及 11 月 13 日召開八次常會，民國 111 年 4 月 12 日召開一次臨時會，討論事由包括：
 - 員工薪酬相關事項報告
 - 每季業績獎金總額
 - 年度酬勞（分紅）總額
 - 經理人、總裁、董事長每季業績獎金
 - 董事及經理人年度酬金與年報資訊揭露
 - 民國 110 年度限制員工權利新股給與
 - 民國 111 年度限制員工權利新股發行辦法
 - 民國 111 年度限制員工權利新股給與
 - 民國 112 年度限制員工權利新股發行辦法
 - 全球員工購股計劃
 - 組織與傳承計劃討論
 - 變更薪酬委員會名稱為薪酬暨人才發展委員會上述事項皆經薪酬暨人才發展委員會審閱或核准通過。
- 二、 董事會不採納或修正薪酬暨人才發展委員會之建議：無。
- 三、 薪酬暨人才發展委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。

(四) 提名及公司治理暨永續委員會組成及運作情形

- 一、 依據台積公司提名及公司治理暨永續委員會組織章程，該委員會應由董事長及三至六位獨立董事組成。台積公司提名及公司治理暨永續委員會的成員目前由董事長及全體六位獨立董事組成。提名及公司治理暨永續委員會旨在協助董事會遴選獨立董事候選人提名名單，建構多元化及專業化的董事成員，以及對公司治理及永續發展相關議題提供建言。
- 二、 本公司董事會於民國一百一十二年二月十四日設立提名及公司治理暨永續委員會，該委員會委員計七人。
- 三、 委員任期：自民國一百一十二年二月十四日至民國一百一十三年七月二十五日止。
- 四、 提名及公司治理暨永續委員會主席摩西·蓋弗瑞洛夫先生於民國一百一十二年截至公開說明書刊印日止，共召開五次會議，提名及公司治理暨

永續委員會委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

條件 姓名及身份別	專業資格與經驗	實際 出席次數	委託出席 次數（註）	實際 出席率（%）	備註
摩西・蓋弗瑞洛夫（主席） 獨立董事	本公司提名及公司治理暨永續委員會由董事長及全體六位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本公開說明書「壹、三、（二）、1、董事會成員簡介」	5	-	100%	新任
劉德音 董事長		5	-	100%	新任
彼得・邦菲爵士 獨立董事		5	-	100%	新任
陳國慈 獨立董事		5	-	100%	新任
麥克・史賓林特 獨立董事		5	-	100%	新任
海英俊 獨立董事		5	-	100%	新任
拉斐爾・萊夫 獨立董事		4	-	80%	新任
其他應記載事項： 一、提名及公司治理暨永續委員會於民國 112 年 2 月 14 日、3 月 23 日、5 月 8 日、8 月 7 日及 11 月 13 日召開五次常會，主要討論事由包括： － 本委員會之運作 － 可能的獨立董事候選人名單 － 訂定本公司「公司治理政策」 － 「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」 － ESG 季度報告 － 年度審閱「提名及公司治理暨永續委員會組織章程」及職責履行情形 上述事項皆經提名及公司治理暨永續委員會審閱、討論或核准通過，董事會並依提名及公司治理暨永續委員會之建議，核准通過所有議案。 二、提名及公司治理暨永續委員會之決議事項，成員反對事項內容：無。 註：本委員會委員應以親自出席會議為原則，並無設有委託出席制度。					

(五) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司經董事會決議通過訂定「公司治理政策」，並揭露於公司網站。	無
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V		(一) 本公司依內部作業程序責成包括法人關係處、企業公共關係處、股務及上市法規遵循部、法務等相關部門處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜，並依程序實施。 (二) 本公司隨時掌握董事、經理人及持股前十名股東之持股情形。 (三) 本公司已依法令於本公司內部控制制度及「關係企業管理辦法」中建立相關控管。 (四) 本公司訂有「內線交易防制辦法」，規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期作內部教育訓練及宣導。	無
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V V V		(一) 請參閱本公司 111 年年報「3.2 董事會—董事會多元化及獨立性」(第 45 頁)。 (二) 審計委員會(民國 91 年設置)；薪資報酬委員會(民國 92 年設置)；ESG 指導委員會(民國 108 年設置)：由經營團隊組成，並由董事長劉德音擔任主席；ESG 委員會(民國 100 年設置)：由執行團隊組成，每季向董事會報告執行成果及未來工作計畫。 (三) 依本公司對公司治理的理念，董事會主要的責任是監督、評量經營團隊之績效及任免經理人、決議重要事項及指導經營團隊。本公司董事會成員皆擁有豐富的世界級公司經營經驗或專業領域經驗，並堅持極高的道德標準及其對公司之承諾。每季定期的董事會開會時間都長達二天，除決議各議案，並與經營團隊討論經營策略及未來方針，以為股東創造最高利益。以本公司長期以來的營運績效及持續獲得國內外各項最佳公司治理獎項的肯定，足以	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			證明本公司董事會的良好績效。 本公司於民國 111 年執行董事會績效評估，針對整體董事會、個別董事成員及審計委員會每年定期進行績效評估，評估作業採用問卷方式自評。 本公司董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 本公司個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 本公司審計委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司已完成民國 111 年度董事會績效自評，評估結果並提送民國 112 年第一季董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為 4.76（滿分 5 分），其中一項「董事會有適當討論 ESG 之參與及執行情形」之平均分數為 4.9，個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.9（滿分 5 分），顯示整體董事會運作良好；審計委員會績效自評結果，各委員均 100%滿意各衡量項目。 (四) 本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性，並向董事會報告評估結果。請參閱本公司 111 年年報「3.9.4 會計師獨立性及適任性之評估」(第 64 頁)。	
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	V		董事會任命本公司法務副總經理暨法務長擔任公司治理主管。直接向法務長報告的公司法務與法規遵循處負責協助相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。	無
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司視不同狀況，責成包括法人關係處、企業公共關係處、股務及上市法規遵循部、人力資源、客戶服務及採購等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊，另設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之包括永續在內之相關議題。詳細內容，請參閱本公司 111 年年報「7. 企業永續（ESG）」（第 146-167 頁）及本公司永續報告書「重大性分析與利害關係人溝通」。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任中國信託股務代理部辦理股東會事務。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(一) 本公司透過公司網站 (http://www.tsmc.com, 中英文版) 隨時揭露相關資訊。本公司美國存託憑證 (ADR) 在美國紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌交易，為外國發行人，須遵守 NYSE 相關規定。其中，本公司須依據 NYSE 上市準則，揭露本公司公司治理執行情形與美國國內公司執行情形之重大差異，有關上述資訊之揭露請參考以下網址： https://www.tsmc.com/download/ir/NYSE_Section_303A.pdf (二) 本公司責成法人關係處、企業公共關係處、股務及上市法規遵循部等相關部門負責依規定蒐集及揭露相關資訊。本公司依規定設有發言人。本公司在網站上提供法人說明會現場音訊直播及重播。 (三) 本公司依相關規定，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。	無
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？	V		(一) 員工權益、僱員關懷之執行情形：請參閱本公司 111 年年報「5.6 人才資本」(第 107-114 頁)。 (二) 投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利之執行情形：請參閱本公司 111 年年報「7. 企業永續 (ESG)」(第 146-167 頁)。 (三) 董事進修之情形：請參閱本公司 111 年年報「民國一百一十一年董事進修情形」(第 54-55 頁)。 (四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本公司 111 年年報「6.3 風險管理」(第 129-142 頁)。 (五) 客戶政策之執行情形：請參閱本公司 111 年年報「5.4 客戶信任」(第 104-106 頁)。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(六) 本公司已為董事及經理人購買責任保險。	
九、就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司歷年來「公司治理評鑑」結果皆為前 5% 公司，民國 111 年加強事項與措施說明如下： (一) 台積公司董事會先後於民國九十一年及九十二年設立審計委員會及薪酬委員會。為持續追求更完善的公司治理，台積公司董事會進一步於民國一百一十二年二月核准新增並強化其下委員會職責，包括變更「審計委員會」名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及設立「提名及公司治理暨永續委員會」。 (二) ESG 季度報告：每季定期向董事會報告。				

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		1. 有關本公司推動永續發展之治理架構，請參閱本公司 111 年年報「7.1 企業永續 (ESG)- 概述」說明（第 146-150 頁）。 2. 有關本公司推動永續發展專職單位、組成、運作及當年度執行情形，以及向董事會報告之頻率，請參閱本公司 111 年年報「7.1 企業永續 (ESG)- 概述」說明（第 146-150 頁）。 3. 有關本公司董事會對永續發展之督導情形，請參閱本公司 111 年年報「7.1 企業永續 (ESG)- 概述」說明（第 146-150 頁）。	無
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		1. 有關本公司風險評估之邊界，請參閱本公司 111 年年報「7.1 企業永續 (ESG)- 概述」（第 146-150 頁）之說明。 2. 有關本公司辨別環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準、過程、結果及風險管理政策或策略，請參閱本公司 111 年年報「7.1 企業永續 (ESG)- 概述」說明（第 146-150 頁）及「7.2 環保、安全與衛生管理」（第 150-163 頁）說明。	無
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		1. 有關本公司環境管理制度及所依據之法規，請參閱本公司 111 年年報「7.2 環保、安全與衛生管理」（第 150-163 頁）及「6.3.3 未遵循出口管控、環保及氣候變遷相關法規及協議，或未即時取得營運所需相關核可之風險」（第 139 頁）說明。	無

			2. 有關本公司所通過國際相關驗證標準及其所涵蓋範圍，請參閱本公司 111 年年報「7.2 環保、安全與衛生管理」說明（第 150-163 頁）。	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		有關本公司提升能源使用效率及使用再生物料之政策，請參閱本公司 111 年年報「7.2.1 環境保護—氣候變遷與能源管理、廢棄物管理與資源回收」說明（第 151-152、155 頁）。	無
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		有關本公司評估氣候變遷對現在及未來的潛在風險與機會、其評估結果及所採取相關之因應措施，請參閱本公司 111 年年報「7.2.1 環境保護—氣候變遷與能源管理」說明（第 151-152 頁）。	無
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		1. 有關本公司溫室氣體、用水量及廢棄物最近兩年之統計數據、密集度及資料涵蓋範圍，請參閱本公司 111 年年報「7.2.1 環境保護—氣候變遷與能源管理、溫室氣體排放減量與能源管理、空氣及水污染防治、廢棄物管理與資源回收」說明（第 151-155 頁）。 2. 有關本公司溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，請參閱本公司 111 年年報「7.2.1 環境保護」說明（第 151-157 頁）。 3. 有關本公司各項資訊之驗證情形及其所涵蓋範圍，請參閱本公司 111 年年報「7.2.1 環境保護—氣候變遷與能源管理、溫室氣體排放減量與能源管理、空氣及水污染防治、廢棄物管理與資源回收」說明（第 151-155 頁）。	無
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		有關本公司保障人權之政策與具體管理方案，以及所依據之相關法規與國際人權公約，請參閱本公司 111 年年報「5.6.1 人權政策與具體作為」說明（第 107-108 頁）。	無

(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V	1. 有關本公司之員工福利措施(包含員工薪酬、職場多元化與平等、休假、各項津貼、禮金與補助等, 請參閱本公司 111 年年報「5.6.6 有競爭力的整體薪酬」(第 110-111 頁)、「5.6.2 多元與共融」(第 108 頁)、「5.6.3 人力結構」(第 109 頁)、「5.6.7 優於法令的福利制度」說明(第 111 頁)。 2. 有關本公司經營績效或成果如何反映於員工薪酬之政策及其實施情形, 請參閱本公司 111 年年報「5.6.6 有競爭力的整體薪酬」說明(第 110-111 頁)。	無
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育?	V	1. 有關本公司對員工安全與健康工作環境之措施、對員工之教育政策與其實施情形, 請參閱本公司 111 年年報「7.2.3 安全與衛生」說明(第 159-162 頁)。 2. 有關本公司所取得相關驗證情形及其所涵蓋範圍, 請參閱本公司 111 年年報「7.2.3 安全與衛生」說明(第 159-162 頁)。 3. 有關本公司當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率, 及相關改善措施, 請參閱本公司 111 年年報「7.2.3 安全與衛生」說明(第 159-162 頁)。 4. 有關本公司火災之件數、死傷人數及占員工總人數比率, 及相關改善措施, 截至公開說明書刊印日止, 台積公司及其子公司共發生二起火災事件於目前營建中的新建廠區工地, 此二起火災並未造成人員受傷或死亡。相關改善措施包括於營建工地(1) 加強動火作業及人員管制措施;(2) 新增移動式水霧滅火設備;(3) 每年定期進行消防緊急應變與通報演練。	無
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V	有關本公司員工培訓計畫所涵蓋面向、範圍及實施情形, 請參閱本公司 111 年年報「5.6.5 人才發展」說明(第 109-110 頁)。	無
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題, 公司是否遵循相關	V	1. 本公司並非最終產品製造者, 故消費者保護項目不適用。	無

法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？			2. 有關本公司客戶權益政策，請參閱本公司111年年報「5.4.1客戶—客戶資訊保護」說明（第105頁）。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		1. 有關本公司供應商管理政策及相關遵循規範，且其內容對供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權應有積極具體之要求，請參閱本公司111年年報「7.2.4 供應商管理（第162-163頁）」及「5.6.1 人權政策與具體作為」說明（第107-108頁）。 2. 有關本公司供應商管理政策及相關遵循規範之實施情形，請參閱本公司111年年報「7.2.4 供應商管理」說明（第162-163頁）。	無
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		1. 有關本公司所參考之國際編製準則或指引，及所編製揭露非財務資訊之報告書，請參閱本公司111年年報「7.1 企業永續 (ESG)- 概述」說明（第146-150頁）。 2. 有關本公司永續報告書之第三方驗證機構，請參閱本公司111年年報「7.1 企業永續 (ESG)- 概述」說明（第146-150頁）。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 台積公司依循董事長劉德音博士所訂定的「ESG 政策」。有關本公司企業永續運作情形，請參閱本公司111年年報「7. 企業永續 (ESG)」說明（第144-167頁）及本公司網站企業永續相關資訊，網址： https://esg.tsmc.com/ch/index.html				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請參考本公司網站 ESG 相關資訊，網址： https://esg.tsmc.com/ch/index.html				

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V V V		(一) 「誠信正直」是台積公司的文化中最重要核心價值。台積公司秉持一貫的道德標準來從事所有業務活動。台積公司制定有「台積電從業道德規範政策」(以下稱「從業道德規範」)嚴格要求每位員工必須履行誠信政策，並於年報及永續報告中詳細說明公司誠信經營之政策以及董事會及管理階層承諾積極落實之情形。 (二) 從業道德規範是台積公司實踐以上價值理念的最核心指引。它要求所有台積公司同仁，包括子公司的成員，都必須肩負起維護高度道德標準、公司聲譽與遵守法令的重要責任。具體之從業道德行為規範要求，請參閱年報相關內容。又為了使同仁時常保持對於誠信行為的認識，台積公司除將從業道德相關規範的相關規章文件公布在公司內部網站供同仁隨時查詢外，另透過例如教育課程、海報、電子郵件等多元方式對同仁進行公司核心價值及遵循法規規定之宣導。此外，為確保台積公司的行為符合法規與從業道德規範的高度要求，針對不誠信行為，台積公司提供了多種舉報系統，請詳見評估項目三。 對於任何可能違反從業道德之行為，台積公司秉持毋枉毋縱的嚴肅態度看待所有經確認屬實之個案，對於違反者採取包含如終止僱傭或業務往來關係等嚴厲的懲戒措施，以及適時採取法律行動。 (三) 在從業道德規範的架構之下，台積公司就不同法規遵循領域分別訂有相關規章或指引，這些領域包括：公司治理、證券法規、反貪腐、反騷擾、反歧視、勞動法規、反托拉斯（公平競爭）、環境保護、安全與衛生、出口管控、財務報告編製、內線交易、智慧財產權保護、機密資訊保護、個人資料保護、文件	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			資料保存及銷毀及非衝突原物料採購（非衝突礦產）等，以上的具體規範對於落實台積公司的從業道德規範至關重要。台積公司提供「年度從業道德與法規遵循」教育訓練（0.5 小時線上必修課程），內容涵括各個不同的重要法規遵循主題，受訓對象包含台積公司的子公司同仁，總計有 67,922 名（完訓率達 99.9%）同仁完成本訓練課程。此外，台積公司、台積公司所有同仁、以及台積公司子公司，均必須詳加瞭解業務相關的法令及規章，並做出正確的商業與道德判斷。台積公司之內部稽核部門就確保從業道德與法規遵循上亦扮演重要的角色。為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與及時，以及員工行為遵循相關之規章、準則、程序與法規等目標，內部稽核依照董事會核准的年度稽核計畫進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層相關之稽核結果與後續改善方案，俾落實稽核成效。	
二、落實誠信經營 （一） 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ （二） 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		（一） 台積公司期待並且採取實際的行動來協助客戶、供應商等商業夥伴或其他有業務往來的各界人士（例如顧問或其他有權代表台積公司從事商業行為之人）能瞭解並認同台積公司的從業道德標準及文化。舉例而言，台積公司要求其所有供應商出具尊重並願意確實遵行台積的從業道德標準及文化的書面承諾。此外，除進行相關稽核外，並透過實體研討會或線上課程提供教育訓練、邀集宣導台積公司之從業道德規範，聽取其對於台積從業道德之意見，以確實瞭解是否有不符合誠信正直的行為發生。台積公司也透過各項客戶稽核活動，向客戶傳達台積公司的從業道德標準，並進行相關議題的交流。 （二） 為了善盡誠信經營之監督責任，台積公司董事會建立了各式組織與管道，例如審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會、提名及公司治理暨永續委員會、隸屬審計暨風險委員會的財務專家顧問、內部稽核等。台積公司主要由法務長及直接向法務	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		長報告的公司法務與法規遵循處協助推動公司誠信經營，法務長並每季定期向董事會報告其執行情形。此外，負責 Ombudsman 系統之資深主管及內部稽核亦會定期向董事會報告相關執行情形。公司經理人，尤其是總裁、財務長及法務長，在董事會的監督之下，必須確保台積公司對證券主管機關所申報或其他對外揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、即時且易懂的。 (三) 台積公司於聘用新進員工時，將視需要請員工簽署「新進員工利益衝突聲明書」。此外，根據台積公司從業道德規範，所有同仁均需主動申報任何實際或潛在利益衝突之情形，特定職級及職務同仁也必須每年度進行利益衝突申報。	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四) 本公司一向注重確保其財務報導流程及其控制的正確性及完整性，並針對潛在具較高不誠信行為風險之作業程序設計相關內部控制制度，內部稽核亦依據風險評估結果擬訂之年度稽核計畫進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案，以落實稽核成效。此外，透過年度企業內控自評，台積公司各部門及子公司，均必須自我檢視內部控制制度設計及執行之有效性。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 遵法教育訓練是台積公司法規遵循計畫中最重要的項目之一。透過定期推出的法規推廣與訓練課程，不僅讓台積公司同仁了解最新或與其息息相關的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾。相關教育訓練課程，請詳見評估項目一。對於台積的供應商，台積公司亦透過實體研討會或線上課程邀集宣導台積公司之從業道德規範，以確保其確實了解台積公司之誠信經營規範。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(一) 台積公司審計暨風險委員會制定有「Complaint Policy and Procedures for Certain Accounting and Legal Matters」及「Procedures for Ombudsman System」等規範，提供員工及外部人士透過 Ombudsman System 或直接向審計暨風險委員會舉報任何財務、法律及誠信相關之不正當從業行為之管道，並允許匿名舉報。若同仁警覺身邊有疑似不符從業道德的情況發生時，有責任隨時向直屬主管、人力資源最高主管或循既有的員工舉報管道向負責 Ombudsman 系統之資深主管進行舉報或直接通報審計暨風險委員會主席。 (二) 對於所接獲的舉報及後續之調查，台積公司均採取保密與嚴謹之態度進行，並已明定在內部規章中。 (三) 台積公司嚴格禁止對於善意舉報或協助調查之人實施任何形式的報復手段，並已明定在內部規章中。	無
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		台積公司於公司內部網站（中英文版）放置誠信經營相關規範及宣導資訊，以供同仁隨時查詢。台積公司亦於對外網站（http://www.tsmc.com，中英文版）放置年報（同時放置於公開資訊觀測站）及永續報告書以揭露「台積電從業道德規範政策」及推動成效。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 台積公司訂有從業道德規範，公司所有同仁、經理人及董事會成員均必須遵守本該規範及相關辦法之規定。台積公司從業道德規範運作情形與規範之內容並無差異，請參閱本公司 111 年年報「3.5 從業道德」說明（第 55-59 頁）。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 有關台積公司從業道德規範運作情形，請參閱本公司 111 年年報「3.5 從業道德」說明（第 55-59 頁）。				

- (八) 公司訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式
有關本公司公司治理運作情形，請參閱本公司民國一百一十一年年報「3.公司治理」說明（第40-64頁）。
- (九) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總
無。
- (十) 其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊
可參考公司網站（<https://investor.tsmc.com/chinese/corporate-governance>）所揭露之相關資訊。

附件一：限制員工權利新股發行辦法

台灣積體電路製造股份有限公司

民國一百一十二年度限制員工權利新股發行辦法

第一條 目的

為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Governance，以下簡稱ESG）成果，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法（以下簡稱本辦法）。

第二條 發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會或由董事會授權董事長訂定之。

第三條 員工資格條件及得獲配股數

- （一）本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為（1）對本公司或本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或（2）本公司或本公司從屬公司未來核心技術與策略發展之特定關鍵人才。
- （二）具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適當參考因素，由董事長與總裁核定提報董事會核准前，如獲配員工為經理人時，應經薪酬暨人才發展委員會同意，獲配員工為非經理人時，應經審計暨風險委員會同意。

第四條 預計發行總額

以本公司前一年度淨利的0.3%為預算上限計算，預計發行股數不超過普通股6,249,000股，每股面額新台幣10元。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東會及主管機關核准後另提董事會決議之。

第五條 限制員工權利新股發行條件及股份權利內容受限情形

- (一) 預計發行價格：無償發行。
- (二) 發行股份之種類：普通股。
- (三) 既得條件：

- 員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：(1) 於各既得期間屆滿日仍在職；(2) 各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3) 達成本公司所設定員工績效評核指標（即既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為「S」^註（含）以上）與公司營運成果指標。（註：「S」代表「優良」）
- 各年度可既得之最高股份比例為：發行後屆滿一年50%、屆滿二年25%，以及屆滿三年25%。各年度可既得之實際股份比例與股數須再依公司營運成果指標達成情形計算，詳細說明如下。
- 本公司符合資格條件之經理人：將各年度可既得之最高股數設定為110%，其中100%依下表本公司股東總報酬率（TSR^註）指標相對達成情形計算可既得股數後，再由薪酬暨人才發展委員會評估本公司ESG成果為調整項，於可既得股數正負10%區間內調整之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。

本公司 TSR 相對標準普爾 500 IT 指數 TSR	既得股數比例
優於指數 X 個百分點	$50\% + X * 2.5\%$ ，最高為100%
與指數持平	50%
落後指數 X 個百分點	$50\% - X * 2.5\%$ ，最低為0%

註：TSR：Total Shareholder Return，包含資本利得及股利。

- 本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工：各年度可既得股數以本公司於各既得日前一年度經會計師查核簽證之合併財務報告為依據，依下表計算之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。

	門檻值	目標值	權重	既得股數比例
營業收入成長率	10%	15%	三分之一	· < 門檻值：0% · = 門檻值：50% · ≥ 目標值：100% · 介於門檻值與目標值：以內插法計算
毛利率	50%	53%	三分之一	
股東權益報酬率	20%	25%	三分之一	

- (四) 員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：

1. 員工未能符合本條第（三）項所定之既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
2. 自願離職、資遣、解雇：
尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未符既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
3. 留職停薪：
尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；惟各年度可既得之實際股份，除依本條第（三）項所定既得條件外，需再依員工於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之。既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
4. 退休：
員工退休後，完全符合以下要求者，尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；若違反以下任一要求，尚未既得之限制員工權利新股視為未達既得條件，個別情況之豁免，由董事長及總裁核定：
 - (1) 未從事全職的工作。
 - (2) 未從事任何與本公司或本公司從屬公司競爭之事項，包含但不限於：加入競爭公司、提供任何與台積公司競爭的服務、建立任何涉及提供半導體製程或服務之公司或事業，或聘僱、誘導、或試圖誘使任何台積公司的員工從事與台積公司競爭的服務。退休員工各年度可既得之實際股份，依本條第（三）項所定之既得條件辦理，個人績效考核等第視為「S」。
5. 一般死亡或因受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職：
尚未既得之限制員工權利新股，本公司符合資格條件之經理人之既得股數以本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR指數持平計算，且不另依ESG成果調整；本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工則以本公司營業收入成長率、毛利率、與股東權益報酬率皆等於門檻值計算。若為死亡，則由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份；若為受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職，則仍由該員工領受其應既得之股份。
6. 調職：
 - (1) 員工請調至從屬公司、關係企業或其他公司時，其尚未既得之限制員工權利新股應比照本項第2款「自願離職」之方式處理。
 - (2) 經本公司或本公司從屬公司指派轉任從屬公司、關係企業或其他公司之員工，尚未既得之限制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受本條第（三）項既得條件之限

制，且既得日仍需繼續在所指派轉任本公司從屬公司、關係企業或其他公司服務，否則視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。而其個人績效評核由本公司之董事長與總裁參考轉任之從屬公司、關係企業或其他公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。

7. 員工向本公司以書面聲明自願放棄被授予之限制員工權利新股者，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
8. 員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
9. 員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託/保管帳戶之代理授權（詳本條第五項第一款和第七項），就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

（五）獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：

1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託/保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
2. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
3. 除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託/保管契約執行之。
4. 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
5. 既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託/保管，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

（六）併購之處理：

尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響，或得由併購相關契約或計畫約定變更之。

（七）其他約定事項：

限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之

交付、運用及處分指示。

第六條 簽約及保密

- (一) 獲配限制員工權利新股之員工，需簽署「限制員工權利新股受領同意書」與辦理相關信託/保管程序。未依規定完成相關文件簽署者，視同放棄限制員工權利新股。
- (二) 任何經本辦法取得限制員工權利新股及相關權益之所有人，皆應遵守本辦法及「限制員工權利新股受領同意書」之規定，違者視為未達既得條件；且應遵守相關保密規定，除法令或主管機關要求外，不得探詢他人或洩漏被授予之限制員工權利新股相關數量及內容，或將本案相關內容及個人權益告知他人。若有違反之情事，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。

第七條 稅賦

依本辦法所獲配之限制員工權利新股其相關之稅賦，按當時中華民國及員工所在國家法令規定辦理。

第八條 其他重要事項

- (一) 本辦法應經薪酬暨人才發展委員會通過及董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管機關申報生效後實行。嗣後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提薪酬暨人才發展委員會及董事會追認後始得發行。
- (二) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

附件二：會計師複核之案件檢查表彙總意見

台灣積體電路製造股份有限公司申報案件檢查表

會計師複核彙總意見

台灣積體電路製造股份有限公司本次為發行限制員工權利新股普通股6,249,000股，每股面額10元，總金額新臺幣62,490,000元，向金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以複核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」（以下簡稱處理準則）規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，台灣積體電路製造股份有限公司本次向金融監督管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響發行限制員工權利新股之情事。

此 致

台灣積體電路製造股份有限公司

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 世 宗



中 華 民 國 1 1 2 年 1 2 月 1 8 日

附件三：民國一百一十年度合併財務報表 及會計師查核報告

會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司（以下簡稱台積公司及其子公司）民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台積公司及其子公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台積公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台積公司及其子公司民國 110 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台積公司及其子公司民國 110 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備－不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程之折舊開始提列時點

請參閱合併財務報表附註四、五及十四。

台積公司及其子公司於評估不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程之折舊開始提列時點，是始於該資產達可供使用且符合預期運作方式之必要狀態時。因該資產預期使用狀態之評估條件涉及主觀判斷及假設，而假設之變動所影響之折舊開始提列時點將對台積公司及其子公司之財務績效產生重大影響。

由於台積公司及其子公司折舊開始提列時點涉及主觀因素，本會計師於執行查核程序以評估台積公司及其子公司之判斷及假設是否合理需要運用高度審計判斷，因此本會計師將本年度不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程提列折舊之時點列為關鍵查核事項。

對於上述所述層面事項本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 檢視並了解折舊開始提列時點之政策及條件。
2. 測試待驗設備及未完工程提列折舊時點之主要內部控制有效性。
3. 自年底待驗設備及未完工程餘額明細中抽核並評估及觀察其是否尚未達到可供使用狀態。
4. 自本年度達可供使用狀態標準之待驗設備及未完工程中抽核，評估其折舊開始提列之時點是否適當。
5. 自期後已轉列至達可供使用狀態之待驗設備及未完工程中抽核，評估其折舊開始提列時點是否適當。

其他事項

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國 110 及 109 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告

編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台積公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台積公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台積公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台積公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台積公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併

財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台積公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台積公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台積公司及其子公司民國110年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 美 艷

江美艷



會計師 林 尚 志

林尚志



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 1 1 1 年 2 月 1 5 日

代碼	資 產	110 年 12 月 31 日			109 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	1,064,990,192	29	\$	660,170,647	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）		159,048	-		2,259,412	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）		119,519,251	3		122,448,453	5
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）		3,773,571	-		6,597,992	-
1139	避險之金融資產（附註十）		13,468	-		47	-
1170	應收票據及帳款淨額（附註十一）		197,586,109	5		145,480,272	5
1180	應收關係人款項（附註三三）		715,324	-		558,131	-
1210	其他應收關係人款項（附註三三）		61,531	-		50,645	-
1310	存貨（附註五及十二）		193,102,321	5		137,353,407	5
1476	其他金融資產（附註三四）		16,630,611	1		10,676,111	1
1479	其他流動資產		10,521,481	-		6,590,191	-
11XX	流動資產合計		1,607,072,907	43		1,092,185,308	40
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）		5,887,892	-		4,514,940	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）		1,533,391	-		4,372,207	-
1550	採用權益法之投資（附註十三）		21,963,418	1		18,841,061	1
1600	不動產、廠房及設備（附註五及十四）		1,975,118,704	53		1,555,589,120	56
1755	使用權資產（附註五及十五）		32,734,537	1		27,728,382	1
1780	無形資產（附註五及十六）		26,821,697	1		25,768,179	1
1840	遞延所得稅資產（附註五及二六）		49,153,886	1		25,958,184	1
1920	存出保證金		2,624,854	-		1,343,001	-
1990	其他非流動資產		2,592,169	-		4,411,023	-
15XX	非流動資產合計		2,118,430,548	57		1,668,526,097	60
1XXX	資 產 總 計	\$	3,725,503,455	100	\$	2,760,711,405	100
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十七及三十）	\$	114,921,333	3	\$	88,559,026	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）		681,914	-		94,128	-
2126	避險之金融負債（附註十）		9,642	-		1,169	-
2170	應付帳款		47,285,603	1		38,987,284	1
2180	應付關係人款項（附註三三）		1,437,186	-		2,107,718	-
2201	應付薪資及獎金		23,802,100	1		20,071,241	1
2206	應付員工酬勞及董監酬勞（附註二九）		36,524,741	1		35,681,046	1
2213	應付工程及設備款		145,742,148	4		157,804,961	6
2216	應付現金股利（附註二一）		142,617,093	4		129,651,902	5
2230	本期所得稅負債（附註五及二六）		59,647,152	2		53,909,313	2
2320	一年內到期長期負債（附註十八、十九及三十）		4,566,667	-		2,600,000	-
2399	應付費用及其他流動負債（附註五、十五、二二、三十及三三）		162,267,779	4		87,683,260	3
21XX	流動負債合計		739,503,358	20		617,151,048	22
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十八及三十）		610,070,652	16		254,105,084	9
2541	長期銀行借款（附註十九及三十）		3,309,131	-		1,967,611	-
2573	遞延所得稅負債（附註五及二六）		1,873,877	-		1,729,941	-
2580	租賃負債（附註五、十五及三十）		20,764,214	1		20,560,649	1
2640	淨確定福利負債（附註二十）		11,036,879	-		11,914,074	1
2645	存入保證金		686,762	-		265,599	-
2670	其他非流動負債（附註二二）		167,525,377	5		2,395,400	-
25XX	非流動負債合計		815,266,892	22		292,938,358	11
2XXX	負債合計		1,554,770,250	42		910,089,406	33
	歸屬於母公司業主之權益						
3110	股本（附註二一）						
	普通股股本		259,303,805	7		259,303,805	9
3200	資本公積（附註二一）		64,761,602	2		56,347,243	2
	保留盈餘（附註二一）						
3310	法定盈餘公積		311,146,899	8		311,146,899	11
3320	特別盈餘公積		59,304,212	2		42,259,146	2
3350	未分配盈餘		1,536,378,550	41		1,235,280,036	45
3300	保留盈餘合計		1,906,829,661	51		1,588,686,081	58
3400	其他權益（附註二一）	(	62,608,515)	(2)	(	54,679,873)	(2)
31XX	母公司業主權益合計		2,168,286,553	58		1,849,657,256	67
36XX	非控制權益		2,446,652	-		964,743	-
3XXX	權益合計		2,170,733,205	58		1,850,621,999	67
	負 債 及 權 益 總 計	\$	3,725,503,455	100	\$	2,760,711,405	100

董事長：

經理人：

會計主管：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		110年度		109年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入淨額（附註五、二 二、三三及三八）	\$1,587,415,037	100	\$1,339,254,811	100
5000	營業成本（附註五、十二、二 九及三三）	<u>767,877,771</u>	<u>48</u>	<u>628,124,691</u>	<u>47</u>
5950	營業毛利	<u>819,537,266</u>	<u>52</u>	<u>711,130,120</u>	<u>53</u>
	營業費用（附註五、二九及三 三）				
6300	研究發展費用	124,734,755	8	109,486,089	8
6200	管理費用	36,929,588	2	28,457,593	2
6100	行銷費用	<u>7,558,591</u>	<u>1</u>	<u>7,112,867</u>	<u>1</u>
6000	合 計	<u>169,222,934</u>	<u>11</u>	<u>145,056,549</u>	<u>11</u>
6500	其他營業收益及費損淨額（附 註十四、十五及二九）	(<u>333,435</u>)	-	<u>710,127</u>	-
6900	營業淨利（附註三八）	<u>649,980,897</u>	<u>41</u>	<u>566,783,698</u>	<u>42</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之關聯企 業損益份額	5,603,084	-	3,592,818	-
7100	利息收入（附註二三）	5,708,765	-	9,018,400	1
7190	其他收入	973,141	-	660,607	-
7230	外幣兌換淨益（損）（附 註三六）	13,662,655	1	(3,303,298)	-
7050	財務成本（附註二四）	(5,414,218)	-	(2,081,455)	-
7020	其他利益及損失淨額（附 註二五）	(<u>7,388,010</u>)	-	<u>10,106,410</u>	<u>1</u>
7000	合 計	<u>13,145,417</u>	<u>1</u>	<u>17,993,482</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	663,126,314	42	584,777,180	44
7950	所得稅費用（附註五及二六）	<u>66,053,180</u>	<u>4</u>	<u>66,619,098</u>	<u>5</u>
8200	本年度淨利	<u>597,073,134</u>	<u>38</u>	<u>518,158,082</u>	<u>39</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益（附註五、二十、二一及二六）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 242,079	-	(\$ 3,516,749)	(1)
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	1,900,797	-	423,697	-
8317	避險工具之損益	(41,416)	-	24,085	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額	(30,194)	-	(11,604)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益（費用）	(<u>85,269</u>)	<u>-</u>	<u>422,663</u>	<u>-</u>
		<u>1,985,997</u>	<u>-</u>	<u>(2,657,908)</u>	<u>(1)</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(6,181,830)	(1)	(29,847,196)	(2)
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	(3,431,791)	-	2,466,711	-
8368	避險工具之損益	131,535	-	-	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額	(119,997)	-	(283,409)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅費用	(<u>3,370</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>(9,605,453)</u>	<u>(1)</u>	<u>(27,663,894)</u>	<u>(2)</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(7,619,456)</u>	<u>(1)</u>	<u>(30,321,802)</u>	<u>(3)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 589,453,678</u>	<u>37</u>	<u>\$ 487,836,280</u>	<u>36</u>
	淨利歸屬予				
8610	母公司業主	\$ 596,540,013	38	\$ 517,885,387	39
8620	非控制權益	<u>533,121</u>	<u>-</u>	<u>272,695</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 597,073,134</u>	<u>38</u>	<u>\$ 518,158,082</u>	<u>39</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金	額 %	金	額 %
	綜合損益總額歸屬予				
8710	母公司業主	\$	588,918,059 37	\$	487,563,478 36
8720	非控制權益		535,619 -		272,802 -
		<u>\$</u>	<u>589,453,678 37</u>	<u>\$</u>	<u>487,836,280 36</u>
	每股盈餘（附註二七）				
9750	基本每股盈餘	\$	23.01	\$	19.97
9850	稀釋每股盈餘	\$	23.01	\$	19.97

董事長：



經理人：



會計主管：





台灣精機股份有限公司
民國 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

歸屬	於	母	公	司	主 權				母 公 司 主 權 合 計	非 控 制 權 益 合 計
					其 他	之	項	目		
普 通 股 發 行 額 股數 (仟股) \$ 259,303,805 \$ 25,930,380	資 本 公 積 \$ 56,339,709	法 定 盈 餘 公 積 \$ 311,146,899	留 存 盈 餘 公 積 \$ 10,675,106	盈 餘 公 積 \$ 1,011,512,974	盈 餘 公 積 \$ 1,333,334,979	國外管理機構財務報表計算之兌換差額 (\$ 26,871,400)	遞延其他綜合收益 按公允價值衡量之金融資產 未實現評價損益 (\$ 692,959)	遞延其他綜合收益 按公允價值衡量之金融資產 未實現評價損益 (\$ 692,959)	其他權益合計 (\$ 27,568,369)	母 公 司 主 權 合 計 \$ 1,621,410,124
109 年 1 月 1 日餘額										\$ 1,622,095,426
盈餘分配										
特別盈餘公積	-	-	-	31,584,040	(31,584,040)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(259,303,805)	-	-	-	-	(259,303,805)
盈餘分配合計	-	-	-	31,584,040	(290,887,845)	-	-	-	-	-
109 年度淨利	-	-	-	-	517,885,387	-	-	-	517,885,387	518,158,082
109 年度其他綜合收益	-	-	-	-	(3,121,793)	(30,130,227)	2,906,026	(27,200,116)	(30,321,909)	(30,321,902)
109 年度綜合收益總額	-	-	-	-	514,763,594	(30,130,227)	2,906,026	(27,200,116)	487,563,478	487,836,280
處分透過其他綜合收益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(108,687)	-	108,687	-	-	-
投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遞延工具損益基礎調整	-	-	-	-	-	(20,205)	-	(20,205)	(20,205)	(20,205)
採用權益法認列之關聯企業帳面淨值之變動數	-	292	-	-	-	190	-	190	482	482
因受領贈與產生者	-	7,242	-	-	-	-	-	-	7,242	7,249
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,612
109 年 12 月 31 日餘額	25,930,380	56,347,243	311,146,899	42,259,146	1,388,686,081	(57,001,627)	2,321,754	(54,679,873)	1,849,657,256	1,850,621,999
盈餘分配										
特別盈餘公積	-	-	-	17,045,066	(17,045,066)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(278,751,590)	-	-	-	(278,751,590)	(278,751,590)
盈餘分配合計	-	-	-	17,045,066	(295,796,656)	-	-	-	-	-
110 年度淨利	-	-	-	-	596,540,013	-	-	-	596,540,013	597,073,134
110 年度其他綜合收益	-	-	-	-	167,503	(6,301,734)	(1,559,790)	(7,789,457)	(7,621,954)	(7,619,456)
110 年度綜合收益總額	-	-	-	-	596,707,516	(6,301,734)	(1,559,790)	(7,789,457)	588,918,059	589,453,678
處分透過其他綜合收益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	187,654	-	(187,654)	-	-	-
投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遞延工具損益基礎調整	-	-	-	-	-	48,469	-	48,469	48,469	48,469
採用權益法認列之關聯企業帳面淨值之變動數	-	4,796	-	-	-	-	-	-	4,796	4,796
實際處分子公司取權價格與帳面價值差額	-	8,406,282	-	-	-	-	-	-	8,406,282	9,431,798
認列對子公司所有權權益變動數	-	(7,891)	-	-	-	-	-	-	(7,891)	-
因受領贈與產生者	-	11,172	-	-	-	-	-	-	11,172	11,282
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	(107,882)	(107,882)
取得子公司影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
110 年 12 月 31 日餘額	25,930,380	64,761,602	311,146,899	59,304,412	\$ 1,906,829,661	(63,303,361)	\$ 574,310	(62,608,513)	\$ 2,168,286,553	\$ 2,170,733,305



董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 663,126,314	\$ 584,777,180
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	414,187,700	324,538,443
攤銷費用	8,207,169	7,186,248
預期信用減損損失（迴轉利益）－債		
務工具投資	(2,735)	3,672
財務成本	5,414,218	2,081,455
採用權益法認列之關聯企業損益份額	(5,603,084)	(3,592,818)
利息收入	(5,708,765)	(9,018,400)
股份基礎給付酬勞成本	7,788	6,612
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損		
（益）	273,627	(188,863)
處分及報廢無形資產淨損	1,228	599
不動產、廠房及設備減損損失	274,388	10,159
透過損益按公允價值衡量之金融工具		
淨利益	-	(3,005)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡		
量之債務工具投資淨利益	(93,229)	(1,439,420)
外幣兌換淨益	(16,115,936)	(1,372,610)
股利收入	(362,310)	(637,575)
其他項目	(414,219)	13,554
與營業活動相關之資產／負債淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融工具	2,649,244	(2,965,270)
應收票據及帳款淨額	(52,105,823)	(8,082,708)
應收關係人款項	(157,193)	303,939
其他應收關係人款項	(10,886)	7,588
存 貨	(55,748,914)	(54,372,211)
其他金融資產	(8,236,897)	1,389,493
其他流動資產	(3,899,043)	(1,358,129)
應付帳款	8,298,319	404,607
應付關係人款項	(670,532)	672,818
應付薪資及獎金	3,730,859	3,798,888
應付員工酬勞及董監酬勞	843,695	12,032,143
應付費用及其他流動負債	84,322,721	20,617,359

（接次頁）

(承前頁)

	110年度	109年度
其他非流動負債	\$ 154,085,985	\$ -
淨確定福利負債	(635,116)	(785,171)
營運產生之現金	1,195,658,573	874,028,577
支付所得稅	(83,497,851)	(51,362,365)
營業活動之淨現金流入	<u>1,112,160,722</u>	<u>822,666,212</u>
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(255,888,679)	(262,637,496)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,799,737)	(4,302,770)
處分透過損益按公允價值衡量之債務工具價款	-	30,049
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	254,604,537	266,931,916
按攤銷後成本衡量之金融資產領回	9,368,275	285,210
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資成本收回	115,627	51,052
除列避險之金融工具	276,261	(308,776)
收取之利息	5,990,948	9,775,120
收取政府補助款—不動產、廠房及設備	821,312	1,044,327
收取政府補助款—其他	6,605	25,369
收取其他股利	362,310	735,081
收取採用權益法投資之股利	2,136,426	2,752,043
取得不動產、廠房及設備	(839,195,708)	(507,238,722)
取得無形資產	(9,040,751)	(9,542,387)
處分不動產、廠房及設備價款	390,364	606,732
預付租賃款增加	(1,200,000)	(4,693,416)
存出保證金增加	(1,997,337)	(726,883)
存出保證金減少	683,684	1,431,837
投資活動之淨現金流出	<u>(836,365,863)</u>	<u>(505,781,714)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	35,668,397	(31,571,567)
應付短期票券增加	-	7,485,303
應付短期票券減少	-	(7,500,000)
發行公司債	364,592,792	236,725,675
償還公司債	(2,600,000)	(31,800,000)
舉借長期借款	1,510,000	2,000,000
支付公司債發行成本	(737,724)	(390,730)
租賃本金償還	(1,985,338)	(2,615,708)
支付利息	(3,833,633)	(1,781,097)

(接次頁)

(承前頁)

	110年度	109年度
收取存入保證金	\$ 469,041	\$ 145,633
存入保證金返還	(36,763)	(16,060)
支付現金股利	(265,786,399)	(259,303,805)
處分子公司股權(未喪失控制力)	9,451,798	-
因受領贈與產生者	11,282	7,269
非控制權益減少	(115,015)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>136,608,438</u>	<u>(88,615,087)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(7,583,752)</u>	<u>(23,498,100)</u>
現金及約當現金淨增加數	404,819,545	204,771,311
年初現金及約當現金餘額	<u>660,170,647</u>	<u>455,399,336</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,064,990,192</u>	<u>\$ 660,170,647</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四：民國一百一十一年度合併財務報
表及會計師查核報告

會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司（以下簡稱台積公司及其子公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台積公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台積公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台積公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台積公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備－不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程之折舊開始提列時點

請參閱合併財務報表附註四、五及十四。

台積公司及其子公司於評估不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程之折舊開始提列時點，是始於該資產達可供使用且符合預期運作方式之必要狀態時。因該資產預期使用狀態之評估條件涉及主觀判斷及假設，而假設之變動所影響之折舊開始提列時點將對台積公司及其子公司之財務績效產生重大影響。

由於台積公司及其子公司折舊開始提列時點涉及主觀因素，本會計師於執行查核程序以評估台積公司及其子公司之判斷及假設是否合理需要運用高度審計判斷，因此本會計師將本年度不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程提列折舊之時點列為關鍵查核事項。

對於上述所述層面事項本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 檢視並了解折舊開始提列時點之政策及條件。
2. 測試待驗設備及未完工程提列折舊時點之主要內部控制有效性。
3. 自年底待驗設備及未完工程餘額明細中抽核並評估及觀察其是否尚未達到可供使用狀態。
4. 自本年度達可供使用狀態標準之待驗設備及未完工程中抽核，評估其折舊開始提列之時點是否適當。
5. 自期後已轉列至達可供使用狀態之待驗設備及未完工程中抽核，評估其折舊開始提列時點是否適當。

其他事項

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告

編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台積公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台積公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台積公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台積公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台積公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併

財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台積公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台積公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台積公司及其子公司民國111年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 美 艷

江美艷



會計師 林 尚 志

林尚志



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 112 年 2 月 14 日

代碼	資 產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 1,342,814,083	27	\$ 1,064,990,192	29
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	1,070,398	-	159,048	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）	122,998,543	2	119,519,251	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）	94,600,219	2	3,773,571	-
1139	避險之金融資產（附註十）	2,329	-	13,468	-
1170	應收票據及帳款淨額（附註十一）	229,755,887	5	197,586,109	5
1180	應收關係人款項（附註三四）	1,583,958	-	715,324	-
1210	其他應收關係人款項（附註三四）	68,975	-	61,531	-
1310	存貨（附註五及十二）	221,149,148	4	193,102,321	5
1476	其他金融資產（附註三五）	25,964,428	1	16,630,611	1
1479	其他流動資產	12,888,776	-	10,521,481	-
11XX	流動資產合計	2,052,896,744	41	1,607,072,907	43
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）	6,159,200	-	5,887,892	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）	35,127,215	1	1,533,391	-
1550	採用權益法之投資（附註十三）	27,641,505	1	21,963,418	1
1600	不動產、廠房及設備（附註五及十四）	2,693,836,970	54	1,975,118,704	53
1755	使用權資產（附註五及十五）	41,914,136	1	32,734,537	1
1780	無形資產（附註五及十六）	25,999,155	1	26,821,697	1
1840	遞延所得稅資產（附註五及二六）	69,185,842	1	49,153,886	1
1920	存出保證金	4,467,022	-	2,624,854	-
1990	其他非流動資產	7,551,089	-	2,592,169	-
15XX	非流動資產合計	2,911,882,134	59	2,118,430,548	57
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,964,778,878	100	\$ 3,725,503,455	100
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十七及三一）	\$ -	-	\$ 114,921,333	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）	116,215	-	681,914	-
2126	避險之金融負債（附註十）	813	-	9,642	-
2170	應付帳款	54,879,708	1	47,285,603	1
2180	應付關係人款項（附註三四）	1,642,637	-	1,437,186	-
2201	應付薪資及獎金	36,435,509	1	23,802,100	1
2206	應付員工酬勞及董事酬勞（附註二九）	61,748,574	1	36,524,741	1
2213	應付工程及設備款	213,499,613	4	145,742,148	4
2216	應付現金股利（附註二一）	142,617,093	3	142,617,093	4
2230	本期所得稅負債（附註五及二六）	120,801,814	3	59,647,152	2
2320	一年內到期長期負債（附註十八、十九及三一）	19,313,889	-	4,566,667	-
2399	應付費用及其他流動負債（附註五、十五、二二、三一及三四）	293,170,952	6	162,267,779	4
21XX	流動負債合計	944,226,817	19	739,503,358	20
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註十八及三一）	834,336,439	17	610,070,652	16
2541	長期銀行借款（附註十九及三一）	4,760,047	-	3,309,131	-
2573	遞延所得稅負債（附註五及二六）	1,031,383	-	1,873,877	-
2580	租賃負債（附註五、十五及三一）	29,764,097	-	20,764,214	1
2640	淨確定福利負債（附註二十）	9,321,091	-	11,036,879	-
2645	存入保證金	892,021	-	686,762	-
2670	其他非流動負債（附註二二）	179,958,116	4	167,525,377	5
25XX	非流動負債合計	1,060,063,194	21	815,266,892	22
2XXX	負債合計	2,004,290,011	40	1,554,770,250	42
	歸屬於母公司業主之權益				
3110	股本（附註四及二一）				
	普通股股本	259,303,805	5	259,303,805	7
3200	資本公積（附註四、二一及二八）	69,330,328	1	64,761,602	2
	保留盈餘（附註四及二一）				
3310	法定盈餘公積	311,146,899	6	311,146,899	8
3320	特別盈餘公積	3,154,310	-	59,304,212	2
3350	未分配盈餘	2,323,223,479	47	1,536,378,550	41
3300	保留盈餘合計	2,637,524,688	53	1,906,829,661	51
3400	其他權益（附註四、二一及二八）	(20,505,626)	-	(62,608,515)	(2)
31XX	母公司業主權益合計	2,945,653,195	59	2,168,286,553	58
36XX	非控制權益	14,835,672	1	2,446,652	-
3XXX	權益合計	2,960,488,867	60	2,170,733,205	58
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 4,964,778,878	100	\$ 3,725,503,455	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入淨額（附註五、二 二、三四及三九）	\$ 2,263,891,292	100	\$ 1,587,415,037	100
5000	營業成本（附註五、十二、二 九及三四）	<u>915,536,486</u>	<u>40</u>	<u>767,877,771</u>	<u>48</u>
5950	營業毛利	<u>1,348,354,806</u>	<u>60</u>	<u>819,537,266</u>	<u>52</u>
	營業費用（附註五、二九及三 四）				
6300	研究發展費用	163,262,208	7	124,734,755	8
6200	管理費用	53,524,898	2	36,929,588	2
6100	行銷費用	<u>9,920,446</u>	<u>1</u>	<u>7,558,591</u>	<u>1</u>
6000	合 計	<u>226,707,552</u>	<u>10</u>	<u>169,222,934</u>	<u>11</u>
6500	其他營業收益及費損淨額（附 註十四及二九）	(<u>368,403</u>)	-	(<u>333,435</u>)	-
6900	營業淨利（附註三九）	<u>1,121,278,851</u>	<u>50</u>	<u>649,980,897</u>	<u>41</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之關聯企 業損益份額	7,798,359	-	5,603,084	-
7100	利息收入（附註二三）	22,422,209	1	5,708,765	-
7190	其他收入	947,697	-	973,141	-
7230	外幣兌換淨益（附註三 七）	4,505,784	-	13,662,655	1
7050	財務成本（附註二四）	(<u>11,749,984</u>)	-	(<u>5,414,218</u>)	-
7020	其他利益及損失淨額（附 註二五）	(<u>1,012,198</u>)	-	(<u>7,388,010</u>)	-
7000	合 計	<u>22,911,867</u>	<u>1</u>	<u>13,145,417</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,144,190,718	51	663,126,314	42
7950	所得稅費用（附註五及二六）	<u>127,290,203</u>	<u>6</u>	<u>66,053,180</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>1,016,900,515</u>	<u>45</u>	<u>597,073,134</u>	<u>38</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益（附註五、二十、二一及二六）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$	823,060)	-	\$ 242,079 -
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(	263,749)	-	1,900,797 -
8317	避險工具之損益	-	-	(	41,416) -
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額		154,457	-	(30,194) -
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益（費用）		<u>733,956</u>	<u>-</u>	(<u>85,269</u>) <u>-</u>
			<u>(198,396)</u>	<u>-</u>	<u>1,985,997</u> <u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		50,845,614	2	(6,181,830) (1)
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	(	10,102,658)	-	(3,431,791) -
8368	避險工具之損益		1,329,231	-	131,535 -
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額		550,338	-	(119,997) -
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅利益（費用）		<u>6,036</u>	<u>-</u>	(<u>3,370</u>) <u>-</u>
			<u>42,628,561</u>	<u>2</u>	(<u>9,605,453</u>) (<u>1</u>)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）		<u>42,430,165</u>	<u>2</u>	(<u>7,619,456</u>) (<u>1</u>)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$</u>	<u>1,059,330,680</u>	<u>47</u>	<u>\$ 589,453,678 37</u>
	淨利歸屬予				
8610	母公司業主	\$	1,016,530,249	45	\$ 596,540,013 38
8620	非控制權益		<u>370,266</u>	<u>-</u>	<u>533,121</u> <u>-</u>
		<u>\$</u>	<u>1,016,900,515</u>	<u>45</u>	<u>\$ 597,073,134 38</u>

(接次頁)

(承前頁)

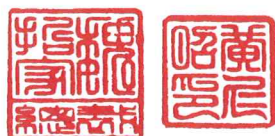
代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	綜合損益總額歸屬予				
8710	母公司業主	\$ 1,059,124,890	47	\$ 588,918,059	37
8720	非控制權益	205,790	-	535,619	-
		<u>\$ 1,059,330,680</u>	<u>47</u>	<u>\$ 589,453,678</u>	<u>37</u>
	每股盈餘（附註二七）				
9750	基本每股盈餘	\$ 39.20		\$ 23.01	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 39.20		\$ 23.01	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





台灣積體電路股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

歸	屬	於	母	公	司	其	他	業	權	主	之	項	目	權	益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金	普	通	股	發	行	股	本	公	積	金	資	本	公	積	金</



會計主管：

後附之附註係本合併財務報告之一部分



經理人：

董事長：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 1,144,190,718	\$ 663,126,314
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	428,498,179	414,187,700
攤銷費用	8,756,094	8,207,169
預期信用減損損失（迴轉利益）－債務		
工具投資	52,351	(2,735)
財務成本	11,749,984	5,414,218
採用權益法認列之關聯企業損益份額	(7,798,359)	(5,603,084)
利息收入	(22,422,209)	(5,708,765)
股份基礎給付酬勞成本	302,348	7,788
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損		
（益）	(98,856)	273,627
處分及報廢無形資產淨損	6,004	1,228
不動產、廠房及設備減損損失	790,740	274,388
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量		
之債務工具投資淨損失（利益）	410,076	(93,229)
外幣兌換淨損（益）	10,342,706	(16,115,936)
股利收入	(266,767)	(362,310)
其 他	138,827	(414,219)
與營業活動相關之資產／負債淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融工具	(1,354,359)	2,649,244
應收票據及帳款淨額	(32,169,853)	(52,105,823)
應收關係人款項	(868,634)	(157,193)
其他應收關係人款項	(7,444)	(10,886)
存 貨	(28,046,827)	(55,748,914)
其他金融資產	(1,680,611)	(8,236,897)
其他流動資產	(4,450,883)	(3,899,043)
應付帳款	7,594,105	8,298,319
應付關係人款項	205,451	(670,532)
應付薪資及獎金	12,633,409	3,730,859
應付員工酬勞及董事酬勞	25,223,833	843,695
應付費用及其他流動負債	46,578,784	84,322,721
其他非流動負債	101,390,476	154,085,985
淨確定福利負債	(2,538,848)	(635,116)
營運產生之現金	1,697,160,435	1,195,658,573
支付所得稅	(86,561,247)	(83,497,851)
營業活動之淨現金流入	<u>1,610,599,188</u>	<u>1,112,160,722</u>

（接次頁）

(承前頁)

	111年度	110年度
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 125,540)	\$ -
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(54,566,725)	(255,888,679)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(183,125,920)	(3,799,737)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	44,963,367	254,604,537
按攤銷後成本衡量之金融資產領回	62,329,674	9,368,275
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資成本收回	2,938	115,627
除列避險之金融工具	1,684,430	276,261
收取之利息	18,083,755	5,990,948
收取政府補助款—不動產、廠房及設備	7,046,136	821,312
收取政府補助款—其他	5,296	6,605
收取其他股利	266,767	362,310
收取採用權益法投資之股利	2,749,667	2,136,426
取得不動產、廠房及設備	(1,082,672,130)	(839,195,708)
取得無形資產	(6,954,326)	(9,040,751)
處分不動產、廠房及設備價款	983,358	390,364
處分無形資產價款	12,636	-
預付租賃款增加	-	(1,200,000)
存出保證金增加	(2,117,041)	(1,997,337)
存出保證金減少	505,423	683,684
投資活動之淨現金流出	(1,190,928,235)	(836,365,863)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(111,959,992)	35,668,397
發行公司債	198,293,561	364,592,792
償還公司債	(4,400,000)	(2,600,000)
舉借長期借款	2,670,000	1,510,000
償還長期銀行借款	(166,667)	-
支付公司債發行成本	(414,307)	(737,724)
買回庫藏股票	(871,566)	-
租賃本金償還	(2,428,277)	(1,985,338)
支付利息	(12,218,659)	(3,833,633)
收取存入保證金	271,387	469,041
存入保證金返還	(62,100)	(36,763)
支付現金股利	(285,234,185)	(265,786,399)
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	9,451,798
因受領贈與產生者	13,225	11,282
非控制權益增加(減少)	16,263,548	(115,015)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(200,244,032)	136,608,438

(接次頁)

(承前頁)

	111年度	110年度
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>\$ 58,396,970</u>	<u>(\$ 7,583,752)</u>
現金及約當現金淨增加數	277,823,891	404,819,545
年初現金及約當現金餘額	<u>1,064,990,192</u>	<u>660,170,647</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,342,814,083</u>	<u>\$ 1,064,990,192</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五：民國一百一十二年第三季合併財務報表及會計師核閱報告

會計師核閱報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

前 言

台灣積體電路製造股份有限公司及其子公司（以下簡稱台積公司及其子公司）民國 112 年及 111 年 9 月 30 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日與民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併綜合損益表、民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併權益變動表與合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製允當表達之財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報表作成結論。

範 圍

本會計師係依照核閱準則 2410 號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報表時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之人員查詢）、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

結 論

依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製，致無法允當表達台積公司及其子公司民國 112 年及 111 年 9 月 30 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務績效及民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務績效及合併現金流量之情事。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 世 宗

吳世宗



會計師 林 尚 志

林尚志



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 112 年 11 月 14 日

民國 112 年 9 月 30 日、111 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	112 年 9 月 30 日			111 年 12 月 31 日			111 年 9 月 30 日			
		產	金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產										
1100	現金及約當現金（附註六）		\$1,311,806,535	24		\$1,342,814,083	27		\$1,296,012,784	28	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）		378,526	-		1,070,398	-		4,705,434	-	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）		154,838,390	3		122,998,543	2		126,209,422	3	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）		84,261,089	2		94,600,219	2		71,857,468	1	
1139	避險之金融資產（附註十）		37,451	-		2,329	-		88,431	-	
1170	應收票據及帳款淨額（附註十一）		222,467,653	4		229,755,887	5		260,447,134	6	
1180	應收關係人款項（附註三一）		356,257	-		1,583,958	-		1,091,174	-	
1210	其他應收關係人款項（附註三一）		82,363	-		68,975	-		76,143	-	
1310	存貨（附註十二）		262,090,072	5		221,149,148	4		218,335,874	5	
1476	其他金融資產（附註三二）		26,938,240	-		25,964,428	1		24,855,999	-	
1479	其他流動資產		19,221,060	-		12,888,776	-		10,552,495	-	
11XX	流動資產合計		2,082,477,636	38		2,052,896,744	41		2,014,232,358	43	
	非流動資產										
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）		111,637	-		-	-		-	-	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）		7,933,799	-		6,159,200	-		6,784,978	-	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）		79,379,651	2		35,127,215	1		42,347,584	1	
1550	採用權益法之投資（附註十三）		28,921,558	1		27,641,505	1		26,663,336	1	
1600	不動產、廠房及設備（附註十四）		3,132,664,367	57		2,693,836,970	54		2,411,490,251	52	
1755	使用權資產（附註十五）		41,254,711	1		41,914,136	1		42,349,743	1	
1780	無形資產（附註十六）		23,410,569	-		25,999,155	1		26,706,552	1	
1840	遞延所得稅資產（附註四）		71,030,144	1		69,185,842	1		63,058,097	1	
1920	存出保證金		8,388,839	-		4,467,022	-		4,451,490	-	
1990	其他非流動資產		8,983,470	-		7,551,089	-		5,217,377	-	
15XX	非流動資產合計		3,402,078,745	62		2,911,882,134	59		2,629,069,408	57	
1XXX	資 產 總 計		\$5,484,556,381	100		\$4,964,778,878	100		\$4,643,301,766	100	
	負 債 及 權 益										
	流動負債										
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）	\$	132,768	-		\$ 116,215	-		\$ 611,010	-	
2126	避險之金融負債（附註十）		26,879,550	-		813	-		-	-	
2170	應付帳款		52,150,883	1		54,879,708	1		60,147,405	1	
2180	應付關係人款項（附註三一）		1,621,423	-		1,642,637	-		1,870,819	-	
2201	應付薪資及獎金		28,657,288	1		36,435,509	1		31,380,029	1	
2206	應付員工酬勞及董事酬勞（附註二七）		37,708,203	1		61,748,574	1		45,041,965	1	
2213	應付工程及設備款		230,848,866	4		213,499,613	4		159,780,369	3	
2216	應付現金股利（附註十九）		155,592,426	3		142,617,093	3		142,617,093	3	
2230	本期所得稅負債（附註四）		102,953,391	2		120,801,814	3		76,005,324	2	
2320	一年內到期長期負債（附註十七、十八及二九）		7,420,132	-		19,313,889	-		23,426,667	1	
2399	應付費用及其他流動負債（附註十五、二十、二九及三一）		326,069,886	6		293,170,952	6		266,550,606	6	
21XX	流動負債合計		970,034,816	18		944,226,817	19		807,431,287	18	
	非流動負債										
2530	應付公司債（附註十七及二九）		932,479,423	17		834,336,439	17		842,386,471	18	
2541	長期銀行借款（附註十八及二九）		5,013,050	-		4,760,047	-		3,055,178	-	
2573	遞延所得稅負債（附註四）		212,549	-		1,031,383	-		1,466,389	-	
2580	租賃負債（附註十五及二九）		29,415,325	1		29,764,097	-		30,182,353	1	
2640	淨確定福利負債（附註四）		8,615,678	-		9,321,091	-		8,503,262	-	
2645	存入保證金		983,928	-		892,021	-		907,991	-	
2670	其他非流動負債（附註二十）		164,983,505	3		179,958,116	4		197,052,676	4	
25XX	非流動負債合計		1,141,703,458	21		1,060,063,194	21		1,083,554,320	23	
2XXX	負債合計		2,111,738,274	39		2,004,290,011	40		1,890,985,607	41	
	歸屬於母公司業主之權益										
3110	股本（附註十九）										
	普通股股本		259,320,710	5		259,303,805	5		259,303,805	6	
3200	資本公積（附註十九及二六）		69,879,218	1		69,330,328	1		69,316,391	1	
	保留盈餘（附註十九）										
3310	法定盈餘公積		311,146,899	6		311,146,899	6		311,146,899	7	
3320	特別盈餘公積		17,228,363	-		3,154,310	-		35,064,663	1	
3350	未分配盈餘		2,682,157,537	49		2,323,223,479	47		2,066,562,035	44	
3300	保留盈餘合計		3,010,532,799	55		2,637,524,688	53		2,412,773,597	52	
3400	其他權益（附註十九及二六）		8,616,930	-		(20,505,626)	-		(3,419,487)	-	
31XX	母公司業主權益合計		3,348,349,657	61		2,945,653,195	59		2,737,974,306	59	
36XX	非控制權益		24,468,450	-		14,835,672	1		14,341,853	-	
3XXX	權益合計		3,372,818,107	61		2,960,488,867	60		2,752,316,159	59	
	負債及權益總計		\$5,484,556,381	100		\$4,964,778,878	100		\$4,643,301,766	100	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年7月1日至9月30日		111年7月1日至9月30日		112年1月1日至9月30日		111年1月1日至9月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註二十、三一及三六)	\$ 546,732,758	100	\$ 613,142,743	100	\$1,536,206,985	100	\$1,638,359,424	100
5000	營業成本(附註十二、二七及三一)	<u>250,090,294</u>	<u>46</u>	<u>242,644,026</u>	<u>40</u>	<u>692,864,282</u>	<u>45</u>	<u>679,189,547</u>	<u>41</u>
5950	營業毛利	<u>296,642,464</u>	<u>54</u>	<u>370,498,717</u>	<u>60</u>	<u>843,342,703</u>	<u>55</u>	<u>959,169,877</u>	<u>59</u>
	營業費用(附註二七及三一)								
6300	研究發展費用	51,137,762	9	42,977,507	7	131,960,076	9	118,675,177	7
6200	管理費用	14,998,124	3	14,499,002	2	42,637,461	3	36,567,623	2
6100	行銷費用	<u>2,572,905</u>	<u>-</u>	<u>2,709,953</u>	<u>-</u>	<u>7,615,158</u>	<u>-</u>	<u>6,929,370</u>	<u>1</u>
6000	合 計	<u>68,708,791</u>	<u>12</u>	<u>60,186,462</u>	<u>9</u>	<u>182,212,695</u>	<u>12</u>	<u>162,172,170</u>	<u>10</u>
6500	其他營業收益及費損淨額(附註十四及二七)	<u>131,230</u>	<u>-</u>	<u>11,959</u>	<u>-</u>	<u>131,095</u>	<u>-</u>	<u>(759,626)</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利(附註三六)	<u>228,064,903</u>	<u>42</u>	<u>310,324,214</u>	<u>51</u>	<u>661,261,103</u>	<u>43</u>	<u>796,238,081</u>	<u>49</u>
	營業外收入及支出								
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	1,166,970	-	2,077,809	-	3,339,974	-	6,061,304	-
7100	利息收入(附註二一)	15,595,274	3	6,615,044	1	42,885,113	3	11,834,868	1
7190	其他收入	78,165	-	120,905	-	403,727	-	941,465	-
7230	外幣兌換淨益(損)(附註三四)	<u>(791,543)</u>	<u>-</u>	<u>(3,748,421)</u>	<u>(1)</u>	<u>(1,838,720)</u>	<u>-</u>	<u>5,859,265</u>	<u>-</u>
7050	財務成本(附註二二)	<u>(3,111,922)</u>	<u>(1)</u>	<u>(3,370,018)</u>	<u>-</u>	<u>(9,080,763)</u>	<u>-</u>	<u>(8,415,015)</u>	<u>(1)</u>
7020	其他利益及損失淨額(附註二三)	<u>938,648</u>	<u>-</u>	<u>4,671,334</u>	<u>1</u>	<u>3,919,901</u>	<u>-</u>	<u>(2,999,124)</u>	<u>-</u>
7000	合 計	<u>13,875,592</u>	<u>2</u>	<u>6,366,653</u>	<u>1</u>	<u>39,629,232</u>	<u>3</u>	<u>13,282,763</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	241,940,495	44	316,690,867	52	700,890,335	46	809,520,844	49
7950	所得稅費用(附註四及二四)	<u>31,145,221</u>	<u>5</u>	<u>35,722,460</u>	<u>6</u>	<u>101,429,019</u>	<u>7</u>	<u>88,498,811</u>	<u>5</u>
8200	本期淨利	<u>210,795,274</u>	<u>39</u>	<u>280,968,407</u>	<u>46</u>	<u>599,461,316</u>	<u>39</u>	<u>721,022,033</u>	<u>44</u>
	其他綜合損益(附註十九及二四)								
8310	不重分類至損益之項目：								
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	<u>(8,655)</u>	<u>-</u>	<u>(103,591)</u>	<u>-</u>	<u>987,893</u>	<u>-</u>	<u>68,610</u>	<u>-</u>
8317	避險工具之損益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39,898</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額	107,972	-	21,431	-	62,956	-	76,518	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益(費用)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31</u>	<u>-</u>	<u>(25)</u>	<u>-</u>	<u>262</u>	<u>-</u>
		<u>99,317</u>	<u>-</u>	<u>(82,129)</u>	<u>-</u>	<u>1,090,722</u>	<u>-</u>	<u>145,390</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：								
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	27,637,865	5	34,872,636	5	28,594,668	2	68,084,934	4
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	<u>(1,856,201)</u>	<u>(1)</u>	<u>(2,973,821)</u>	<u>-</u>	<u>(1,455,025)</u>	<u>-</u>	<u>(11,263,186)</u>	<u>-</u>
8368	避險工具之損益	<u>(19,068)</u>	<u>-</u>	<u>4,989</u>	<u>-</u>	<u>(55,327)</u>	<u>-</u>	<u>1,347,573</u>	<u>-</u>
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額	187,312	-	299,724	-	237,518	-	591,374	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,036</u>	<u>-</u>
		<u>25,949,908</u>	<u>4</u>	<u>32,203,528</u>	<u>5</u>	<u>27,321,834</u>	<u>2</u>	<u>58,766,731</u>	<u>4</u>
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>26,049,225</u>	<u>4</u>	<u>32,121,399</u>	<u>5</u>	<u>28,412,556</u>	<u>2</u>	<u>58,912,121</u>	<u>4</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 236,844,499</u>	<u>43</u>	<u>\$ 313,089,806</u>	<u>51</u>	<u>\$ 627,873,872</u>	<u>41</u>	<u>\$ 779,934,154</u>	<u>48</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年7月1日至9月30日		111年7月1日至9月30日		112年1月1日至9月30日		111年1月1日至9月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	本期淨利歸屬予								
8610	母公司業主	\$ 210,999,939	39	\$ 280,865,780	46	\$ 599,785,521	39	\$ 720,626,072	44
8620	非控制權益	(204,665)	-	102,627	-	(324,205)	-	395,961	-
		<u>\$ 210,795,274</u>	<u>39</u>	<u>\$ 280,968,407</u>	<u>46</u>	<u>\$ 599,461,316</u>	<u>39</u>	<u>\$ 721,022,033</u>	<u>44</u>
	本期綜合損益總額歸屬予								
8710	母公司業主	\$ 237,285,511	43	\$ 312,889,198	51	\$ 629,307,238	41	\$ 780,221,513	48
8720	非控制權益	(441,012)	-	200,608	-	(1,433,366)	-	(287,359)	-
		<u>\$ 236,844,499</u>	<u>43</u>	<u>\$ 313,089,806</u>	<u>51</u>	<u>\$ 627,873,872</u>	<u>41</u>	<u>\$ 779,934,154</u>	<u>48</u>
	每股盈餘(附註二五)								
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 8.14</u>		<u>\$ 10.83</u>		<u>\$ 23.13</u>		<u>\$ 27.79</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 8.14</u>		<u>\$ 10.83</u>		<u>\$ 23.13</u>		<u>\$ 27.79</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





台灣積體電路股份有限公司
民國 112 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

歸	母	公	司	其 他 之 項 目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				通 過 其 他 綜 合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普 通 股 發 行 股 本	普



董事長：



經理人：



會計主管：

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

	112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 700,890,335	\$ 809,520,844
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	374,654,167	323,122,219
攤銷費用	6,888,324	6,550,157
預期信用減損損失－債務工具投資	41,161	33,282
財務成本	9,080,763	8,415,015
採用權益法認列之關聯企業損益份額	(3,339,974)	(6,061,304)
利息收入	(42,885,113)	(11,834,868)
股份基礎給付酬勞成本	355,701	222,091
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損	335,393	91,532
處分及報廢無形資產淨益	(2,308)	-
不動產、廠房及設備減損損失	-	790,740
透過損益按公允價值衡量之金融工具淨利		
益	(27,022)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之		
債務工具投資淨損失	372,631	346,125
外幣兌換淨損	4,178,853	12,532,183
股利收入	(387,837)	(260,534)
其他	(280,262)	(292,572)
與營業活動相關之資產／負債淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融工具	857,225	(4,622,312)
應收票據及帳款淨額	7,288,198	(62,861,124)
應收關係人款項	1,227,701	(375,850)
其他應收關係人款項	(13,388)	(14,612)
存貨	(40,940,924)	(25,233,553)
其他金融資產	263,031	(4,371,124)
其他流動資產	(5,852,289)	(1,072,295)
其他非流動資產	(378,730)	-
應付帳款	(2,728,825)	12,861,802
應付關係人款項	(21,214)	433,633
應付薪資及獎金	(7,778,221)	7,577,929
應付員工酬勞及董事酬勞	(24,040,371)	8,517,224
應付費用及其他流動負債	(34,382,658)	38,582,192
其他非流動負債	26,776,501	100,127,809
淨確定福利負債	(705,413)	(2,533,617)
營運產生之現金	969,445,435	1,210,191,012
支付所得稅	(122,307,435)	(86,473,728)
營業活動之淨現金流入	847,138,000	1,123,717,284

(接次頁)

(承前頁)

	112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 323,973)	\$ -
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(54,832,622)	(49,269,573)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(115,641,029)	(123,508,899)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	28,804,766	41,221,410
按攤銷後成本衡量之金融資產領回	89,166,171	20,620,129
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資成本收回	117,897	300
除列避險之金融工具	66,776	1,591,074
收取之利息	41,015,135	9,440,363
收取政府補助款－不動產、廠房及設備	20,756,650	462,822
收取政府補助款－其他	1,152	874
收取其他股利	387,837	260,534
收取採用權益法投資之股利	3,076,482	2,749,667
取得不動產、廠房及設備	(779,656,605)	(745,827,757)
取得無形資產	(3,387,581)	(5,471,086)
處分不動產、廠房及設備價款	391,764	801,029
處分無形資產價款	2,308	-
預付租賃款增加	(50,173)	-
存出保證金增加	(4,053,259)	(1,904,318)
存出保證金減少	357,210	437,209
投資活動之淨現金流出	(773,801,094)	(848,396,222)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(111,959,992)
避險之金融負債－銀行借款增加	27,908,580	-
發行公司債	75,900,000	188,093,561
償還公司債	(18,100,000)	-
舉借長期借款	2,450,000	500,000
償還長期銀行借款	(1,244,444)	-
支付公司債發行成本	(78,448)	(403,162)
買回庫藏股票	-	(871,566)
租賃本金償還	(2,132,449)	(1,767,753)
支付利息	(11,363,895)	(6,498,170)
收取存入保證金	230,116	199,190
存入保證金返還	(217,446)	(43,314)
支付現金股利	(213,925,639)	(213,925,639)
非控制權益增加	11,046,506	16,264,358
籌資活動之淨現金流出	(129,527,119)	(130,412,487)

(接次頁)

(承前頁)

	112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>\$ 25,182,665</u>	<u>\$ 86,114,017</u>
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	(31,007,548)	231,022,592
期初現金及約當現金餘額	<u>1,342,814,083</u>	<u>1,064,990,192</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,311,806,535</u>	<u>\$ 1,296,012,784</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件六：民國一百一十年度個體財務報表 及會計師查核報告

會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積公司）民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台積公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台積公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台積公司民國 110 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台積公司民國 110 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備－不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程之折舊開始提列時點

請參閱個體財務報表附註四、五及十二。

台積公司於評估不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程之折舊開始提列時點，是始於該資產達可供使用且符合預期運作方式之必要狀態時。因該資產預期使用狀態之評估條件涉及主觀判斷及假設，而假設之變動所影響之折舊開始提列時點將對台積公司之財務績效產生重大影響。

由於台積公司折舊開始提列時點涉及主觀因素，本會計師於執行查核程序以評估台積公司之判斷及假設是否合理需要運用高度審計判斷，因此本會計師將本年度不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程提列折舊之時點列為關鍵查核事項。

對於上述所述層面事項本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 檢視並了解折舊開始提列時點之政策及條件。
2. 測試待驗設備及未完工程提列折舊時點之主要內部控制有效性。
3. 自年底待驗設備及未完工程餘額明細中抽核並評估及觀察其是否尚未達到可供使用狀態。
4. 自本年度達可供使用狀態標準之待驗設備及未完工程中抽核，評估其折舊開始提列之時點是否適當。
5. 自期後已轉列至達可供使用狀態之待驗設備及未完工程中抽核，評估其折舊開始提列時點是否適當。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台積公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台積公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台積公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台積公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台積公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台積公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台積公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台積公司民國 110 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 美 艷

江美艷



會計師 林 尚 志

林尚志



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 1 1 1 年 2 月 1 5 日

代碼	資 產	110 年 12 月 31 日			109 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	396,294,241	12	\$	303,165,717	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）		145,280	-		2,125,825	-
1170	應收票據及帳款淨額（附註九）		45,900,297	2		34,611,115	1
1180	應收關係人款項（附註三十）		138,352,374	4		101,781,174	4
1210	其他應收關係人款項（附註三十）		5,227,425	-		1,714,334	-
1310	存貨（附註五及十）		185,159,848	5		130,298,036	5
1476	其他金融資產		3,861,859	-		1,425,594	-
1479	其他流動資產		8,264,613	-		5,827,453	-
11XX	流動資產合計		783,205,937	23		580,949,248	21
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		998,400	-		834,830	-
1550	採用權益法之投資（附註十一）		602,642,544	18		564,597,508	21
1600	不動產、廠房及設備（附註五及十二）		1,889,970,529	56		1,511,784,556	55
1755	使用權資產（附註五及十三）		30,123,052	1		25,184,827	1
1780	無形資產（附註五及十四）		22,910,400	1		21,733,597	1
1840	遞延所得稅資產（附註五及二三）		47,780,990	1		24,678,225	1
1920	存出保證金		862,893	-		1,249,552	-
1990	其他非流動資產		400	-		2,492,770	-
15XX	非流動資產合計		2,595,289,208	77		2,152,555,865	79
1XXX	資 產 總 計		\$ 3,378,495,145	100		\$ 2,733,505,113	100
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十五及二七）	\$	114,921,333	3	\$	175,659,726	7
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）		636,472	-		93,153	-
2170	應付帳款		41,204,422	1		36,238,637	1
2180	應付關係人款項（附註三十）		7,687,673	-		7,017,623	-
2201	應付薪資及獎金		20,814,434	1		17,478,038	1
2206	應付員工酬勞及董事酬勞（附註二六）		36,088,986	1		35,262,937	1
2213	應付工程及設備款		136,212,285	4		156,342,457	6
2216	應付現金股利（附註十八）		142,617,093	4		129,651,902	5
2230	本期所得稅負債（附註五及二三）		58,755,245	2		53,297,025	2
2320	一年內到期長期負債（附註十六及二七）		4,400,000	-		2,600,000	-
2399	應付費用及其他流動負債（附註五、十三、十九、二七及三十）		141,495,427	4		66,888,237	2
21XX	流動負債合計		704,833,370	20		680,529,735	25
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十六及二七）		307,783,409	9		170,450,745	6
2573	遞延所得稅負債（附註五及二三）		1,848,966	-		1,716,367	-
2580	租賃負債（附註五、十三及二七）		18,742,323	1		18,480,111	1
2640	淨確定福利負債（附註十七）		11,036,879	-		11,914,074	1
2645	存入保證金		680,137	-		259,073	-
2670	其他非流動負債（附註十九及三十）		165,283,508	5		497,752	-
25XX	非流動負債合計		505,375,222	15		203,318,122	8
2XXX	負債合計		1,210,208,592	35		883,847,857	33
	權 益						
3110	股本（附註十八）						
	普通股股本		259,303,805	8		259,303,805	9
3200	資本公積（附註十八）		64,761,602	2		56,347,243	2
	保留盈餘（附註十八）						
3310	法定盈餘公積		311,146,899	9		311,146,899	11
3320	特別盈餘公積		59,304,212	2		42,259,146	2
3350	未分配盈餘		1,536,378,550	46		1,235,280,036	45
3300	保留盈餘合計		1,906,829,661	57		1,588,686,081	58
3400	其他權益（附註十八）	(	62,608,515)	(2)	(	54,679,873)	(2)
3XXX	權益合計		2,168,286,553	65		1,849,657,256	67
	負 債 及 權 益 總 計		\$ 3,378,495,145	100		\$ 2,733,505,113	100

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製程股份有限公司

個體綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、十九及三十）	\$1,574,745,881	100	\$1,314,793,013	100
5000	營業成本（附註五、十、二六及三十）	<u>786,116,844</u>	<u>50</u>	<u>632,788,990</u>	<u>48</u>
5950	營業毛利	<u>788,629,037</u>	<u>50</u>	<u>682,004,023</u>	<u>52</u>
	營業費用（附註五、二六及三十）				
6300	研究發展費用	123,417,275	8	108,613,789	8
6200	管理費用	30,967,600	2	26,312,285	2
6100	行銷費用	<u>4,282,882</u>	<u>-</u>	<u>4,359,436</u>	<u>1</u>
6000	合 計	<u>158,667,757</u>	<u>10</u>	<u>139,285,510</u>	<u>11</u>
6500	其他營業收益及費損淨額（附註十二、十三及二六）	<u>(328,444)</u>	<u>-</u>	<u>746,994</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>629,632,836</u>	<u>40</u>	<u>543,465,507</u>	<u>41</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註十一）	26,837,174	2	34,902,194	3
7100	利息收入（附註二十）	927,754	-	951,877	-
7190	其他收入	789,810	-	209,885	-
7230	外幣兌換淨益（損）（附註三二）	14,682,696	1	(1,759,386)	-
7050	財務成本（附註二一）	<u>(2,534,721)</u>	<u>-</u>	<u>(1,766,297)</u>	<u>-</u>
7020	其他利益及損失淨額（附註二二）	<u>(9,833,358)</u>	<u>(1)</u>	<u>6,615,162</u>	<u>-</u>
7000	合 計	<u>30,869,355</u>	<u>2</u>	<u>39,153,435</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	660,502,191	42	582,618,942	44
7950	所得稅費用（附註五及二三）	<u>63,962,178</u>	<u>4</u>	<u>64,733,555</u>	<u>5</u>
8200	本年度淨利	<u>596,540,013</u>	<u>38</u>	<u>517,885,387</u>	<u>39</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益（附註五、十一、十七、十八及二三）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 242,079	-	(\$ 3,516,749)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	170,127	-	(41,995)	-
8317	避險工具之損益	(41,416)	-	24,085	-
8320	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	1,697,885	-	453,603	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（費用）利益	(85,269)	-	422,663	-
		<u>1,983,406</u>	-	<u>(2,658,393)</u>	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(6,182,507)	-	(29,853,603)	(2)
8370	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	(3,422,853)	-	2,190,087	-
		<u>(9,605,360)</u>	-	<u>(27,663,516)</u>	<u>(2)</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(7,621,954)</u>	-	<u>(30,321,909)</u>	<u>(2)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 588,918,059</u>	<u>38</u>	<u>\$ 487,563,478</u>	<u>37</u>
	每股盈餘（附註二四）				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 23.01</u>		<u>\$ 19.97</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 23.01</u>		<u>\$ 19.97</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：





台灣證券交易所股份有限公司
TAIPEI STOCK EXCHANGE
105年12月31日

民國 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	普 通 股 發 行 股 本 股數 (仟股) 25,930,380	資 本 公 積 \$ 56,339,769	保 留 盈 餘 法定盈餘公積 \$ 311,146,899	特別盈餘公積 \$ 10,675,106	未 分 配 盈 餘 \$ 1,011,512,974	盈 餘 保留盈餘合計 \$ 1,333,334,979	其 他 權 益					總 計
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 (\$ 26,871,400)	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現評價損益 (\$ 692,959)	遞延工具損益 (\$ 3,820)	員工未賺得酬勞 (\$ 190)	其他權益合計 (\$ 27,568,369)	
109 年 1 月 1 日餘額	25,930,380	\$ 259,303,805	\$ 311,146,899	\$ 10,675,106	\$ 1,011,512,974	\$ 1,333,334,979	-	-	-	-	-	\$ 1,621,410,124
盈餘分配	-	-	-	-	(31,584,040)	(31,584,040)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	(259,303,805)	(259,303,805)	-	-	-	-	-	(259,303,805)
現金股利	-	-	-	-	(290,887,845)	(290,887,845)	-	-	-	-	-	(290,887,845)
盈餘分配合計	-	-	-	-	(581,471,885)	(581,471,885)	-	-	-	-	-	-
109 年度淨利	-	-	-	-	517,885,387	517,885,387	-	-	-	-	-	517,885,387
109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(3,121,793)	(3,121,793)	(30,130,222)	2,906,026	24,085	-	(27,200,116)	(30,321,809)
109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	514,763,594	514,763,594	(30,130,222)	2,906,026	24,085	-	(27,200,116)	(487,563,478)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	(108,687)	(108,687)	-	108,687	-	-	108,687	-
遞延工具損益基礎調整	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,265)	-	(20,265)	(20,265)
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	292	-	-	-	-	-	-	-	190	190	482
因受領贈與產生者	-	7,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,242
109 年 12 月 31 日餘額	25,930,380	\$ 56,347,243	\$ 311,146,899	\$ 42,259,146	\$ 1,235,280,036	\$ 1,588,686,081	(57,001,627)	2,321,754	-	-	(54,679,873)	\$ 1,449,657,256
盈餘分配	-	-	-	-	(17,045,066)	(17,045,066)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	(278,751,590)	(278,751,590)	-	-	-	-	-	(278,751,590)
現金股利	-	-	-	-	(295,796,656)	(295,796,656)	-	-	-	-	-	(295,796,656)
盈餘分配合計	-	-	-	-	(590,632,712)	(590,632,712)	-	-	-	-	-	-
110 年度淨利	-	-	-	-	596,540,013	596,540,013	-	-	-	-	-	596,540,013
110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	167,503	167,503	(6,301,734)	(1,559,790)	72,067	-	(7,789,437)	(7,621,954)
110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	596,707,516	596,707,516	(6,301,734)	(1,559,790)	72,067	-	(7,789,437)	(588,918,059)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	187,654	187,654	-	(187,654)	-	-	(187,654)	-
遞延工具損益基礎調整	-	-	-	-	-	-	-	-	48,469	-	48,469	48,469
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	4,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,796
實際處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	8,406,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,406,282
認列對子公司所有權權益變動數	-	(7,891)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,891)	-
因受領贈與產生者	-	11,172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,172
110 年 12 月 31 日餘額	25,930,380	\$ 64,761,602	\$ 311,146,899	\$ 59,304,212	\$ 1,536,376,550	\$ 1,906,829,661	(63,303,361)	\$ 574,310	\$ 120,536	\$ -	(62,618,515)	\$ 2,168,286,553



董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司

個體現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 660,502,191	\$ 582,618,942
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	402,931,257	313,379,686
攤銷費用	8,100,730	7,047,694
財務成本	2,534,721	1,766,297
採用權益法認列之子公司及關聯企業		
損益份額	(26,837,174)	(34,902,194)
利息收入	(927,754)	(951,877)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損		
(益)	222,387	(266,581)
處分及報廢無形資產淨益	(7,332)	(7,960)
不動產、廠房及設備減損損失	274,388	-
透過損益按公允價值衡量之金融工具		
淨利益	-	(8,289)
外幣兌換淨益	(16,975,706)	(7,747,615)
股利收入	(178,979)	(186,854)
其他項目	(370,086)	13,808
與營業活動相關之資產／負債淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融工具	2,482,448	(2,973,199)
應收票據及帳款淨額	(11,289,182)	13,002,568
應收關係人款項	(36,571,200)	(19,586,673)
其他應收關係人款項	(3,503,728)	(684,360)
存貨	(54,861,812)	(54,034,185)
其他金融資產	(2,371,699)	(1,091,188)
其他流動資產	(2,445,945)	(1,174,789)
應付帳款	4,965,785	400,931
應付關係人款項	(746,871)	1,300,988
應付薪資及獎金	3,336,396	3,262,877
應付員工酬勞及董事酬勞	826,049	11,736,788
應付費用及其他流動負債	82,992,551	19,228,140
其他非流動負債	154,036,474	-
淨確定福利負債	(635,116)	(785,171)
營運產生之現金	1,165,482,793	829,357,784
支付所得稅	(81,550,608)	(49,747,636)
營業活動之淨現金流入	<u>1,083,932,185</u>	<u>779,610,148</u>

(接次頁)

(承前頁)

	110年度	109年度
投資活動之現金流量：		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益		
工具投資成本收回	\$ 6,257	\$ 285
除列避險之金融工具	-	19,786
收取之利息	902,872	958,590
收取其他股利	178,979	186,854
收取採用權益法投資之股利	2,560,790	2,752,043
取得子公司之現金流出	(157,243)	(937,679)
取得不動產、廠房及設備	(793,327,208)	(494,310,468)
取得無形資產	(8,998,084)	(9,482,909)
處分不動產、廠房及設備價款	462,138	1,070,855
預付租賃款增加	(1,200,000)	(4,687,970)
存出保證金增加	(225,347)	(667,219)
存出保證金減少	605,714	1,427,743
投資活動之淨現金流出	(799,191,132)	(503,670,089)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(50,538,933)	31,944,333
應付短期票券增加	-	7,485,303
應付短期票券減少	-	(7,500,000)
發行公司債	142,318,000	149,085,000
償還公司債	(2,600,000)	(31,800,000)
支付公司債發行成本	(146,157)	(155,818)
租賃本金償還	(1,466,130)	(2,168,114)
支付利息	(1,997,383)	(1,729,192)
收取存入保證金	467,964	144,364
存入保證金返還	(7,234)	(13,695)
支付現金股利	(265,786,399)	(259,303,805)
處分子公司股權(未喪失控制力)	9,451,798	-
取得子公司部分權益價款	(21,318,931)	(220,480)
因受領贈與產生者	10,876	7,064
籌資活動之淨現金流出	(191,612,529)	(114,225,040)
現金及約當現金淨增加數	93,128,524	161,715,019
年初現金及約當現金餘額	303,165,717	141,450,698
年底現金及約當現金餘額	\$ 396,294,241	\$ 303,165,717

董事長：



經理人：



會計主管：



附件七：民國一百一十一年度個體財務報
表及會計師查核報告

會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台積公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台積公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台積公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台積公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備－不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程之折舊開始提列時點

請參閱個體財務報表附註四、五及十三。

台積公司於評估不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程之折舊開始提列時點，是始於該資產達可供使用且符合預期運作方式之必要狀態時。因該資產預期使用狀態之評估條件涉及主觀判斷及假設，而假設之變動所影響之折舊開始提列時點將對台積公司之財務績效產生重大影響。

由於台積公司折舊開始提列時點涉及主觀因素，本會計師於執行查核程序以評估台積公司之判斷及假設是否合理需要運用高度審計判斷，因此本會計師將本年度不動產、廠房及設備項下之待驗設備及未完工程提列折舊之時點列為關鍵查核事項。

對於上述所述層面事項本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 檢視並了解折舊開始提列時點之政策及條件。
2. 測試待驗設備及未完工程提列折舊時點之主要內部控制有效性。
3. 自年底待驗設備及未完工程餘額明細中抽核並評估及觀察其是否尚未達到可供使用狀態。
4. 自本年度達可供使用狀態標準之待驗設備及未完工程中抽核，評估其折舊開始提列之時點是否適當。
5. 自期後已轉列至達可供使用狀態之待驗設備及未完工程中抽核，評估其折舊開始提列時點是否適當。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台積公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台積公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台積公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台積公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台積公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台積公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台積公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台積公司民國 111 年度個別財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 美 艷

江美艷



會計師 林 尚 志

林尚志



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 112 年 2 月 14 日

代 碼	資 產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 628,875,897	14	\$ 396,294,241	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	552,255	-	145,280	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註八）	48,732,476	1	-	-
1170	應收票據及帳款淨額（附註十）	41,311,836	1	45,900,297	2
1180	應收關係人款項（附註三一）	173,044,812	4	138,352,374	4
1210	其他應收關係人款項（附註三一）	6,357,925	-	5,227,425	-
1310	存貨（附註五及十一）	208,282,895	5	185,159,848	5
1476	其他金融資產	2,801,253	-	3,861,859	-
1479	其他流動資產	8,591,040	-	8,264,613	-
11XX	流動資產合計	1,118,550,389	25	783,205,937	23
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,014,741	-	998,400	-
1550	採用權益法之投資（附註十二）	727,947,169	16	602,642,544	18
1600	不動產、廠房及設備（附註五及十三）	2,432,675,050	55	1,889,970,529	56
1755	使用權資產（附註五及十四）	39,051,427	1	30,123,052	1
1780	無形資產（附註五及十五）	21,456,104	1	22,910,400	1
1840	遞延所得稅資產（附註五及二四）	67,708,061	2	47,780,990	1
1920	存出保證金	2,095,656	-	862,893	-
1990	其他非流動資產（附註三一）	11,920,467	-	400	-
15XX	非流動資產合計	3,303,868,675	75	2,595,289,208	77
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,422,419,064	100	\$ 3,378,495,145	100
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六及二八）	\$ -	-	\$ 114,921,333	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）	17,468	-	636,472	-
2170	應付帳款	48,732,542	1	41,204,422	1
2180	應付關係人款項（附註三一）	10,051,044	-	7,687,673	-
2201	應付薪資及獎金	31,308,620	1	20,814,434	1
2206	應付員工酬勞及董事酬勞（附註二七）	61,392,175	1	36,088,986	1
2213	應付工程及設備款	200,046,018	5	136,212,285	4
2216	應付現金股利（附註十九）	142,617,093	3	142,617,093	4
2230	本期所得稅負債（附註五及二四）	120,077,567	3	58,755,245	2
2320	一年內到期長期負債（附註十七及二八）	18,100,000	-	4,400,000	-
2399	應付費用及其他流動負債（附註五、十四、二十、二八及三一）	266,903,073	6	141,495,427	4
21XX	流動負債合計	899,245,600	20	704,833,370	20
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註十七及二八）	361,130,474	8	307,783,409	9
2573	遞延所得稅負債（附註五及二四）	908,273	-	1,848,966	-
2580	租賃負債（附註五、十四及二八）	27,593,900	1	18,742,323	1
2640	淨確定福利負債（附註十八）	9,321,091	-	11,036,879	-
2645	存入保證金	885,273	-	680,137	-
2670	其他非流動負債（附註二十及三一）	177,681,258	4	165,283,508	5
25XX	非流動負債合計	577,520,269	13	505,375,222	15
2XXX	負債合計	1,476,765,869	33	1,210,208,592	35
	權 益				
3110	股本（附註十九）				
	普通股股本	259,303,805	6	259,303,805	8
3200	資本公積（附註十九）	69,330,328	2	64,761,602	2
	保留盈餘（附註十九）				
3310	法定盈餘公積	311,146,899	7	311,146,899	9
3320	特別盈餘公積	3,154,310	-	59,304,212	2
3350	未分配盈餘	2,323,223,479	53	1,536,378,550	46
3300	保留盈餘合計	2,637,524,688	60	1,906,829,661	57
3400	其他權益（附註十九）	(20,505,626)	(1)	(62,608,515)	(2)
3XXX	權益合計	2,945,653,195	67	2,168,286,553	65
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 4,422,419,064	100	\$ 3,378,495,145	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入淨額（附註五、二十 及三一）	\$2,252,320,561	100	\$1,574,745,881	100
5000	營業成本（附註五、十一、二 七及三一）	<u>951,927,673</u>	<u>42</u>	<u>786,116,844</u>	<u>50</u>
5950	營業毛利	<u>1,300,392,888</u>	<u>58</u>	<u>788,629,037</u>	<u>50</u>
	營業費用（附註五、二七及三 一）				
6300	研究發展費用	160,813,633	7	123,417,275	8
6200	管理費用	42,764,642	2	30,967,600	2
6100	行銷費用	<u>6,059,649</u>	<u>-</u>	<u>4,282,882</u>	<u>-</u>
6000	合 計	<u>209,637,924</u>	<u>9</u>	<u>158,667,757</u>	<u>10</u>
6500	其他營業收益及費損淨額（附 註十三及二七）	(<u>8,275</u>)	(<u>1</u>)	(<u>328,444</u>)	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>1,090,746,689</u>	<u>48</u>	<u>629,632,836</u>	<u>40</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司 及關聯企業損益份額 （附註十二）	42,415,408	2	26,837,174	2
7100	利息收入（附註二一）	5,957,864	1	927,754	-
7190	其他收入	887,958	-	789,810	-
7230	外幣兌換淨益（附註三 三）	853,022	-	14,682,696	1
7050	財務成本（附註二二）	(<u>3,240,406</u>)	-	(<u>2,534,721</u>)	-
7020	其他利益及損失淨額（附 註二三）	<u>3,053,281</u>	<u>-</u>	(<u>9,833,358</u>)	(<u>1</u>)
7000	合 計	<u>49,927,127</u>	<u>3</u>	<u>30,869,355</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	1,140,673,816	51	660,502,191	42
7950	所得稅費用（附註五及二四）	<u>124,143,567</u>	<u>6</u>	<u>63,962,178</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>1,016,530,249</u>	<u>45</u>	<u>596,540,013</u>	<u>38</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益（附註五、十二、十八、十九及二四）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 823,060)	-	\$ 242,079	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	18,979	-	170,127	-
8317	避險工具之損益	-	-	(41,416)	-
8320	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	(127,903)	-	1,697,885	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益（費用）	<u>733,956</u> <u>(198,028)</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>(85,269)</u> <u>1,983,406</u>	<u>-</u> <u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	51,030,928	2	(6,182,507)	-
8370	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	(8,244,295)	-	(3,419,483)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅利益（費用）	<u>6,036</u> <u>42,792,669</u>	<u>-</u> <u>2</u>	<u>(3,370)</u> <u>(9,605,360)</u>	<u>-</u> <u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>42,594,641</u>	<u>2</u>	<u>(7,621,954)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$1,059,124,890</u>	<u>47</u>	<u>\$ 588,918,059</u>	<u>38</u>
	每股盈餘（附註二五）				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 39.20</u>		<u>\$ 23.01</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 39.20</u>		<u>\$ 23.01</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

110年1月1日餘額	普通股股數(仟股)	發行股本額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	其他綜合損益	員工未賺得酬勞	其他權益合計	庫藏股票	權益合計
25,930,380	\$ 259,303,805	\$ 56,347,243	\$ 311,146,899	\$ 42,259,146	\$ 1,215,280,036	\$ 1,588,686,181	\$ 57,001,027	\$ 2,321,754	\$ -	\$ -	\$ 54,679,873	\$ -	\$ 1,849,657,256
庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	17,045,066	(17,045,066)	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(278,751,590)	-	-	-	-	-	-	(278,751,590)
盈餘分配合計	-	-	-	-	-	(278,751,590)	-	-	-	-	-	-	(278,751,590)
本年度淨利	-	-	-	-	-	596,540,013	-	-	-	-	-	-	596,540,013
本年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	167,503	(6,301,234)	(1,559,790)	72,067	-	(7,789,457)	-	(7,621,954)
本年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	596,707,516	(6,301,234)	(1,559,790)	72,067	-	(7,789,457)	-	588,918,059
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	-	187,654	-	(187,654)	-	-	(187,654)	-	-
遞除工具損益基礎調整	-	-	-	-	-	-	-	-	48,469	-	48,469	-	48,469
採用權益法認列之關聯企業取得淨值之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,796
實際處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,406,282
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,891)
因受贈贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,172
110年12月31日餘額	25,930,380	\$ 64,761,602	\$ 311,146,899	\$ 59,304,212	\$ 1,536,378,550	\$ 1,906,829,661	(63,303,361)	\$ 574,310	\$ 120,536	(62,608,515)	\$ 2,168,286,553	-	\$ 2,168,286,553
庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	(56,149,902)	56,149,902	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(285,234,185)	-	-	-	-	-	-	(285,234,185)
盈餘分配合計	-	-	-	-	-	(229,084,283)	-	-	-	-	-	-	(285,234,185)
本年度淨利	-	-	-	-	-	1,016,530,249	-	-	-	-	-	-	1,016,530,249
本年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(49,572)	51,560,060	(10,327,421)	1,411,574	-	42,644,213	-	42,594,641
本年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,016,480,677	51,560,060	(10,327,421)	1,411,574	-	42,644,213	-	1,059,124,890
股份基礎給付交易	1,387	13,870	438,029	-	-	-	-	-	(185,153)	(185,153)	-	-	266,746
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(871,566)	(871,566)	-
庫藏股票註銷	(1,387)	(13,870)	(2,989)	-	-	(854,707)	-	-	-	-	-	871,566	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	-	303,242	-	(303,242)	-	-	(303,242)	-	-
遞除工具損益基礎調整	-	-	-	-	-	-	-	-	(52,929)	-	(52,929)	-	(52,929)
採用權益法認列之關聯企業取得淨值之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,541
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,115,940
因受贈贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,205
111年12月31日餘額	25,930,380	\$ 69,330,328	\$ 311,146,899	\$ 3,154,310	\$ 2,323,223,429	\$ 2,637,524,688	(11,743,301)	(10,056,333)	\$ 1,479,181	(185,153)	(20,505,626)	\$ -	\$ 2,945,653,195

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



會計主管：



經理人：



董事長：

台灣積體電路製造股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$1,140,673,816	\$ 660,502,191
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	413,595,082	402,931,257
攤銷費用	8,706,961	8,100,730
預期信用減損損失－債務工具投資	10,341	-
財務成本	3,240,406	2,534,721
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	(42,415,408)	(26,837,174)
利息收入	(5,957,864)	(927,754)
股份基礎給付酬勞成本	266,746	-
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損(益)	(436,567)	222,387
處分及報廢無形資產淨損(益)	3,720	(7,332)
不動產、廠房及設備減損損失	790,740	274,388
外幣兌換淨損(益)	9,965,603	(16,975,706)
股利收入	(207,028)	(178,979)
其他	131,637	(370,086)
與營業活動相關之資產／負債淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融工具	(1,025,979)	2,482,448
應收票據及帳款淨額	4,588,461	(11,289,182)
應收關係人款項	(34,692,438)	(36,571,200)
其他應收關係人款項	(1,074,087)	(3,503,728)
存貨	(23,123,047)	(54,861,812)
其他金融資產	1,894,328	(2,371,699)
其他流動資產	(712,233)	(2,445,945)
其他非流動資產	(8,532,751)	-
應付帳款	7,528,120	4,965,785
應付關係人款項	2,362,846	(746,871)
應付薪資及獎金	10,494,186	3,336,396
應付員工酬勞及董事酬勞	25,303,189	826,049
應付費用及其他流動負債	47,110,082	82,992,551
其他非流動負債	86,831,552	154,036,474
淨確定福利負債	(2,538,848)	(635,116)
營運產生之現金	1,642,781,566	1,165,482,793
支付所得稅	(83,364,086)	(81,550,608)
營業活動之淨現金流入	<u>1,559,417,480</u>	<u>1,083,932,185</u>

(接次頁)

(承前頁)

	111年度	110年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 97,748,105)	\$ -
按攤銷後成本衡量之金融資產領回	49,190,000	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資成本收回	2,938	6,257
收取之利息	4,889,786	902,872
收取其他股利	207,028	178,979
收取採用權益法投資之股利	3,248,044	2,560,790
取得子公司之現金流出	-	(157,243)
取得不動產、廠房及設備	(897,574,802)	(793,327,208)
取得無形資產	(6,679,871)	(8,998,084)
處分不動產、廠房及設備價款	1,665,212	462,138
處分無形資產價款	3,750	-
預付租賃款增加	-	(1,200,000)
存出保證金增加	(1,611,716)	(225,347)
存出保證金減少	406,185	605,714
投資活動之淨現金流出	(944,001,551)	(799,191,132)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(111,959,992)	(50,538,933)
發行公司債	65,400,000	142,318,000
償還公司債	(4,400,000)	(2,600,000)
支付公司債發行成本	(69,528)	(146,157)
買回庫藏股票	(871,566)	-
租賃本金償還	(1,848,257)	(1,466,130)
支付利息	(3,757,985)	(1,997,383)
收取存入保證金	216,589	467,964
存入保證金返還	(45,643)	(7,234)
支付現金股利	(285,234,185)	(265,786,399)
處分子公司股權（未喪失控制力）	-	9,451,798
取得子公司部分權益價款	(40,421,374)	(21,318,931)
處分子公司部分權益價款	144,505	-
因受領贈與產生者	13,163	10,876
籌資活動之淨現金流出	(382,834,273)	(191,612,529)
現金及約當現金淨增加數	232,581,656	93,128,524
年初現金及約當現金餘額	396,294,241	303,165,717
年底現金及約當現金餘額	\$ 628,875,897	\$ 396,294,241

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司



董事長 劉德音

